Consejo de la Unión Europea

Bruselas, 11 de febrero de 2022
(OR. en)

6170/22

Expediente interinstitucional: 2022/0032 (COD)

COMPET 84
IND 34
MI 103
RC 9
RECH 74
TELECOM 51
FIN 149
CADREFIN 12
CODEC 140

PROPUESTA

De:	Por la secretaria general de la Comisión Europea, D.ª Martine DEPREZ, directora
Fecha de recepción:	10 de febrero de 2022
A:	D. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretario general del Consejo de la Unión Europea
N.° doc. Ción.:	COM(2022) 46 final
Asunto:	Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores (Ley de Chips)

Adjunto se remite a las Delegaciones el documento – COM(2022) 46 final.

Adj.: COM(2022) 46 final

COMISIÓN
EUROPEA

Bruselas, 8.2.2022
COM(2022) 46 final

2022/0032 (COD)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores (Ley de Chips)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

• Razones y objetivos de la propuesta

Los chips semiconductores son fundamentales para la economía digital. Gracias a ellos, los productos digitales funcionan: desde los teléfonos inteligentes y los automóviles hasta las aplicaciones e infraestructuras críticas en los ámbitos de la salud, la energía, las comunicaciones, la automatización y la mayoría de los sectores industriales. Los chips también son esenciales para las tecnologías del futuro, incluida la inteligencia artificial (IA) y la comunicación 5G/6G. Sin los chips, el sector digital no podría existir.

Durante el pasado año, Europa ha sido testigo de perturbaciones en el suministro de chips, lo que ha provocado penurias en múltiples sectores económicos y consecuencias sociales potencialmente graves. Muchos sectores europeos, como la automoción, la energía, la comunicación y la salud, así como sectores estratégicos como la defensa, la seguridad y el espacio, se ven amenazados por tales perturbaciones del suministro. Al mismo tiempo, empiezan a aparecer en el mercado chips falsos, lo que pone en peligro la seguridad de los dispositivos y sistemas electrónicos.

La actual crisis ha revelado vulnerabilidades estructurales de las cadenas de valor europeas. La escasez mundial de semiconductores ha puesto de manifiesto la dependencia europea del suministro procedente de un número limitado de empresas y zonas geográficas, así como la vulnerabilidad europea ante las restricciones a la exportación de terceros países, y otras perturbaciones en el contexto geopolítico actual. Además, esta dependencia se ve agravada por los obstáculos extremadamente elevados para entrar en el mercado y por la intensidad de capital del sector. Por ejemplo, los chips más potentes desde el punto de vista de la computación tienen que fabricarse con una precisión de unos pocos nanómetros (nm)[1]. La construcción de instalaciones capaces de fabricar con tal precisión exige una inversión inicial de al menos 15 000 millones EUR[2] y se necesitan tres años para alcanzar un nivel de producción con rendimientos adecuados[3]. Los gastos para diseñar este tipo de chips pueden oscilar entre 500 millones EUR y más de 1 000 millones EUR. La intensidad de investigación y desarrollo (I+D) en el sector es elevada y supera el 15 %[4].

En la actualidad, los agentes europeos invierten principalmente en I+D, pero no lo suficiente como para traducir sus resultados en beneficios industriales. La I+D es un factor clave para la miniaturización en las tecnologías de semiconductores necesarias para la producción de chips de próxima generación potentes desde el punto de vista de la computación. Europa alberga organizaciones de investigación y tecnología líderes a nivel mundial. Sin embargo, en muchos casos, los resultados de actividades europeas de I+D se desarrollan industrialmente fuera de la Unión.

---

1 En la fabricación de semiconductores, la tecnología de procesos se ha correlacionado tradicionalmente con la dimensión de los transistores. El «nodo» de proceso se mide en nanómetros (nm); un nanómetro = una mil millonésima parte de un metro. Los nodos de proceso más pequeños producen transistores más pequeños, que son más rápidos y tienen una mayor eficiencia energética. En la actualidad, el nodo de proceso más avanzado mide 5 nm, con 3 nm en fase de preproducción y 2 nm en desarrollo.

2 https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-new-advanced-semiconductor-fab-site-in-taylor-texas, 24.11.2021.

3 https://semianalysis.substack.com/p/tsmc-3nm-wafer-shipments-pushed-into, 14.10.2021

4 https://min.news/en/tech/def29226dea2b06f47efea4aae13e8f3.html, 22.01.2022

La Unión es fuerte en el diseño de componentes de semiconductores para electrónica de potencia, dispositivos de radiofrecuencia y analógicos, sensores y microcontroladores que tienen un uso generalizado en las industrias automovilística y manufacturera en la actualidad. Es menos fuerte en el diseño de la lógica digital (procesadores y memoria), que se hace esencial a medida que los datos, la IA y la conectividad están cada vez más generalizados.

Además, la Unión está muy bien situada en cuanto a los materiales y equipos necesarios para el funcionamiento de grandes fábricas de chips, y muchas empresas desempeñan un papel esencial a lo largo de la cadena de suministro. La Unión cuenta con sectores de usuarios industriales fuertes y diversificados, como los del automóvil, la automatización industrial, la asistencia sanitaria, la energía, la comunicación, etc. Sin embargo, la colaboración a lo largo de la cadena de valor es escasa.

La cuota de mercado global de la Unión en el mercado mundial de los semiconductores es del 10 % en valor económico[5], muy por debajo de su peso económico. A pesar de su fuerte posición global en la fabricación de materiales y equipos, la Unión depende en gran medida de proveedores de terceros países para el diseño, la fabricación, el empaquetado, los ensayos y el montaje de chips.

Hoy en día, los semiconductores están en el centro de grandes intereses geoestratégicos y en el núcleo de la carrera tecnológica mundial. Los países están ansiosos por asegurarse el suministro de los chips más avanzados, ya que ello condicionará su capacidad para actuar (económica, industrial y militarmente) e impulsar la transformación digital. Todas las principales regiones del mundo están realizando grandes inversiones y desplegando medidas de apoyo para innovar y reforzar sus capacidades teóricas de producción.

La Unión tiene los activos necesarios para convertirse en un líder industrial en el mercado de chips del futuro. Su ambición es duplicar su cuota de producción mundial hasta el 20 % en valor económico de aquí a 2030[6]. El objetivo no es solo reducir la dependencia, sino también aprovechar las oportunidades económicas, ya que se espera que el mercado mundial de semiconductores se duplique antes de finales de la década, lo que aumentará la competitividad del ecosistema de los semiconductores y de la industria en general, a través de productos innovadores para los ciudadanos europeos.

Están surgiendo nuevas tendencias y oportunidades de mercado. Cada vez es más frecuente que las empresas de semiconductores diseñen chips personalizados junto con empresas de usuarios finales con el fin de mejorar el rendimiento del sistema a través de la optimización del *hardware* y el *software*. La IA, la computación en el borde de la nube («edge cloud») y la digitalización de los sectores industriales ofrecen nuevas oportunidades para la competitividad de la tecnología y el liderazgo industrial europeos en el futuro.

Al mismo tiempo, la tecnología evoluciona de manera constante. La miniaturización sigue avanzando hacia unas dimensiones de nodo más pequeñas en las principales tecnologías de fabricación (FinFET y FDSOI) en consonancia con la ley de Moore[7], mientras que existe una gran demanda de soluciones más eficientes desde el punto de vista energético para garantizar

---

[5] *Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an uncertain era*, BCGxSIA, Abril 2021. https://www.bcg.com/publications/2021/strengthening-the-global-semiconductor-supply-chain

[6] La Brújula Digital estableció como objetivo que, para 2030, «la producción de semiconductores de vanguardia y sostenibles en Europa, incluidos los procesadores, suponga al menos el 20 % de la producción mundial en valor» (COM(2021) 118 de 9.3.2021). La propuesta de programa de política «Itinerario hacia la Década Digital» para 2030 ha reafirmado dicha ambición (véase la nota a pie de página n.º 15).

[7] La ley de Moore establece que el número de transistores en un circuito integrado se duplica cada dos años aproximadamente.

que la huella de carbono, cada vez mayor, siga siendo sostenible. Los paradigmas emergentes de computación, como la computación neuromórfica y las tecnologías cuánticas, son tecnologías prometedoras para nuevos ámbitos de aplicación. Los nuevos materiales, como el carburo de silicio (SiC) y el nitruro de galio (GaN), son esenciales para la gestión de la energía, por ejemplo, para garantizar un uso óptimo de la energía de las baterías, en particular de los vehículos eléctricos de todo tipo, y para generar energía renovable.

La presente exposición de motivos acompaña a la propuesta de **Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores (Ley de Chips)**.

La presente propuesta responde al compromiso político de la presidenta Von der Leyen, que en su discurso sobre el estado de la Unión de 2021 anunció que el objetivo es crear conjuntamente un ecosistema de chips europeo de última generación que incluya su fabricación[8]. La propuesta contiene una visión estratégica subyacente que tiene como objetivo reforzar el ecosistema de semiconductores europeo, y que se describe en la Comunicación[9] que la acompaña.

Para hacer realidad esta visión, la Estrategia Europea de Chips se articula en torno a cinco objetivos estratégicos:

- Europa deberá reforzar su liderazgo en materia de investigación y tecnología;
- Europa deberá desarrollar y reforzar su capacidad propia para innovar en el diseño, la fabricación y el empaquetado de chips avanzados y convertirlos en productos comerciales;
- Europa deberá establecer un marco adecuado para aumentar sustancialmente su capacidad efectiva de producción de aquí a 2030;
- Europa deberá hacer frente a la grave escasez de capacidades, atraer nuevos talentos y apoyar la aparición de trabajadores cualificados;
- Europa deberá desarrollar una comprensión profunda de las cadenas mundiales de suministro de semiconductores.

La propuesta tiene por objeto alcanzar el objetivo estratégico de aumentar la resiliencia del ecosistema europeo de semiconductores e incrementar su cuota de mercado mundial. También busca facilitar la rápida adopción de nuevos chips por parte de la industria europea y aumentar su competitividad. Para ello, es necesario atraer inversiones destinadas a instalaciones de producción innovadoras, contar con trabajadores cualificados, pero también estar en condiciones de diseñar y producir los chips más avanzados que definirán los mercados del mañana, desarrollar capacidades y poder probar diseños innovadores, y desarrollar sus prototipos, a través de líneas piloto en estrecha colaboración con sus sectores verticales industriales. Se trata de medidas necesarias, pero no suficientes, a menos que la Unión cuente con la capacidad analítica necesaria para aumentar sus conocimientos sobre los responsables políticos de la cadena de valor y pueda beneficiarse de una mayor capacidad para servir al interés común del mercado único en caso de crisis. El objetivo no es ser autosuficientes, ya que ese es un objetivo inalcanzable. Debemos reforzar y ampliar nuestros puntos fuertes y trabajar con terceros países en una cadena de suministro en la que las interdependencias sigan siendo sólidas.

En cuanto a la consecución de estos objetivos, la propuesta tendrá por objeto:

---

[8] Discurso sobre el estado de la Unión 2021. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu_2021_address_es_0.pdf

[9] COM(2022) 45, de 8.2.2022. Ley Europea de Chips.

- **Crear la iniciativa Chips para Europa** con el propósito de apoyar el desarrollo de capacidades tecnológicas y la innovación a gran escala en toda la Unión a fin de permitir el desarrollo y la implantación de tecnologías cuánticas y de semiconductores de vanguardia y de próxima generación que refuercen en la Unión el diseño avanzado, la integración de sistemas, las capacidades teóricas de producción de chips y las correspondientes destrezas, y se preste especial atención a las empresas emergentes y en expansión (pilar 1, «Iniciativa Chips para Europa»).

En particular, la iniciativa desarrollará una plataforma innovadora de diseño virtual para reforzar la capacidad de diseño de Europa, que será accesible de manera abierta, no discriminatoria y transparente. La plataforma impulsará una amplia cooperación de las comunidades de usuarios con las grandes empresas, empresas emergentes y pymes dedicadas al diseño de microprocesadores, con proveedores de propiedad intelectual (PI) y de herramientas, con diseñadores y organizaciones de investigación y tecnología, e integrará las instalaciones de diseño nuevas y ya existentes con bibliotecas ampliadas y herramientas de automatización del diseño EDA[10].

La iniciativa apoyará líneas piloto que permitirán a terceros probar, validar y seguir desarrollando sus diseños de productos, todo ello de manera abierta, transparente y no discriminatoria. El desarrollo de nuevas líneas piloto avanzadas preparará la próxima generación de capacidades teóricas de producción y su validación.

Además, la iniciativa contribuirá a aumentar la capacidad tecnológica y de ingeniería avanzadas para acelerar el desarrollo innovador de chips cuánticos, por ejemplo, mediante bibliotecas de diseño para chips cuánticos, líneas piloto e instalaciones para ensayos y experimentación.

La iniciativa apoyará una red de centros de competencia en toda la Unión que proporcionará conocimientos especializados a las partes interesadas, incluidos los usuarios finales como las pequeñas y medianas empresas (pymes), las empresas emergentes y los sectores verticales, y mejorará sus capacidades. Estos centros de competencia facilitarán un acceso abierto, transparente y no discriminatorio a la infraestructura de diseño y las líneas piloto, y su uso efectivo. Se convertirán en polos de atracción para la innovación y el talento nuevo altamente cualificado.

Además de la iniciativa, las actividades que se desarrollen para facilitar el acceso a la financiación mediante deuda y capital en la cadena de valor de los semiconductores -que se describirán de manera conjunta como el «Fondo de Chips»- deberán apoyar el desarrollo de un ecosistema de semiconductores dinámico y resiliente, permitiendo aumentar la disponibilidad de fondos para financiar el crecimiento de las empresas emergentes y en expansión y las pymes, así como de inversiones a lo largo de toda la cadena de valor, también para las empresas de la cadena de valor de los semiconductores, posiblemente con financiación mixta proporcionada por la propia iniciativa.

- **Crear un marco para garantizar la seguridad del suministro** atrayendo inversiones y mejorando las capacidades efectivas de producción en la fabricación de semiconductores, así como en el empaquetado, los ensayos y el montaje avanzados a través de instalaciones de producción integrada y fundiciones abiertas de la UE pioneras (pilar 2, «Seguridad del suministro»).

[10] Herramientas de automatización del diseño electrónico («Electronic Design Automation»), es decir, herramientas informáticas para diseñar circuitos integrados.

En particular, la propuesta define los criterios para facilitar la ejecución de proyectos específicos que contribuyan a la seguridad del suministro de semiconductores en la Unión. A tal fin, distingue entre dos tipos de instalaciones pioneras[11], a saber, las instalaciones de producción integrada y las fundiciones abiertas de la UE[12]. Cuando una solicitud presentada por una instalación para que se le reconozca como uno de los dos tipos de instalaciones pioneras sea satisfactoria, la propuesta exige a los Estados miembros que garanticen la tramitación eficiente de las solicitudes administrativas relacionadas con la planificación, la construcción y el funcionamiento de una instalación pionera reconocida.

En respuesta a la creciente necesidad de cadenas de suministro ciberresilientes[13], la Comisión trabajará con los Estados miembros y los agentes privados con el fin de determinar requisitos sectoriales para los chips confiables con vistas a establecer normas y certificaciones comunes, así como requisitos comunes para la contratación pública, que se desarrollarán con el apoyo de las organizaciones europeas de normalización cuando proceda y teniendo en cuenta los principios del nuevo marco legislativo para la evaluación de la conformidad y la vigilancia del mercado.

- **Establecer un mecanismo de coordinación entre los Estados miembros y la Comisión** con el fin de reforzar la colaboración con los Estados miembros y entre ellos, supervisar el suministro de semiconductores, estimar la demanda, anticipar las penurias, iniciar la activación de una fase de crisis y actuar a través de un conjunto de medidas específicas (pilar 3, «Seguimiento y respuesta a las crisis»).

- **Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial**

La presente propuesta es coherente con la visión, los objetivos y las vías generales de la Comisión para lograr la transformación digital exitosa de la Unión Europea de aquí a 2030, tal como se presenta en la Comunicación de la Comisión «Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital» («Comunicación sobre la Brújula Digital»)[14] y la posterior propuesta de la Comisión relativa al programa de política de la Década Digital[15], con el objetivo específico de los semiconductores. La presente propuesta tiene por objeto contribuir a dotar a la Unión de las capacidades necesarias para cumplir su objetivo de 2030.

---

[11] «Instalación pionera»: instalación industrial capaz de producir semiconductores, que incluye la etapa de fabricación o la etapa empaquetado, ensamblado y prueba, o ambas, que aún no está presente de forma sustancial o sobre cuya construcción en la Unión aún no hay compromiso alguno, por ejemplo en lo que se refiere al nodo tecnológico, el material de sustrato (como el carburo de silicio y el nitruro de galio), y otra innovación de productos que permita ofrecer mejores prestaciones, innovar los procesos y mejorar el rendimiento energético y el comportamiento medioambiental.

[12] Las instalaciones de producción integrada son instalaciones pioneras de diseño y producción de semiconductores, que incluyen la etapa de fabricación o la etapa empaquetado, ensamblado y prueba, o ambas, que están situadas en la Unión y que contribuyen a la seguridad del suministro destinado al mercado interior. Las fundiciones abiertas de la UE son instalaciones pioneras de producción de semiconductores, que incluyen la etapa de fabricación o la etapa empaquetado, ensamblado y prueba, o ambas, que están situadas en la Unión y que ofrecen capacidad efectiva de producción a empresas no vinculadas, favoreciendo así la seguridad del suministro destinado al mercado interior.

[13] El 31 % de los ciberataques registrados en 2020 se dirigieron a la UE. https://www.ibm.com/security/data-breach/threat-intelligence

[14] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital», COM(2021) 118, de 9.3.2021.

[15] COM(2021) 574 final. Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el programa de política «Itinerario hacia la Década Digital» para 2030. 15.9.2021.

La presente propuesta es coherente con la Comunicación de la Comisión «Actualización del nuevo modelo de industria de 2020»[16], de mayo de 2021, que señala los ámbitos de dependencias estratégicas que podrían dar lugar a vulnerabilidades como la escasez de suministro. La propuesta aborda los retos en materia de diseño, fabricación, empaquetado, ensayos y montaje señalados en la Comunicación y en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña. Dicha Comunicación anunció la Alianza industrial sobre tecnologías de procesadores y semiconductores («la Alianza»)[17] para determinar las lagunas en la producción de microchips y los avances tecnológicos necesarios para que las empresas y organizaciones prosperen, ayuden a la competitividad de las empresas, refuercen la soberanía digital de Europa y hagan frente a la demanda de la próxima generación de chips y procesadores seguros, eficientes desde el punto de vista energético y potentes. En el contexto del presente Reglamento, la Alianza desempeñará una función consultiva.

La presente propuesta es también coherente con la estrategia de normalización[18] de la Comisión y con el programa de trabajo anual de la Unión sobre normalización europea para 2022[19], que se adoptaron el 2 de febrero de 2022. La estrategia y el programa de trabajo contemplan el desarrollo de normas para la certificación de la seguridad, autenticidad y fiabilidad de los chips.

Asimismo, la presente propuesta tiene en cuenta los objetivos del Observatorio de Tecnologías Críticas[20], que pretende contribuir a detectar las dependencias estratégicas digitales de la Unión, tanto las actuales como las posibles en el futuro, y contribuir a reforzar su soberanía digital.

La presente propuesta aborda los retos únicos y específicos del sector de la cadena de suministro de semiconductores y es una iniciativa independiente del «Instrumento de Emergencia del Mercado Único» previsto por la Comisión en su estrategia industrial actualizada.

La presente propuesta contribuye a la aplicación de la Declaración sobre una iniciativa europea en materia de tecnologías de procesadores y semiconductores, suscrita por 22 Estados miembros el 7 de diciembre de 2020[21]. En dicha Declaración, los 22 Estados miembros acordaron «hacer un esfuerzo especial para reforzar el ecosistema de semiconductores y ampliar la presencia industrial en toda la cadena de suministro». Los Estados miembros también acordaron «trabajar en pro de normas comunes y, en su caso, de certificaciones para la electrónica confiable, así como de requisitos comunes para la adquisición de chips seguros y sistemas empotrados en aplicaciones que dependan de la tecnología de chips o hagan un uso amplio de la misma». La presente propuesta es coherente con todos estos objetivos.

Además, la propuesta está en consonancia con la reciente Comunicación «Una política de competencia adaptada a los nuevos retos», en la que la Comisión reconoce que puede «prever

---

[16] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: Creación de un mercado único más sólido para la recuperación de Europa» COM(2021) 350 final.

[17] La Comisión puso en marcha la Alianza industrial sobre tecnologías de procesadores y semiconductores en julio de 2021. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/alliance-processors-and-semiconductor-technologies.

[18] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Estrategia de la UE en materia de normalización. Establecer normas mundiales para apoyar un mercado único de la Unión resiliente, ecológico y digital», COM(2022) 31.

[19] C(2022) 546 Comunicación de la Comisión — Programa de trabajo anual de la Unión sobre normalización europea para 2022.

[20] COM(2021) 70, Plan de Acción sobre sinergias entre las industrias civil, de defensa y espacial.

[21] Declaración conjunta sobre tecnologías de procesadores y semiconductores. 7 de diciembre de 2020.

la aprobación de ayudas públicas para colmar posibles lagunas de financiación en el ecosistema de semiconductores para el establecimiento, en particular, de instalaciones europeas pioneras en la Unión, sobre la base del artículo 107, apartado 3, del TFUE. Estas ayudas tendrían que estar sujetas a sólidas salvaguardias para garantizar que las ayudas son necesarias, adecuadas y proporcionadas, que se reducen al mínimo las distorsiones indebidas de la competencia y que los beneficios se reparten ampliamente y sin discriminación en toda la economía europea».[22]

La iniciativa Chips para Europa mancomunará recursos de la Unión, de los Estados miembros y de terceros países asociados a los programas existentes de la Unión, así como del sector privado.

Las acciones en el marco de la iniciativa Chips para Europa se ejecutarán principalmente a través de la Empresa Común de Chips, es decir, la actual Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave, modificada y con una nueva denominación[23]. Dicha empresa común brinda actualmente un amplio apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación impulsados por la industria en el ámbito de los componentes y sistemas electrónicos, así como de los correspondientes programas informáticos y tecnologías de sistemas. Estas actividades formarán parte de la iniciativa Chips para Europa.

La iniciativa Chips para Europa se basa en los cinco objetivos específicos del programa Europa Digital (PED)[24] y los complementa. Estos objetivos apoyan el desarrollo de capacidades digitales en los ámbitos digitales clave en los que la tecnología de semiconductores aporta mejoras de rendimiento, como la informática de alto rendimiento, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, así como el desarrollo de capacidades y la implantación de centros de innovación digital. A través del nuevo objetivo específico 6, que debería centrarse temáticamente en las tecnologías de semiconductores, la iniciativa Chips para Europa invertirá en el desarrollo de capacidades con el fin de reforzar las capacidades de integración avanzadas de la investigación, el diseño, la producción y los sistemas en tecnologías de semiconductores de vanguardia y de próxima generación.

La iniciativa Chips para Europa también se basa en el programa Horizonte Europa[25] y lo complementa. En el ámbito de los semiconductores, dicho programa brinda apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación impulsados por el mundo académico. La iniciativa se centrará en apoyar la inversión en infraestructuras de investigación, desarrollo e innovación transfronterizas y de acceso abierto establecidas en la Unión para permitir el desarrollo de tecnologías de semiconductores en toda Europa. Las nuevas tecnologías de semiconductores derivadas de acciones de investigación e innovación apoyadas por Horizonte Europa podrán ser progresivamente asumidas e implantadas por la parte de la iniciativa Chips

---

[22] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una política de competencia adaptada a los nuevos retos, COM(2021) 713, 18 de noviembre de 2021.

[23] Reglamento (UE) 2021/2085 del Consejo, de 19 de noviembre de 2021, por el que se establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 219/2007, (UE) n.º 557/2014, (UE) n.º 558/2014, (UE) n.º 559/2014, (UE) n.º 560/2014, (UE) n.º 561/2014 y (UE) n.º 642/2014 (DO L 427 de 30.11.2021, p. 17.)

[24] Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se establece el Programa Europa Digital y por el que se deroga la Decisión (UE) 2015/2240 (DO L 166 de 11.5.2021, p. 1).

[25] Reglamento (UE) n.º 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa», se establecen sus normas de participación y difusión, y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1290/2013 y (UE) n.º 1291/2013 (DO L 170 de 12.5.2021, p. 1).

para Europa correspondiente al desarrollo de capacidades. En cambio, las capacidades tecnológicas de la iniciativa se pondrán a disposición de la comunidad de investigación e innovación, incluidas las acciones que reciban apoyo a través de Horizonte Europa.

La presente propuesta se presenta a la luz de las oportunidades que ofrece el programa InvestEU[26] y de la importante contribución a la transformación digital del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia[27], en virtud del cual al menos el 20 % de los fondos debe contribuir a los objetivos digitales. La presente propuesta también es coherente con la Estrategia para una Unión de la Seguridad[28].

Con el fin de acelerar la ejecución de las acciones, la iniciativa Chips para Europa establece un nuevo instrumento jurídico, el Consorcio Europeo de Infraestructuras de Chips (CEIC), que se desarrolla específicamente para simplificar y estructurar las relaciones jurídicas entre los miembros del consorcio público-privado, en particular las organizaciones de investigación y tecnología, y para mantener un diálogo estructural con la Comisión con vistas a ejecutar las acciones de la iniciativa. Este nuevo instrumento jurídico tiene carácter voluntario y complementará al conjunto de instrumentos jurídicos de la Unión, incluido el Consorcio Europeo de Infraestructuras Digitales[15], que permiten combinar la financiación de los Estados miembros, el presupuesto de la Unión y las inversiones privadas. Las entidades jurídicas, cuando formen un consorcio público-privado a efectos de la ejecución de las acciones de la iniciativa, tendrán la posibilidad de elegir entre los instrumentos jurídicos de la Unión disponibles que mejor se ajusten al objetivo específico, la composición y la configuración de un consorcio concreto. La Empresa Común de Chips a la que se haya encomendado la ejecución global de determinadas acciones en el marco de dicha iniciativa podrá establecer, en virtud de las condiciones que se establecen en el artículo 134 de la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (UE) 2021/2085, por el que se establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa, en lo que respecta a la Empresa Común de Chips[29], que determinadas acciones solo puedan llevarse a cabo por aquellas entidades jurídicas que cooperen en el marco de un consorcio que pueda estructurarse en forma de Consorcio Europeo de Infraestructuras de Chips, o cualquier otro instrumento jurídico de la Unión que permita formar un consorcio.

- **Coherencia con otras políticas de la Unión**

Las medidas propuestas pueden fomentar algunas de las principales políticas de la Unión, como el Pacto Verde[30]. La aplicación de tecnologías de semiconductores y de tecnologías digitales en general contribuyen en gran medida a la transición hacia la sostenibilidad y pueden dar lugar a nuevos productos y formas de trabajo más eficientes y eficaces que contribuyan a los objetivos del Pacto Verde.

Las perturbaciones en el suministro de semiconductores y las dependencias de otras regiones pueden ralentizar la transición hacia la sostenibilidad de los sectores europeos que se benefician de soluciones digitales. A fin de hacer frente a dichas perturbaciones y dependencias, la propuesta refuerza la capacidad efectiva de producción de semiconductores

---

[26] Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 2021, por el que se establece el Programa InvestEU y se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017 (DO L 107 de 26.3.2021, p. 30).

[27] Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17).

[28] Comunicación sobre la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad. COM(2020) 605 final.

[29] COM(2022) 47, de 8.2.2022.

[30] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: El Pacto Verde Europeo. COM(2019) 640, de 11.12.2019.

de Europa. Cuando proceda, las instalaciones deberán cumplir plenamente los requisitos derivados de la legislación de la Unión, como las evaluaciones de impacto ambiental, o los requisitos relativos a las emisiones a la atmósfera, el agua y el suelo, incluida la prevención de riesgos y accidentes industriales, y deberán tratar de garantizar un alto nivel de eficiencia energética, hídrica y de los recursos. Para reforzar la capacidad efectiva de producción es necesario crear instalaciones de fabricación de semiconductores rápidamente. Excepcionalmente, cuando sea necesario, dichas instalaciones podrán considerarse de interés público superior a la hora de establecer excepciones en los procedimientos de concesión de autorizaciones, también en determinadas evaluaciones medioambientales, siempre que se cumplan las demás condiciones establecidas en las disposiciones pertinentes. Al mismo tiempo, el concepto de «instalación pionera» incluye una posible calificación basada en el rendimiento energético o medioambiental previsto de la instalación.

Las tecnologías digitales, tanto cuando se fabrican como cuando se utilizan, generan su propia huella ambiental, en particular debido a la liberación de gases fluorados de efecto invernadero durante la fabricación y al consumo de energía significativo que conllevan su producción y su uso. El sector de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) representa entre el 5 % y el 9 % del consumo total de electricidad del mundo y más del 2 % de todas las emisiones[31]. En 2018, los centros de datos, por sí solos, representaban el 2,7 % de la demanda de electricidad en la Unión y, si la trayectoria actual se mantiene, alcanzarán el 3,21 % en 2030[32]. Este consumo de energía debe reducirse. La propuesta, y en particular la creación de instalaciones de diseño y líneas piloto en el marco del pilar 1, dará lugar al diseño, los ensayos y la validación de nuevos procesadores de bajo consumo. Los procesadores son los componentes básicos de los servidores que gestionan la carga de trabajo computacional en los centros de datos. Los centros de datos de mayor tamaño contienen millones de estos servidores, y las mejoras en el consumo de energía de los procesadores pueden tener una incidencia significativa en el consumo total de energía de un centro de datos. Estos chips que generan una huella energética baja también contribuyen a situar a la Unión como líder en tecnologías digitales sostenibles.

La propuesta contribuye a los objetivos de las partes del paquete de medidas «Objetivo 55» centradas en la promoción tecnológicamente neutra de vehículos y combustibles más limpios[33]. La revisión de las normas de emisión de CO_2 para turismos y furgonetas nuevos tiene por objeto seguir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero de estos vehículos, estableciendo una trayectoria clara y realista hacia una movilidad sin emisiones. La demanda de los consumidores en favor de vehículos de emisión cero, como los vehículos eléctricos recargables, ya está aumentando[34]. Los vehículos eléctricos recargables suelen tener más del doble de semiconductores por vehículo que los automóviles con motores de combustión interna[35]. Las tecnologías avanzadas de empaquetado son cada vez más

---

[31] Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética (versión refundida). COM(2021) 558, de 14.7.2021.

[32] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market

[33] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. «Objetivo 55»: cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática. COM(2021) 550, de 14.7.2021.

[34] Por ejemplo, la proporción de coches eléctricos en las ventas de coches nuevos en Europa está aumentando y se espera que alcance el 14 % en 2021. https://think.ing.com/articles/slow-start-for-electric-vehicles-in-the-us-but-times-are-changing

[35] https://www.idtechex.com/en/research-article/ev-power-electronics-driving-semiconductor-demand-in-a-chip-shortage/24820

importantes a la hora de responder ante los crecientes requisitos de potencia y eficiencia energética de los vehículos eléctricos. De todo ello se deduce que la propuesta es coherente con los objetivos del paquete «Objetivo 55».

La propuesta está en consonancia con el Plan de acción para la economía circular[36], que señala a la electrónica y las TIC como una cadena de valor clave y anuncia una Iniciativa sobre la Electrónica Circular que abarca «medidas reguladoras en los sectores de la electrónica y las TIC (incluidos los teléfonos móviles, las tabletas y los ordenadores portátiles) conforme a la Directiva sobre diseño ecológico, de forma que los dispositivos estén diseñados con los criterios de eficiencia energética y de durabilidad, reparabilidad, actualizabilidad, mantenimiento, reutilización y reciclado».

Si los productos electrónicos se mantienen en uso durante más tiempo mediante un diseño que favorezca la durabilidad y la mejora de los servicios, las tasas de sustitución y la necesidad de productos nuevos se verán reducidas. Los materiales que componen los microchips pueden recuperarse a partir de residuos electrónicos. Por ejemplo, es técnicamente posible reciclar materiales de semiconductores compuestos, aunque actualmente solo en cantidades muy pequeñas. La iniciativa sobre productos sostenibles, centrada en ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico, proporcionará un posible instrumento para alcanzar estos objetivos. La Comisión también está estudiando posibles sistemas de recogida y venta para la electrónica de consumo, a fin de impulsar el suministro de dispositivos usados que funcionen.

Con el aumento de la digitalización y la electrificación, los chips eficientes desde el punto de vista energético también contribuyen a otras políticas, en particular a las relativas a la fabricación industrial, el transporte y la energía como, por ejemplo, el próximo plan de acción para la digitalización del sector de la energía[37]. Se espera que la demanda de tecnologías de semiconductores se duplique en una década. Cada vez hay más chips integrados en robots y máquinas de fabricación, en la industria y en la agricultura, pero también en vehículos de transporte y otros dispositivos. La propuesta tiene por objeto fomentar el uso inteligente de chips y otras tecnologías digitales, así como la producción de chips más eficientes desde el punto de vista energético, por lo que es coherente con varias políticas sectoriales y contribuye a su aplicación.

2. BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

• Base jurídica

El presente Reglamento persigue dos objetivos específicos distintos, que constituyen partes esenciales de su objetivo general de establecer un marco coherente con el fin de reforzar el ecosistema de semiconductores de la Unión. El primer objetivo específico del Reglamento, en el marco del pilar 1, es crear amplias capacidades de innovación y las competencias tecnológicas adecuadas en la industria de semiconductores necesarias para acelerar la innovación y adaptarse a ella. Además, en el marco de los pilares 2 y 3, el Reglamento tiene por objeto aumentar la resiliencia y la seguridad del suministro de la Unión en el ámbito de las tecnologías de semiconductores apoyando y coordinando las inversiones en la fabricación de semiconductores avanzados (pilar 2) y permitiendo el seguimiento coordinado y la respuesta a las crisis (pilar 3).

---

36 COM(2020) 98 final, de 11.3.2020.

37 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Plan-de-accion-de-la-UE-para-la-digitalizacion-del-sector-de-la-energia_es

La base jurídica para este primer objetivo son el artículo 173, apartado 3, el artículo 182, apartado 1, y el artículo 183 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El artículo 173, apartado 3, establece que el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social Europeo, podrán tomar medidas específicas destinadas a apoyar las acciones que se lleven a cabo en los Estados miembros a fin de garantizar la existencia de las condiciones necesarias para la competitividad y la capacidad de innovación de la Unión, así como la adaptación de la industria a los cambios estructurales debidos a ciclos rápidos de innovación. Esta base jurídica es adecuada para la mayoría de las actividades emprendidas en el marco de la iniciativa, dado que el pilar 1 del presente Reglamento tiene por objeto acelerar la producción de semiconductores por parte de la industria de la Unión, reforzar la soberanía en la cadena de suministro de semiconductores, impulsar las capacidades industriales, facilitar el desarrollo de empresas emergentes y pymes innovadoras, y fomentar nuevas inversiones en innovación y desarrollo tecnológico. Habida cuenta de la amplitud de la iniciativa, esta también se basa en el título del TFUE «Investigación y desarrollo tecnológico y espacio» (artículo 182, apartado 1, y artículo 183).

La base jurídica adecuada para el segundo objetivo, en el marco de los pilares 2 y 3, es el artículo 114 del TFUE. Los pilares 2 y 3 de la presente propuesta tienen por objeto crear un marco jurídico armonizado a fin de aumentar la resiliencia y la seguridad del suministro de la Unión. El uso de semiconductores es fundamental para múltiples sectores económicos y funciones sociales en la Unión, por lo que un suministro resiliente es esencial para el funcionamiento del mercado interior. Así pues, cualquier perturbación del suministro debe anticiparse y solucionarse sin demora con el fin de preservar el funcionamiento estable de los sectores estratégicos descendentes. A la luz del importante impacto económico de la actual escasez de semiconductores, es probable que los Estados miembros pongan en marcha medidas reguladoras para hacer frente a las vulnerabilidades estructurales del sector que han llevado a la penuria actual, o para responder a futuras penurias en situaciones de crisis y mitigarlas[38]. Si bien serían adecuadas para subsanar las deficiencias a nivel nacional, dichas medidas reguladoras podrían implicar una respuesta incoherente con la necesidad de reforzar la resiliencia y de hacer frente a posibles crisis en el mercado interior, lo que daría lugar a la fragmentación del sector. Para poder adoptar medidas coordinadas con vistas a aumentar la resiliencia, se necesitan unas normas armonizadas que faciliten la ejecución de proyectos específicos que contribuyan a la seguridad del suministro de semiconductores en la Unión (pilar 2). El mecanismo de seguimiento y respuesta a las crisis propuesto (pilar 3) debe ser uniforme para permitir un enfoque coordinado de la preparación frente a las crisis para la cadena de valor transfronteriza de los semiconductores. La propuesta establece la estructura de gobierno y la cooperación adecuadas entre los Estados miembros a escala de la Unión, apoyando así la confianza, la innovación y el crecimiento en el mercado interior. Por lo tanto, el artículo 114 del TFUE constituye una base jurídica pertinente para los pilares 2 y 3 a fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior.

Ningún otro artículo del TFUE, ni ningún artículo por sí solo, puede servir para justificar los dos objetivos mencionados. El artículo 122 del TFUE no es pertinente, ya que no proporciona una base para los dos objetivos y no es compatible con el artículo 114 ni con el artículo 173 del TFUE. Los elementos propuestos figuran en un único acto, ya que todas las medidas constituyen un enfoque coherente con el que abordar, de diferentes maneras, la necesidad de reforzar el ecosistema de semiconductores de la Unión.

---

[38] Por ejemplo, se ha anunciado que España tiene la intención de reformar su Ley de Seguridad Nacional en este sentido.

- **Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)**

Los Estados miembros no pueden alcanzar por sí solos los objetivos de la propuesta, ya que los problemas son de carácter transfronterizo y no se limitan a un solo Estado miembro o a un subconjunto de Estados miembros. Las acciones propuestas se centran en ámbitos en los que existe un valor añadido demostrable en la actuación a escala de la Unión debido a la magnitud, velocidad y alcance de los esfuerzos necesarios.

Para ofrecer una respuesta global a la crisis de los semiconductores es necesaria una acción conjunta rápida y coordinada llevada a cabo por diversas partes interesadas, en cooperación con los Estados miembros. Ningún Estado miembro puede conseguirlo por sí solo. Además, debido a la complejidad del ecosistema de semiconductores, las consecuencias de las dependencias estructurales de la Unión y de la escasez de suministro son de tal magnitud que una intervención a nivel de la Unión es lo más adecuado para hacerles frente.

Resulta evidente que una actuación a nivel de la Unión puede orientar mejor a los agentes europeos hacia una visión y una estrategia de aplicación comunes. Esto resulta fundamental para generar economías de escala y de alcance, así como la masa crítica necesaria para unas capacidades de vanguardia, con lo que se limita (o evita) la fragmentación de los esfuerzos, las competiciones por conseguir subvenciones y unas soluciones nacionales que distan de ser óptimas.

La acción de la Unión es necesaria en relación con los ámbitos que la presente propuesta aborda a través de sus tres pilares.

- Por lo que se refiere al primer pilar («Iniciativa Chips para Europa»), la iniciativa apoyará el desarrollo de capacidades tecnológicas y la innovación tecnológica a gran escala a través de la Unión para permitir el desarrollo y la implantación de tecnologías de semiconductores y cuánticas de vanguardia y de próxima generación y para subsanar las deficiencias estructurales crónicas de Europa en el diseño y la producción. En 2018, los Estados miembros crearon un primer «proyecto importante de interés común europeo» (PIICE), que prestó apoyo a proyectos innovadores transfronterizos en toda la cadena de valor de la microelectrónica, y se está preparando un segundo PIICE en este ámbito[39]. Aunque estas iniciativas son de importancia estratégica para el sector, en esta fase es probable que, por sí solas, no aborden suficientemente el desarrollo de capacidades en forma de líneas piloto y de diseño de infraestructuras que deberán ponerse a disposición de todas las terceras partes interesadas en toda Europa y que también permitirán a la Unión desempeñar un papel más importante en un ecosistema global e interdependiente. Debido a la magnitud de las inversiones y los conocimientos técnicos necesarios, estas instalaciones de gran escala solo pueden llevarse a cabo a nivel de la Unión.
- Por lo que respecta al segundo pilar («Seguridad del suministro»), las medidas destinadas a acelerar la inversión en la fabricación de semiconductores solo pueden diseñarse y aplicarse adecuadamente a escala de la Unión, debido a la magnitud de las inversiones necesarias y a que dichas instalaciones de producción, por definición, servirán a todo el mercado interior, reforzarán todo el ecosistema y garantizarán la seguridad del suministro en situaciones de crisis.

[39] Cuatro Estados miembros (Francia, Alemania, Italia y Austria) y el Reino Unido participaron en el primer PIICE. El PIICE cuenta con 32 empresas, con una ayuda pública de 1 900 millones EUR y una contribución por parte de la industria de aproximadamente 6 000 millones EUR.

- En relación con el tercer pilar («Seguimiento y respuesta a las crisis»), la cooperación reforzada de la Unión garantizará la recopilación de información necesaria y contrastable. Juntos, los Estados miembros y la Comisión podrán anticipar las penurias, activar la fase de crisis en una situación de penuria grave y poner en marcha las medidas necesarias para hacer frente a las crisis de manera más eficaz que mediante un mosaico de medidas nacionales.

- **Proporcionalidad**

La propuesta tiene por objeto reforzar el ecosistema europeo de semiconductores a través de: la preparación y el seguimiento a corto plazo para aumentar la transparencia de las cadenas de suministro de semiconductores; acciones a medio plazo en materia de seguridad del suministro con el fin de aumentar la capacidad efectiva de producción de semiconductores en Europa; y acciones de liderazgo en tecnología e innovación a más largo plazo para crear instalaciones de diseño y producción de tecnologías avanzadas y emergentes de semiconductores.

En este contexto, la propuesta se centra en las partes del ecosistema de semiconductores que más contribuyen a la resiliencia de la cadena de suministro de la Unión. La propuesta se centra en el propio ecosistema de semiconductores, más que en el ámbito más amplio de los componentes y sistemas electrónicos, o en los ámbitos de aplicación que utilizan semiconductores o componentes y sistemas electrónicos, con el fin de limitar las acciones a uno de los asuntos actuales más cruciales y críticos para la economía y la sociedad europeas en general.

La iniciativa Chips para Europa (pilar 1) establece los mecanismos necesarios para garantizar la competitividad y la capacidad de innovación a largo plazo de la industria europea a través de capacidades de investigación y diseño, líneas piloto para ensayos y experimentación, capacidades para chips cuánticos, centros de competencia y un fondo para empresas emergentes, empresas en expansión y pymes.

Las acciones en materia de seguridad del suministro para mejorar la capacidad efectiva de producción de semiconductores de la Unión, previstas en el pilar 2, pueden reconocer a una instalación determinada como instalación de producción integrada o como fundición abierta de la UE. Una vez concedido dicho reconocimiento, los Estados miembros deberán garantizar que los permisos para dichas instalaciones y fundiciones se concedan mediante procedimientos rápidos.

Las acciones de preparación previstas en el pilar 3 se basan en el seguimiento y el intercambio de información por parte de los Estados miembros y la Unión para anticipar las perturbaciones en la cadena de suministro. En caso de perturbaciones (anticipadas), podrán adoptarse medidas coordinadas dirigidas a mitigar o prevenir la escasez de semiconductores y otras perturbaciones.

- **Elección del instrumento**

La propuesta adopta la forma de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo. Este es el instrumento jurídico más adecuado para el pilar 1 de la propuesta por la que se establece la iniciativa «Chips para Europa», ya que solo un Reglamento, con sus disposiciones jurídicas directamente aplicables, puede proporcionar el grado de uniformidad necesario para la creación y el funcionamiento de una iniciativa de la Unión destinada a apoyar un sector industrial en todo el mercado interior. La elección de un Reglamento como instrumento jurídico para el pilar 2 se justifica por la necesidad de aplicar las nuevas normas de manera uniforme, en particular la definición de instalaciones de producción integrada y fundiciones abiertas de la UE, así como de contar con un procedimiento uniforme para su reconocimiento

y apoyo. Además, un Reglamento es el instrumento jurídico más adecuado para el pilar 3, ya que esta parte deberá establecer un mecanismo para anticipar y abordar las perturbaciones graves del suministro de semiconductores en la Unión. Dicho mecanismo no requiere medidas nacionales de transposición y es directamente aplicable.

3. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

• Consultas con las partes interesadas

En su discurso en el Foro Económico Mundial de enero de 2022, la presidenta Von der Leyen afirmó: «propondremos nuestra Ley Europea de Chips a principios de febrero, [...] no tenemos tiempo que perder»[40]. Las economías líderes están muy interesadas por asegurar el suministro de los chips más avanzados a sus países, ya que se trata de un asunto que condiciona cada vez más su capacidad de actuación (económica, industrial, militar) e impulsa la transformación digital. Dichas economías ya están invirtiendo grandes sumas y desplegando medidas de apoyo para innovar y reforzar sus capacidades efectivas de producción, o esperan hacerlo en breve[41]. Existen indicios que apuntan a que las empresas de la Unión y las organizaciones de investigación y tecnología podrían sentirse atraídas por la idea de trasladarse a otras regiones. Es menos probable que los agentes internacionales amplíen las instalaciones existentes o creen nuevas instalaciones de producción en la Unión si no tienen totalmente claras las condiciones de inversión, las posibilidades de apoyo público, las inversiones públicas en capacidades, infraestructuras, I+D avanzada, etc.

Dada la urgente necesidad de actuar, no se ha llevado a cabo ninguna evaluación de impacto ni se ha previsto ninguna consulta pública en línea. El análisis y todas las pruebas pertinentes se expondrán en un documento de trabajo de los servicios de la Comisión que se publicará a más tardar en el plazo de tres meses a partir de la publicación de la propuesta.

No obstante, en los talleres *ad hoc* celebrados con las partes interesadas de la industria sobre temas específicos relacionados con el pilar 1 se señaló la necesidad de contemplar la creación de instalaciones con vistas a las futuras tecnologías, como la fotónica, la computación neuromórfica y las tecnologías cuánticas, así como el uso de nuevos materiales[42]. Además, en estos talleres se hizo hincapié en la necesidad de tener debidamente en cuenta otras arquitecturas de conjunto de instrucciones alternativas, como RISC-V.

Asimismo, en el contexto de la Empresa Común ECSEL (predecesora de la Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave), en el verano de 2021 se celebraron reuniones con representantes de la industria y autoridades públicas en las que se debatieron los objetivos de la Brújula Digital, la actualización de la estrategia industrial, la Alianza industrial y la Ley Europea de Chips.

En 2021 se celebraron reuniones mensuales con los Estados miembros para preparar el segundo PIICE previsto sobre microelectrónica. Los Estados miembros contribuyeron a la

---

[40] «Estado del mundo», discurso especial de la presidenta Von der Leyen en el Foro Económico Mundial. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_443

[41] Por ejemplo: EE.UU.: https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1260?s=1&r=52
China: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46767
Japón: https://www.reuters.com/technology/japan-create-scheme-subsidise-domestic-chip-output-nikkei-2021-11-07/
Corea del Sur: https://spectrum.ieee.org/south-koreas-450billion-investment-latest-in-chip-making-push

[42] https://ecscollaborationtool.eu/ecs-sria-workshops.html

definición y evaluación de las instalaciones de producción integrada y fundiciones abiertas de la UE en el marco del pilar 2, así como a la definición de las instalaciones específicas en el marco del pilar 1.

El 10 de enero de 2022, se celebró una reunión con los directores generales que representan a las principales partes interesadas del sector europeo de los semiconductores. Las principales conclusiones de la reunión fueron las siguientes: la necesidad de aprovechar los puntos fuertes europeos, como la I+D y la fabricación de equipos; el apoyo claro a las líneas piloto e infraestructuras de diseño; el apoyo a las empresas emergentes y en expansión; la necesidad de aumentar la capacidad de fabricación de Europa en el ámbito de las tecnologías consolidadas y avanzadas; y la necesidad de contar con unas condiciones de competencia equitativas a escala mundial[43].

También se celebraron numerosas reuniones con representantes de los directores generales sobre la necesidad de reforzar el sector europeo de los semiconductores, tras las reuniones del comisario Breton con los directores generales de los principales agentes del sector de los semiconductores y con organizaciones de investigación y tecnología. En estas reuniones se aportaron contribuciones, en particular, con relación al pilar 1.

El foro europeo sobre Componentes y Sistemas Electrónicos (EFECS), en noviembre de 2021, con más de 500 participantes, sirvió como una amplia plataforma de debate sobre las necesidades industriales. Se aportaron más contribuciones en las reuniones celebradas con las asociaciones del sector y sus miembros, como SEMI, ESIA y Europa Digital.

Además, a través de contactos regulares y de larga duración con las partes interesadas del sector, los Estados miembros, las asociaciones comerciales y las asociaciones de usuarios, se recopiló gran cantidad de información y comentarios relevantes para la propuesta.

Desde finales de 2019, se han publicado numerosos informes sobre el sector de los semiconductores que describen tendencias y aportan datos y cifras, y que sirven para fundamentar la propuesta[44].

- **Evaluación de impacto**

La presente propuesta no va acompañada de una evaluación de impacto formal. Teniendo en cuenta la urgencia mencionada anteriormente, no podría haberse realizado una evaluación de impacto en el plazo disponible de forma previa a la adopción de la propuesta. El análisis y todas las pruebas pertinentes se expondrán en un documento de trabajo de los servicios de la Comisión que se publicará a más tardar en el plazo de tres meses a partir de la publicación de la propuesta.

---

[43] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ceo-roundtable-semiconductors-10-january-2022

[44] Lista no exhaustiva: Medición de las distorsiones en los mercados internacionales: la cadena de valor de los semiconductores, OCDE 2019; *The Geopolitics of Semiconductors*, elaborado por el grupo EURASIA, septiembre de 2020; *The global semiconductor value chains*, Stiftung Neue Verantwortung, octubre de 2020; *The Weak Links in China's Drive for Semiconductors*, Instituto Montaigne, enero de 2021; *Strengthening the Semiconductor supply chain in an uncertain Era*, BCGxSIA, abril de 2021; *SIA Factbook*, mayo de 2021; *Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth*, Informe de la Casa Blanca, junio de 2021; *Mapping China's semiconductor ecosystem in global context*, Stiftung Neue Verantwortung, junio de 2021; *Semiconductors Global Policy Review Access Partnership*, septiembre de 2021; Semiconductores: *U.S. Industry, Global Competition, and Federal Policy, Congressional Report Service*, octubre de 2021; *Semiconductor Strategy for Germany and Europe*, ZVEI, octubre de 2021; *A semiconductor strategy for the European Union*, Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIN-D), 2021; *Understanding the global chip shortage*, Stiftung Neue Verantwortung, noviembre de 2021.

- **Derechos fundamentales**

El artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») establece la libertad de empresa. Las medidas previstas en los pilares 1 y 2 de la presente propuesta generan capacidad de innovación y fomentan la seguridad del suministro de semiconductores, lo que puede reforzar la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales. No obstante, algunas medidas previstas en el pilar 3, necesarias para hacer frente a perturbaciones graves del suministro de semiconductores en la Unión, pueden limitar temporalmente la libertad de empresa y la libertad contractual, protegidas por el artículo 16, y el derecho a la propiedad, protegido por el artículo 17 de la Carta. De conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, cualquier limitación del ejercicio de estos derechos en la presente propuesta deberá ser establecida por la ley, respetará el contenido esencial de dichos derechos y libertades y cumplirá el principio de proporcionalidad.

La obligación de comunicar información específica a la Comisión, siempre que se cumplan determinadas condiciones, respeta el contenido esencial de la libertad de empresa y no afecta de manera desproporcionada a la misma (artículo 16 de la Carta). Toda solicitud de información sirve al objetivo de interés general de la Unión de permitir la identificación de posibles medidas de mitigación de crisis de escasez de semiconductores. Dichas solicitudes de información son adecuadas y eficaces a la hora de alcanzar dicho objetivo con la información necesaria para evaluar la crisis en cuestión. En principio, la Comisión solo solicita la información deseada a las organizaciones representativas y además solo puede formular solicitudes a empresas individuales si es necesario. Dado que la información sobre la situación del suministro no está disponible por otros medios, no existe ninguna medida tan eficaz como las expuestas a la hora de obtener la información necesaria que permita a los responsables políticos europeos tomar medidas de mitigación. A la luz de las graves consecuencias económicas y sociales de la escasez de semiconductores y de la respectiva importancia de las medidas de mitigación, las solicitudes de información son proporcionales al objetivo deseado. Además, la limitación de la libertad de empresa y el derecho a la propiedad se compensan estableciendo unas garantías adecuadas. Las solicitudes de información solo podrán iniciarse en situaciones de crisis en las que la Comisión haya activado la fase de crisis mediante un acto de ejecución.

La obligación de aceptar pedidos calificados de prioritarios, y de darles prioridad, respeta el contenido esencial de la libertad de empresa y la libertad contractual (artículo 16 de la Carta) así como el derecho a la propiedad (artículo 17 de la Carta), y no afectará a dichas libertades ni a dicho derecho de manera desproporcionada. Esta obligación sirve al objetivo de interés general de la Unión de garantizar que los sectores críticos afectados por perturbaciones en el suministro debido a una escasez de semiconductores sigan funcionando. Dicha obligación es adecuada y eficaz para la consecución de dicho objetivo, ya que garantiza que los recursos disponibles se utilicen de manera preferente para los productos suministrados a estos sectores. No existe ninguna otra medida tan eficaz como esta. En una situación de crisis, es proporcionado obligar a las instalaciones de fabricación de semiconductores que hayan solicitado ser reconocidas como «instalaciones de producción integrada» y «fundiciones abiertas de la UE», a otras instalaciones de fabricación de semiconductores que hayan aceptado tal posibilidad y reciban ayuda pública, o a empresas a lo largo de la cadena de suministro de semiconductores que estén supeditadas a pedidos calificados de prioritarios de un tercer país en la medida en que ello afecte significativamente a la seguridad del suministro a sectores críticos, a aceptar y priorizar determinados pedidos. A través de unas salvaguardias adecuadas se garantizará que si de la obligación de priorización se derivase un impacto negativo sobre la libertad de empresa, la libertad contractual o el derecho a la propiedad,

dicho impacto no constituirá una violación de estos derechos y libertades. La obligación de dar prioridad a determinados pedidos solo podrá aplicarse en situaciones de crisis en las que la Comisión haya activado la fase de crisis mediante un acto de ejecución. La empresa en cuestión podrá solicitar a la Comisión una revisión del pedido calificado de prioritario si no está en condiciones de llevar a término el pedido o si hacerlo le supondría una carga económica excesiva y unas dificultades especiales. Además, la empresa que esté sujeta a la obligación de priorización estará exenta de toda responsabilidad por daños y perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de la observancia de dicha obligación.

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La propuesta crea la iniciativa Chips para Europa, que no tendrá una dotación financiera separada, sino que obtendrá financiación de Horizonte Europa y del programa Europa Digital, que se ampliará con un nuevo objetivo específico 6. El Reglamento (CE) n.º 2021/2085, por el que se establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa, se modifica y se amplía para permitir que la Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave, que pasa a denominarse Empresa Común de Chips, ejecute las contribuciones aumentadas de Horizonte Europa y del programa Europa Digital en el marco del objetivo específico 6. Las consecuencias financieras de la propuesta para el presupuesto de la Unión figuran en la ficha financiera que acompaña a la propuesta y se cubrirán con los recursos disponibles del marco financiero plurianual 2021-2027.

El presupuesto de la UE apoyará la iniciativa Chips para Europa con un total de hasta 3 300 millones EUR, incluidos 1 650 millones EUR a través de Horizonte Europa y 1 650 millones EUR a través del programa Europa Digital. De este importe total, 2 875 millones EUR se ejecutarán a través de la Empresa Común de Chips, 125 millones EUR a través de InvestEU (que se complementarán con otros 125 millones EUR en el marco de InvestEU) y 300 millones EUR a través del Consejo Europeo de Innovación (CEI). Esto se añade al presupuesto ya dedicado a las actividades en el ámbito de la microelectrónica en el marco de este MFP, que asciende a casi 5 000 millones EUR.

En particular, se ejecutará un importe de hasta 1 650 millones EUR en el marco de Horizonte Europa en favor de la iniciativa Chips para Europa: 900 millones EUR del clúster 4; 150 millones EUR del clúster 3; 300 millones EUR del clúster 5; y 300 millones EUR del CEI. Además, la Comisión propone reducir el presupuesto de Horizonte Europa en 400 millones EUR a fin de incrementar los importes disponibles para el programa Europa Digital. Para compensar esta reducción de 400 millones EUR, la Comisión propone volver a poner a disposición, en beneficio del programa Horizonte Europa, un importe adicional de 400 millones EUR (a precios corrientes) de créditos de compromiso durante el período 2023-2027, resultantes de la no ejecución total o parcial de proyectos pertenecientes a dicho programa o a su predecesor. Este importe se añadirá a los 500 millones EUR (a precios de 2018) ya mencionados en la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la reutilización de los fondos liberados en relación con el programa de investigación[45]. Por consiguiente, la Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a que completen dicha Declaración conjunta con una mención del importe adicional que debe ponerse de nuevo a disposición.

[45] DO C 444I de 22.12.2020, p. 3.

En el marco del programa Europa Digital, se propone un nuevo objetivo específico 6 a efectos de la iniciativa Chips para Europa. Dicho objetivo específico 6, que abarca los elementos descritos en las letras a) a d) del artículo 5, deberá ser ejecutado por la Empresa Común de Chips. Se asignará un total de hasta 1 650 millones EUR a este nuevo objetivo específico 6 del programa de la manera siguiente: 600 millones EUR reasignados de los objetivos existentes del programa Europa Digital; una reducción de 400 millones EUR del programa del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), de los cuales 150 millones EUR del MCE-Digital y 250 millones EUR del MCE-Transporte[46]; una reducción de 400 millones EUR del clúster 4 del programa Horizonte Europa (como se menciona en el párrafo anterior, compensada por la reutilización de liberaciones); y 250 millones EUR del margen no asignado de la rúbrica 1 para financiar la iniciativa en el marco del programa Europa Digital.

La Comisión propone gestionar las reducciones de las dotaciones financieras del MCE y Horizonte Europa dentro de la variación del 15 % especificada en el apartado 18 del Acuerdo Interinstitucional, de 16 de diciembre de 2020, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios[47]. La Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a hacer referencia a estas variaciones, que son necesarias para la aplicación eficaz de la iniciativa Chips para Europa, en la Declaración conjunta mencionada en el párrafo anterior.

Se incluyen más detalles en la ficha financiera legislativa que acompaña a la presente propuesta.

5. OTROS ELEMENTOS

- **Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información**

La Comisión evaluará el rendimiento, los resultados y el impacto de la presente propuesta tres años después de la fecha en que sea aplicable y, a continuación, cada cuatro años. Las principales conclusiones de la evaluación se presentarán en un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, que se hará público. Para llevar a cabo la evaluación, el Consejo Europeo de Semiconductores, los Estados miembros y las autoridades nacionales competentes facilitarán a la Comisión información a petición suya.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

1.1. Capítulo I: Disposiciones generales

El **capítulo I** establece el objeto del Reglamento, así como las definiciones utilizadas en todo el instrumento. El Reglamento establece un marco, compuesto por tres «pilares», para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores. En particular, el Reglamento crea la iniciativa Chips para Europa, que introduce las condiciones necesarias para reforzar la capacidad de innovación industrial de la Unión (pilar 1), incluye la definición de instalaciones de producción integrada y fundiciones abiertas de la UE (pilar 2) pioneras, y los criterios

---

[46] En consonancia con la conclusión mencionada sobre la coherencia de la Ley de Chips de la UE con otras políticas de la Unión, en particular el Pacto Verde Europeo y el paquete «Objetivo 55», esta reducción no debe afectar negativamente a los objetivos generales del MCE en materia de transporte y al despliegue de infraestructuras de transporte sostenibles.

[47] DO L 433I de 22.12.2020, p. 28.

asociados a estas, así como un mecanismo de coordinación para el seguimiento y la respuesta a las crisis (pilar 3).

1.2. Capítulo II: Iniciativa «Chips para Europa»

El **capítulo II** establece la iniciativa Chips para Europa, que reforzará la competitividad, la resiliencia y la capacidad de innovación de la Unión. Mediante inversiones en la iniciativa Chips para Europa, la Unión deberá aumentar su eficacia al traducir sus avances tecnológicos y de investigación en tecnologías de semiconductores de máxima calidad orientadas a la demanda, basadas en aplicaciones, seguras y eficientes desde el punto de vista energético. Al mismo tiempo, la Unión deberá ofrecer a su industria de suministro la oportunidad de aprovechar dichas inversiones.

A tal fin, el presente capítulo incluye las disposiciones y objetivos generales de la iniciativa Chips para Europa. La iniciativa tiene por objeto apoyar el desarrollo de capacidades a gran escala en toda la Unión en el ámbito de las tecnologías de semiconductores de vanguardia y de próxima generación. La iniciativa consta de cinco elementos: capacidades de diseño para las tecnologías de semiconductores integradas; líneas piloto para la preparación de instalaciones de producción, ensayos y experimentación innovadoras; capacidades tecnológica y de ingeniería avanzadas para acelerar el desarrollo de chips cuánticos; una red de centros de competencia y desarrollo de capacidades; y actividades del «Fondo de Chips» para el acceso de empresas emergentes, empresas en expansión y pymes al capital.

La iniciativa recibirá financiación de Horizonte Europa y del programa Europa Digital, y en particular de su nuevo objetivo específico 6, y se ejecutará de conformidad con los Reglamentos por los que se establecen dichos programas.

El Reglamento establece un marco de procedimiento para facilitar una financiación combinada que incluya: financiación por parte de los Estados miembros, inversiones que no perjudiquen a las normas sobre ayudas estatales, el presupuesto de la Unión e inversión privada. Este marco adoptará la forma de un nuevo instrumento con personalidad jurídica, el Consorcio Europeo de Infraestructuras de Chips (CEIC), que podrá ser utilizado por las entidades jurídicas para estructurar su trabajo colaborativo dentro de un consorcio, de forma voluntaria. Además, la sección 1 establece un mecanismo para la creación de una red europea de centros de competencia con el fin de ejecutar acciones relativas a los centros de competencia y las capacidades en el marco de la iniciativa Chips para Europa.

Este capítulo también incluye disposiciones sobre la ejecución de la iniciativa. La ejecución primaria de la iniciativa se confiará a la Empresa Común de Chips, tal como se sugiere en la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/2085. La descripción técnica de las acciones figura en el anexo I. El anexo II incluye indicadores mensurables que sirven para supervisar la ejecución de la iniciativa y para informar sobre los avances de esta en la consecución de sus objetivos. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con el fin de modificar la lista de indicadores mensurables. La iniciativa se basa en los puntos fuertes de Europa en la cadena de valor mundial de los semiconductores y mejora las sinergias mediante acciones que actualmente reciben apoyo de la Unión y los Estados miembros. Por lo tanto, a fin de maximizar sus efectos positivos, la iniciativa deberá permitir sinergias con los programas de la Unión descritos en el anexo III.

1.3. Capítulo III: Seguridad del suministro

El **capítulo III** establece el marco para las instalaciones de producción integrada y las fundiciones abiertas de la UE. Las instalaciones de producción integrada y las fundiciones abiertas de la UE son instalaciones de fabricación que proporcionan capacidades de fabricación de semiconductores que son «pioneras» en la Unión y contribuyen a la seguridad del suministro y a un ecosistema resiliente en el mercado interior. En particular, para poder considerarlas instalaciones de producción integrada y fundiciones abiertas de la UE, la instalación en cuestión deberá tener un claro impacto positivo en la cadena de valor de los semiconductores en la Unión.

Si bien las instalaciones de producción integrada son instalaciones de producción verticalmente integrada, las fundiciones abiertas de la UE ofrecen un grado significativo de su capacidad de producción a otros agentes industriales, como las empresas de semiconductores sin fábricas (es decir, empresas que diseñan pero no fabrican chips). La inversión en estas instalaciones facilita el desarrollo de la fabricación de semiconductores en la Unión. Por consiguiente, tras su reconocimiento como instalación de producción integrada o fundición abierta de la UE por parte de la Comisión, se considerará que estas instalaciones contribuyen a la seguridad del suministro de semiconductores en la Unión y, por tanto, se considerarán de interés público. A fin de alcanzar la seguridad del suministro, los Estados miembros, sin perjuicio de las normas sobre ayudas estatales, podrán aplicar sistemas de apoyo y proporcionarán apoyo administrativo, incluido un seguimiento rápido de los procedimientos administrativos de solicitud relacionados con la planificación, construcción y funcionamiento de dichas instalaciones. La Comisión reconocerá una instalación como instalación de producción integrada o fundición abierta de la UE si cumple los criterios establecidos en el capítulo III. La Comisión podrá revocar su decisión si el reconocimiento se hubiera basado en información incorrecta o si la instalación dejara de cumplir los criterios establecidos.

1.4. Capítulo IV: Seguimiento y respuesta a las crisis

El **capítulo IV** contiene un mecanismo para realizar un seguimiento coordinado de la cadena de valor de los semiconductores y dar respuesta a las perturbaciones del suministro de semiconductores que afecten al correcto funcionamiento del mercado interior.

La **sección 1** (Supervisión) establece un sistema de supervisión y alerta de la cadena de valor de los semiconductores. El sistema se basa en actividades de seguimiento periódicas por parte de los Estados miembros consistentes, en particular, en la observación de indicadores de alerta temprana y la disponibilidad e integridad de los servicios y bienes proporcionados por los agentes clave del mercado. La Comisión proporciona la base para las actividades de seguimiento a través de una evaluación de riesgos de la Unión en la que determina los indicadores de alerta temprana. Para garantizar la participación de la industria, los Estados miembros invitarán a las partes interesadas y a las asociaciones del sector a que informen sobre las fluctuaciones significativas de la demanda y las perturbaciones de su cadena de suministro. Los Estados miembros deberán proporcionar actualizaciones periódicas e intercambiar sus conclusiones en el Consejo Europeo de Semiconductores. Los Estados miembros deberán alertar a la Comisión si tienen conocimiento de una posible crisis de los semiconductores o de la aparición de un factor de riesgo pertinente en el marco de sus actividades de seguimiento o a través de una actualización por parte de las partes interesadas. Tras recibir dicha alerta, ya provenga esta de los Estados miembros o de otras fuentes, incluidos los socios internacionales, la Comisión convocará una reunión extraordinaria del Consejo Europeo de Semiconductores. Dicha reunión servirá para evaluar la necesidad de activar la fase de crisis y debatir una posible contratación coordinada antes de una penuria. Además, la Comisión consultará o cooperará, en nombre de la Unión, con los terceros países pertinentes con el fin de buscar soluciones de cooperación para hacer frente a las perturbaciones de la cadena de suministro.

La **sección 2** (Fase de crisis) establece las normas para activar la fase de crisis de los semiconductores y detalla las medidas de emergencia que pueden utilizarse para responder a la crisis.

La Comisión está facultada para activar la fase de crisis mediante un acto de ejecución cuando existan pruebas concretas, serias y fiables de una crisis de los semiconductores. Se producirá una crisis de los semiconductores cuando se generen perturbaciones graves en el suministro de semiconductores que den lugar a penurias graves que acarreen efectos negativos significativos en uno o más sectores importantes de la Unión, o impidan el suministro, la reparación y el mantenimiento de productos esenciales utilizados por sectores críticos. El acto de ejecución especificará la duración de la fase de crisis o su prórroga. Antes de que expire la fase de crisis, la Comisión evaluará, teniendo en cuenta el dictamen del Consejo Europeo de Semiconductores, si esta debe prorrogarse. Durante la fase de crisis, el Consejo Europeo de Semiconductores celebrará reuniones extraordinarias para que los Estados miembros puedan colaborar estrechamente con la Comisión y coordinar las medidas nacionales adoptadas en relación con la cadena de suministro de semiconductores.

Cuando la fase de crisis esté activada, la Comisión podrá adoptar determinadas medidas de emergencia establecidas en el presente Reglamento. La Comisión podrá solicitar a las organizaciones representativas de las empresas o, en su caso, a las empresas individuales que operan a lo largo de la cadena de suministro de semiconductores la información necesaria para evaluar la crisis de los semiconductores y determinar posibles medidas de mitigación. Dichas entidades estarán obligadas a facilitar a la Comisión la información solicitada. La información solicitada a las entidades podrá consistir en información sobre sus capacidades teóricas y prácticas de producción, las principales perturbaciones experimentadas en el momento de la solicitud, o cualquier otro dato disponible que sea necesario para evaluar la naturaleza de la crisis de los semiconductores o para determinar y evaluar posibles medidas de mitigación o emergencia a escala nacional o de la Unión. Cuando proceda, la Comisión podrá obligar a las instalaciones de producción integrada, las fundiciones abiertas de la UE y las instalaciones de fabricación de semiconductores que hayan aceptado previamente esta posibilidad en el contexto de la recepción de ayudas públicas, o a las empresas a lo largo de la cadena de suministro de semiconductores que hayan sido objeto de un pedido calificado de prioritario de un tercer país que afecte significativamente al funcionamiento de sectores críticos, a aceptar y dar prioridad a la fabricación de productos pertinentes para la crisis destinados a sectores críticos. Con carácter adicional o alternativo, a petición de dos o más Estados miembros, la Comisión podrá, en nombre de estos, actuar como central de compras con el fin de adquirir productos pertinentes para la crisis para los sectores críticos. La Comisión, en consulta con el Consejo Europeo de Semiconductores, evaluará la utilidad, necesidad y proporcionalidad de la solicitud. Para la definición de los sectores críticos, el presente Reglamento hace referencia a los sectores que figuran en la lista incluida en el anexo de la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la resiliencia de las entidades críticas[48] y, también, al sector de la defensa y otras actividades relevantes para la seguridad pública, y establece que la Comisión podrá limitar estas medidas de emergencia a determinados sectores de dicha lista.

1.5. Capítulo V: Gobernanza

En el **capítulo V** se establecen los sistemas de gobernanza nacionales y a escala de la Unión. A escala de la Unión, la propuesta establece un Consejo Europeo de Semiconductores, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por la Comisión. El

[48] COM(2020) 829. 16.12.2020.

Consejo Europeo de Semiconductores asesorará al Consejo de Autoridades Públicas de la Empresa Común de Chips sobre la iniciativa (pilar 1); proporcionará asesoramiento y asistencia a la Comisión con el fin de intercambiar información sobre el funcionamiento de las instalaciones de producción integrada y las fundiciones abiertas de la UE (pilar 2); debatirá y preparará la determinación de tecnologías y sectores críticos específicos, abordará cuestiones relativas al seguimiento y a la respuesta a las crisis (pilar 3), prestará apoyo para la aplicación coherente del Reglamento propuesto y facilitará la cooperación entre los Estados miembros. El Consejo Europeo de Semiconductores apoyará a la Comisión en el ámbito de la cooperación internacional. Asimismo, coordinará e intercambiará información con las estructuras relevantes para las crisis establecidas en virtud del Derecho de la Unión. El Consejo Europeo de Semiconductores se reunirá en diferentes composiciones y celebrará reuniones separadas, por un lado, para las tareas que correspondan al pilar 1 y, por otro, para las que correspondan a los pilares 2 y 3. La Comisión podrá crear subgrupos permanentes o temporales del Consejo Europeo de Semiconductores e invitar a organizaciones que representen los intereses de la industria de los semiconductores, y otras partes interesadas, a participar en dichos subgrupos en calidad de observadores.

A nivel nacional, los Estados miembros designarán una o varias autoridades nacionales competentes y establecerán, entre ellas, un punto de contacto único nacional a efectos de la aplicación del Reglamento.

1.6. Capítulos VI, VII y VIII: Disposiciones finales

El **capítulo VI** hace hincapié en la obligación de todas las partes de respetar la confidencialidad de la información comercial sensible y de los secretos comerciales. Dicha obligación es aplicable a la Comisión, a las autoridades nacionales competentes y a otras autoridades de los Estados miembros, así como a todos los representantes y expertos que asistan a las reuniones del Consejo Europeo de Semiconductores y del Comité de Semiconductores. Este capítulo también establece normas sobre sanciones y multas efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, sujetas a las garantías adecuadas. La Comisión podrá imponer multas coercitivas en caso de que las empresas en cuestión no acepten ni den prioridad a determinados pedidos en el contexto de una crisis de los semiconductores. Además, la Comisión podrá imponer multas a una empresa que facilite información incorrecta, incompleta o engañosa, o que no facilite la información solicitada en el plazo establecido.

El **capítulo VII** establece las normas y condiciones para el ejercicio de las competencias de delegación y ejecución. La propuesta faculta a la Comisión para adoptar, cuando proceda, actos de ejecución que permitan la especificación de procedimientos y garanticen la aplicación uniforme del Reglamento y de los actos delegados para modificar el anexo I (las actividades que en él se establecen de manera coherente con los objetivos de la iniciativa) y el anexo II (los indicadores mensurables y las disposiciones sobre el establecimiento de un marco de seguimiento y evaluación para complementar el presente Reglamento).

El **capítulo VIII** contiene modificaciones de otros actos, incluido el programa Europa Digital, y la obligación de la Comisión de elaborar informes periódicos sobre la evaluación y revisión del Reglamento para el Parlamento Europeo y el Consejo.

2022/0032 (COD)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores (Ley de Chips)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus **artículos** 173, apartado 3, 182, apartado 1, 183 y 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[49],

Visto el dictamen del Comité de las Regiones[50],

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1) Los semiconductores son un elemento central de cualquier dispositivo digital: desde los teléfonos inteligentes y los automóviles hasta las aplicaciones e infraestructuras críticas en los ámbitos de la salud, la energía, las comunicaciones, la automatización y la mayoría de los sectores industriales. Si bien los semiconductores son esenciales para el funcionamiento de nuestra economía y nuestra sociedad modernas, la Unión ha experimentado perturbaciones sin precedentes en su suministro. La actual escasez de suministro es un síntoma de deficiencias estructurales permanentes y graves en la cadena de valor y de suministro de semiconductores de la Unión. Dichas perturbaciones han puesto de manifiesto vulnerabilidades duraderas a este respecto, en particular una fuerte dependencia de terceros países en la fabricación y el diseño de chips.

(2) Debe establecerse un marco para aumentar la resiliencia de la Unión en el ámbito de las tecnologías de semiconductores que estimule la inversión, refuerce las capacidades de la cadena de suministro de semiconductores de la Unión e incremente la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión.

(3) Este marco persigue dos objetivos. El primer objetivo es garantizar las condiciones necesarias para la competitividad y la capacidad de innovación de la Unión, así como el ajuste de la industria a los cambios estructurales debidos a los rápidos ciclos de innovación y a la necesidad de sostenibilidad. El segundo objetivo, que es independiente del primero y lo complementa, es mejorar el funcionamiento del

[49] DO C […] de […], p. […].
[50] DO C […] de […], p. […].

mercado interior estableciendo un marco jurídico uniforme de la Unión para aumentar la resiliencia y la seguridad del suministro de la Unión en el ámbito de las tecnologías de semiconductores.

(4) Es necesario adoptar medidas para desarrollar capacidades y reforzar el sector de los semiconductores de la Unión, de conformidad con el artículo 173, apartado 3, del Tratado. Estas medidas no implican la armonización de las disposiciones legales y reglamentarias nacionales. A este respecto, la Unión debe reforzar la competitividad y la resiliencia de la base tecnológica e industrial de los semiconductores, y al mismo tiempo fortalecer la capacidad de innovación de su sector de semiconductores, reducir la dependencia de un número limitado de empresas y zonas geográficas de terceros países y reafirmar su capacidad para diseñar y producir componentes avanzados. La iniciativa Chips para Europa (en lo sucesivo, «la iniciativa») debe apoyar estos objetivos reduciendo la brecha existente entre las capacidades avanzadas de investigación e innovación de Europa y su explotación industrial sostenible. Debe promover el desarrollo de capacidades para permitir la integración del diseño, la producción y los sistemas en las tecnologías de semiconductores de próxima generación, mejorar la colaboración entre los principales agentes de toda la Unión, reforzar las cadenas de suministro y de valor de los semiconductores de Europa, dar servicio a sectores industriales clave y crear nuevos mercados.

(5) El uso de semiconductores es fundamental para múltiples sectores económicos y funciones sociales en la Unión, por lo que un suministro resiliente es esencial para el funcionamiento del mercado interior. Dada la amplia circulación de productos semiconductores a través de las fronteras, la resiliencia y la seguridad del suministro de semiconductores pueden abordarse mejor mediante una legislación de armonización de la Unión basada en el artículo 114 del Tratado. Con vistas a posibilitar medidas coordinadas para aumentar la resiliencia, son necesarias normas armonizadas para facilitar la ejecución de proyectos específicos que contribuyan a la seguridad del suministro de semiconductores en la Unión. El mecanismo de seguimiento y respuesta a las crisis propuesto debe ser uniforme para permitir un enfoque coordinado de la preparación frente a las crisis para la cadena de valor transfronteriza de los semiconductores.

(6) La consecución de estos objetivos estará respaldada por un mecanismo de gobernanza. A escala de la Unión, el presente Reglamento establece un Consejo Europeo de Semiconductores, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por la Comisión. El Consejo Europeo de Semiconductores asesorará y asistirá a la Comisión sobre cuestiones específicas, incluida la aplicación coherente del presente Reglamento, facilitando la cooperación entre los Estados miembros e intercambiando información sobre cuestiones relacionadas con el presente Reglamento. El Consejo Europeo de Semiconductores debe celebrar reuniones separadas para sus tareas que figuran en los distintos capítulos del presente Reglamento. Las distintas reuniones podrán celebrarse con diferentes composiciones de los representantes de alto nivel, y la Comisión podrá crear subgrupos.

(7) Habida cuenta del carácter globalizado de la cadena de suministro de semiconductores, la cooperación internacional con terceros países es un elemento importante para lograr la resiliencia del ecosistema de semiconductores de la Unión. Las medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento también deben permitir a la Unión desempeñar un papel más importante, como centro de excelencia, en un ecosistema de semiconductores global e interdependiente que funcione mejor. La Comisión, asistida por el Consejo Europeo de Semiconductores, debe cooperar y establecer asociaciones

con terceros países con vistas a buscar soluciones para hacer frente, en la medida de lo posible, a las perturbaciones de la cadena de suministro de semiconductores.

(8) El sector de los semiconductores se caracteriza por unos costes de desarrollo e innovación muy elevados, así como para construir instalaciones de ensayo y experimentación de vanguardia con objeto de apoyar la producción industrial. Esta circunstancia tiene un impacto directo en la competitividad y la capacidad de innovación de la industria de la Unión, así como en la seguridad y la resiliencia del suministro. A la luz de las lecciones aprendidas de la reciente penuria en la Unión y en todo el mundo, y de la rápida evolución de los retos tecnológicos y los ciclos de innovación que afectan a la cadena de valor de los semiconductores, es necesario reforzar la competitividad, la resiliencia y la capacidad de innovación de la Unión mediante el establecimiento de la iniciativa.

(9) Los principales responsables de cimentar una base industrial sólida, competitiva, sostenible e innovadora en la Unión son los Estados miembros. Sin embargo, la naturaleza y la magnitud del reto de la innovación en el sector de los semiconductores requieren una actuación colaborativa a escala de la Unión.

(10) El Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte Europa, creado por el Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo[51], tiene el objetivo de reforzar el Espacio Europeo de Investigación (EEI), alentándolo a que sea más competitivo, también en lo que se refiere a su industria, promoviendo al mismo tiempo todas las actividades de investigación e innovación (I+I) destinadas a cumplir las prioridades y compromisos estratégicos de la Unión, que en última instancia tienen por objeto promover la paz, los valores de la Unión y el bienestar de sus pueblos. La Unión tiene la prioridad fundamental de que los recursos financieros totales asignados al programa no se vean reducidos y que la disminución de los recursos financieros, destinados a reforzar la dotación financiera del programa Europa Digital con el fin de contribuir a la iniciativa de Chips, se compense con otra fuente. Por consiguiente, sin perjuicio de las prerrogativas institucionales del Parlamento Europeo y del Consejo, debe ponerse a disposición de Horizonte Europa, durante el período 2023-2027, un importe de créditos de compromiso equivalente a la disminución, resultante de la no ejecución total o parcial de proyectos pertenecientes a dicho programa o a su predecesor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo[52] (el Reglamento Financiero). Este importe se añadirá a los 500 millones EUR (a precios de 2018) ya mencionados en la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la reutilización de los fondos liberados en relación con el programa de investigación.

---

[51] Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa», se establecen sus normas de participación y difusión, y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1290/2013 y (UE) n.º 1291/2013. (DO L 170 de 12.5.2021, p. 1).

[52] Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

(11) Con el fin de dotar a la Unión de las capacidades de investigación e innovación en tecnología de semiconductores necesarias para mantener sus inversiones en investigación e industria en la vanguardia y reducir la brecha existente entre la investigación y el desarrollo y la fabricación, la Unión y sus Estados miembros deben coordinar mejor sus esfuerzos e invertir conjuntamente. Para lograrlo, la Unión y los Estados miembros deben tener en cuenta el objetivo doble de la transición digital y ecológica. En todos sus componentes y acciones la iniciativa debe, en la medida de lo posible, integrar y maximizar las ventajas de la aplicación de las tecnologías de semiconductores como poderosos facilitadores de la transición hacia la sostenibilidad que puedan dar lugar a nuevos productos y a un uso más eficiente, eficaz, limpio y duradero de los recursos, incluida la energía y los materiales necesarios para la producción y el uso de los semiconductores durante todo el ciclo de vida.

(12) Para alcanzar su objetivo general y abordar los retos tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda del actual ecosistema de semiconductores, la iniciativa debe incluir cinco componentes principales. En primer lugar, para reforzar la capacidad de diseño de Europa, la iniciativa debe apoyar acciones destinadas a la construcción de una plataforma virtual disponible en toda la Unión. Dicha plataforma debe conectar a las comunidades de grandes empresas, empresas emergentes y pymes dedicadas al diseño de microprocesadores, de propiedad intelectual y proveedores de herramientas con organizaciones de investigación y tecnología para proporcionar prototipos virtuales basados en el desarrollo conjunto de tecnología. En segundo lugar, con el fin de reforzar la seguridad y la resiliencia del suministro y reducir la dependencia de la Unión de la producción de terceros países, la iniciativa debe apoyar el desarrollo y el acceso a líneas piloto. Las líneas piloto deben proporcionar a la industria instalaciones para ensayar, experimentar y validar las tecnologías de semiconductores y los conceptos de diseño de sistemas a niveles elevados de preparación tecnológica, superiores al nivel 3 pero inferiores al nivel 8, reduciendo el impacto ambiental al mismo tiempo, tanto como sea posible. Las inversiones de la Unión, junto con las inversiones de los Estados miembros y del sector privado en líneas piloto, son necesarias para hacer frente al reto estructural existente y a las deficiencias del mercado cuando no se dispone de este tipo de instalaciones en la Unión, lo que obstaculiza el potencial de innovación y la competitividad mundial de la Unión. En tercer lugar, con objeto de posibilitar las inversiones en tecnologías alternativas, como las tecnologías cuánticas, que propicien el desarrollo del sector de los semiconductores, la iniciativa debe apoyar acciones, en particular en materia de bibliotecas de diseño para chips cuánticos, líneas piloto para la construcción de chips cuánticos e instalaciones de ensayo y experimentación para componentes cuánticos. En cuarto lugar, con el fin de promover el uso de las tecnologías de semiconductores, facilitar el acceso a instalaciones de diseño y líneas piloto y abordar las carencias de capacidades en toda la Unión, la iniciativa debe apoyar el establecimiento de centros de competencia en materia de semiconductores en cada Estado miembro. El acceso a infraestructuras financiadas con fondos públicos, como instalaciones piloto y de ensayo, y a la red de competencias, debe estar abierto a una amplia gama de usuarios y debe concederse de manera transparente y no discriminatoria y en condiciones de mercado (o de los costes más un margen razonable) para las grandes empresas, mientras que las pymes puedan beneficiarse de un acceso preferencial o de precios reducidos. Este acceso, también para la investigación internacional y los socios comerciales, puede conducir a un mayor enriquecimiento mutuo y a mejoras en los conocimientos técnicos y la excelencia, y contribuir al mismo tiempo a la recuperación de los costes. En quinto lugar, la Comisión debe crear un mecanismo específico de

inversión en semiconductores (como parte de las actividades de facilitación de la inversión descritas colectivamente como el «Fondo de Chips») que proponga soluciones tanto de capital como de deuda, incluido un mecanismo de financiación combinada en el marco del Fondo InvestEU, establecido por el Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo[53], en estrecha cooperación con el Grupo del Banco Europeo de Inversiones y con otros socios ejecutantes, como los bancos e instituciones nacionales de fomento. Las actividades del «Fondo de Chips» deben apoyar el desarrollo de un ecosistema de semiconductores dinámico y resiliente, ofreciendo oportunidades para una mayor disponibilidad de fondos con objeto de apoyar el crecimiento de las empresas emergentes y las pymes, así como las inversiones a lo largo de toda la cadena de valor, también para otras empresas de las cadenas de valor de los semiconductores. En este contexto, el Consejo Europeo de Innovación proporcionará más apoyo específico mediante subvenciones e inversiones en capital a innovadores y creadores de mercado de alto riesgo.

(13) Con el fin de superar las limitaciones de los actuales esfuerzos fragmentados de inversión pública y privada, facilitar la integración, el enriquecimiento mutuo y el rendimiento de la inversión en los programas en curso, y perseguir una visión estratégica común de la Unión sobre los semiconductores como medio para alcanzar el objetivo de la Unión y de sus Estados miembros de garantizarse un papel de liderazgo en la economía digital, la iniciativa Chips para Europa debe facilitar una mejor coordinación y unas sinergias más estrechas entre los programas de financiación existentes a escala nacional y de la Unión, una mejor coordinación y colaboración con la industria y las principales partes interesadas del sector privado e inversiones conjuntas adicionales con los Estados miembros. La ejecución de la iniciativa se ha establecido para mancomunar recursos de la Unión, de los Estados miembros y de terceros países asociados con los programas existentes de la Unión, así como del sector privado. Por lo tanto, el éxito de la iniciativa solo puede basarse en un esfuerzo colectivo de los Estados miembros, con la Unión, para apoyar tanto los considerables costes de capital como la amplia disponibilidad de recursos de diseño virtual, ensayo y experimentación, así como la difusión de conocimientos, capacidades y competencias. Cuando proceda, habida cuenta de las especificidades de las acciones de que se trate, los objetivos de la iniciativa, en particular las actividades del «Fondo de Chips», también deben recibir apoyo a través de un mecanismo de financiación combinada en el marco del Fondo InvestEU.

(14) El apoyo de la iniciativa debe utilizarse para corregir los fallos de mercado o las situaciones de inversión subóptimas de manera proporcionada, y las acciones no deben duplicar o desplazar la financiación privada o distorsionar la competencia en el mercado interior. Las acciones deben presentar un claro valor añadido para la Unión.

(15) La iniciativa debe desarrollarse sobre la sólida base de conocimientos existente y mejorar las sinergias con las acciones actualmente apoyadas por la Unión y los Estados miembros a través de programas y acciones de investigación e innovación en semiconductores y en el desarrollo de una parte de la cadena de suministro, en particular Horizonte Europa y el programa Europa Digital establecido por el

[53] Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 2021, por el que se establece el Programa InvestEU y se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017 (DO L 107 de 26.3.2021, p. 30).

Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo[54] con el objetivo de reforzar la Unión de aquí a 2030 como actor mundial en la tecnología de semiconductores y sus aplicaciones, con una cuota mundial creciente de la fabricación. Como complemento de estas actividades, la iniciativa colaboraría estrechamente con otras partes interesadas pertinentes, incluida la Alianza industrial sobre tecnologías de procesadores y semiconductores.

(16) Con el fin de acelerar la ejecución de las acciones de la iniciativa es necesario ofrecer la opción de ejecutar algunas de ellas, en particular en materia de líneas piloto, a través de un nuevo instrumento jurídico: el Consorcio Europeo de Infraestructuras de Chips (CEIC). El CEIC debe tener personalidad jurídica propia. Esto significa que, al solicitar financiación para acciones en el marco de la iniciativa, el propio CEIC, y no las entidades individuales que lo forman, puede ser el solicitante. El objetivo principal del CEIC debe ser fomentar una colaboración eficaz y estructural entre las entidades jurídicas, incluidas las organizaciones de investigación y tecnología. Por este motivo, el CEIC debe contar con la participación de al menos tres entidades jurídicas de tres Estados miembros y funcionar como un consorcio público-privado para una acción específica. La creación del CEIC no debe implicar el establecimiento efectivo de un nuevo organismo de la Unión y no debe dirigirse a una sola acción específica en el marco de la iniciativa. El CEIC debe abordar la brecha existente en el conjunto de instrumentos de la Unión para combinar la financiación procedente de los Estados miembros, el presupuesto de la Unión y la inversión privada a efectos de la ejecución de las acciones de la iniciativa. En particular, pueden lograrse fuertes sinergias mediante el desarrollo combinado de las diferentes líneas piloto de un CEIC, poniendo en común la contribución de la Unión con los recursos colectivos de los Estados miembros y otros participantes. El presupuesto del CEIC que pondrían a disposición los Estados miembros y los participantes del sector privado durante su período de funcionamiento previsto debe respetar los plazos de las acciones ejecutadas en el marco de la presente iniciativa. La Comisión no debe ser parte directa en el Consorcio.

(17) La ejecución primaria de la iniciativa debe confiarse a la Empresa Común de Chips, tal como se establece en el Reglamento XX/XX del Consejo, que modifica el Reglamento (UE) 2021/2085, por el que se establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa, en lo que respecta a la Empresa Común de Chips[55].

(18) Con el fin de fomentar el establecimiento de las capacidades de fabricación y diseño necesarias y, de este modo, garantizar la seguridad del suministro en la Unión, puede ser conveniente contar con apoyo público. A este respecto, es necesario establecer los criterios para facilitar la ejecución de proyectos específicos que contribuyan a la consecución de los objetivos del presente Reglamento y distinguir entre dos tipos de instalaciones, a saber: instalaciones de producción integradas y fundiciones abiertas de la UE.

(19) Las instalaciones de producción integrada y las fundiciones abiertas de la UE deben proporcionar capacidades de fabricación de semiconductores que sean «pioneras» en la Unión y contribuyan a la seguridad del suministro y a un ecosistema resiliente en el mercado interior. El factor de selección para la producción de una instalación pionera

---

[54] Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se establece el Programa Europa Digital y por el que se deroga la Decisión (UE) 2015/2240. (DO L 166 de 11.5.2021, p. 1).

[55] […].

podría estar relacionado con el nodo tecnológico, el material de sustrato, como el carburo de silicio y el nitruro de galio, y otras innovaciones de productos que puedan ofrecer un mejor rendimiento, tecnología de procesos o rendimiento energético y medioambiental. Dentro de la Unión, no debería existir aún una instalación con una capacidad teórica comparable a escala industrial, ni debería estar prevista su construcción, con excepción de las instalaciones de investigación y desarrollo o las instalaciones de producción a pequeña escala.

(20) Cuando una fundición abierta de la UE ofrezca capacidad efectiva de producción a empresas no vinculadas al operador de la instalación, esta deberá establecer, aplicar y mantener una separación funcional adecuada y efectiva para evitar el intercambio de información confidencial entre la producción interna y externa. Esto debe aplicarse a cualquier información obtenida en el diseño y en los procesos de la etapa de fabricación o la etapa de empaquetado, ensamblado y prueba.

(21) Para considerarlas instalaciones de producción integrada o fundiciones abiertas de la UE, la creación y el funcionamiento de la instalación deben tener un impacto positivo claro en la cadena de valor de los semiconductores en la Unión, en particular en lo que se refiere a la provisión de un suministro resiliente de semiconductores a los usuarios en el mercado interior. El impacto de las instalaciones en varios Estados miembros, incluido en los objetivos de cohesión, debe considerarse uno de los indicadores del claro efecto positivo de las instalaciones de producción integrada y las fundiciones abiertas de la UE en la cadena de valor de los semiconductores en la Unión.

(22) Es importante que las instalaciones de producción integrada y las fundiciones abiertas de la UE no estén sujetas a la aplicación extraterritorial de las obligaciones de servicio público impuestas por terceros países que puedan socavar su capacidad para utilizar sus infraestructuras, programas informáticos, servicios, instalaciones, activos, recursos, propiedad intelectual o conocimientos técnicos necesarios para cumplir la obligación en materia de pedidos calificados de prioritarios en virtud del presente Reglamento, que tendrían que garantizar.

(23) A la luz del rápido desarrollo de las tecnologías de semiconductores y para reforzar la futura competitividad industrial de la Unión, las instalaciones de producción integrada y las fundiciones abiertas de la UE deben comprometerse a invertir de forma continua y eficiente en las próximas generaciones de semiconductores, en particular probando y experimentando nuevos avances mediante el acceso prioritario a las líneas piloto establecidas por la iniciativa Chips para Europa, sin perjuicio del acceso efectivo de terceros.

(24) Con objeto de permitir un procedimiento uniforme y transparente de obtención del reconocimiento como instalación de producción integrada y fundición abierta de la UE, la decisión de reconocimiento debe ser adoptada por la Comisión tras la solicitud de una empresa individual o un consorcio de varias empresas. A fin de tener en cuenta la importancia de una aplicación coordinada y cooperativa del mecanismo previsto, la Comisión debe tener en cuenta en su evaluación la disposición del Estado o Estados miembros en los que el solicitante tenga la intención de establecer sus instalaciones a apoyar dicho establecimiento. Además, al evaluar la viabilidad del plan empresarial, la Comisión podría tener en cuenta el historial global del solicitante. En vista de los privilegios asociados al reconocimiento como instalación de producción integrada o fundición abierta de la UE, la Comisión debe supervisar si las instalaciones a las que se ha concedido este estatus siguen cumpliendo los criterios establecidos en el presente Reglamento.

(25) Habida cuenta de su importancia para garantizar la seguridad del suministro y permitir un ecosistema de semiconductores resiliente, las instalaciones de producción integrada y las fundiciones abiertas de la UE deben considerarse de interés público. Garantizar la seguridad del suministro de semiconductores también es importante para la digitalización, que permite la transición ecológica de muchos otros sectores. Para contribuir a la seguridad del suministro de semiconductores en la Unión, los Estados miembros podrán aplicar regímenes de apoyo y prestar apoyo administrativo en los procedimientos nacionales de concesión de autorizaciones. Esto se entiende sin perjuicio de la competencia de la Comisión en el ámbito de las ayudas estatales en virtud de los artículos 107 y 108 del Tratado, cuando proceda. Los Estados miembros deben apoyar el establecimiento de instalaciones de producción integrada y de fundiciones abiertas de la UE, de conformidad con el Derecho de la Unión.

(26) Es necesario que las instalaciones de producción integrada y las fundiciones abiertas de la UE se creen lo antes posible, manteniendo al mínimo la carga administrativa. Por esta razón, los Estados miembros deben tratar las solicitudes relacionadas con la planificación, la construcción y el funcionamiento de instalaciones de producción integrada y fundiciones abiertas de la UE de la manera más rápida posible. Los Estados miembros deben designar una autoridad que facilite y coordine los procesos de concesión de autorizaciones y un coordinador que actúe como punto de contacto único para el proyecto. Además, cuando sea necesario para conceder una excepción en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo[56] y de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[57], el establecimiento y funcionamiento de estas instalaciones podrá considerarse de interés público superior en el sentido de los textos jurídicos antes mencionados, siempre que se cumplan las demás condiciones establecidas en dichas disposiciones.

(27) El mercado interior se beneficiaría enormemente de unas normas comunes para chips ecológicos, confiables y seguros. Los futuros dispositivos inteligentes, sistemas y plataformas de conectividad tendrán que depender de componentes de semiconductores avanzados y deberán cumplir requisitos relacionados con la ecología, la confianza y la ciberseguridad, que dependerán en gran medida de las características de la tecnología subyacente. A tal fin, la Unión debe desarrollar procedimientos de certificación de referencia y exigir a la industria que desarrolle conjuntamente dichos procedimientos para sectores y tecnologías específicos que puedan tener una gran repercusión social.

(28) En vista de ello, la Comisión, en consulta con el Consejo Europeo de Semiconductores, debe preparar el terreno para una certificación de chips y sistemas integrados verdes, confiables y seguros que se basen en tecnologías de semiconductores o las utilicen ampliamente. En particular, deben debatir y determinar los sectores y productos pertinentes que necesitan dicha certificación.

(29) A la luz de las deficiencias estructurales de la cadena de suministro de semiconductores y del consiguiente riesgo de futuras penurias, el presente Reglamento proporciona instrumentos para aplicar un enfoque coordinado a fin de supervisar y abordar eficazmente las posibles perturbaciones del mercado.

---

[56] Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

[57] Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

(30) Debido a la compleja y rápida evolución de las cadenas de valor de los semiconductores y a su interrelación con diversos agentes, es necesario un enfoque coordinado de supervisión periódica para aumentar la capacidad de mitigar los riesgos que puedan afectar negativamente al suministro de semiconductores. Los Estados miembros deben supervisar la cadena de valor de los semiconductores centrándose en los indicadores de alerta temprana y en la disponibilidad e integridad de los servicios y bienes proporcionados por los principales agentes del mercado, de manera que no represente una carga administrativa excesiva para las empresas.

(31) Cualquier conclusión oportuna, incluida la información facilitada por las partes interesadas pertinentes y las asociaciones del sector, debe transmitirse al Consejo Europeo de Semiconductores para permitir el intercambio periódico de información entre representantes de alto nivel de los Estados miembros y la integración de la información en una visión general de la supervisión de las cadenas de valor de los semiconductores.

(32) Es importante tener en cuenta la información específica de los usuarios de semiconductores sobre la situación del suministro. Por consiguiente, los Estados miembros deben identificar e intercambiar información regularmente con las principales categorías de usuarios en sus mercados nacionales. Además, los Estados miembros deben ofrecer a las organizaciones de partes interesadas pertinentes, incluidas las asociaciones del sector y los representantes de las principales categorías de usuarios, la posibilidad de facilitar información sobre los cambios significativos en la demanda y la oferta, y las perturbaciones de su cadena de suministro de las que tengan conocimiento, lo que podría incluir la falta de disponibilidad de semiconductores o materias primas esenciales, un plazo de producción superior a la media, retrasos en la entrega y subidas excepcionales de los precios.

(33) Para llevar a cabo estas actividades de seguimiento, las autoridades competentes de los Estados miembros pueden necesitar determinada información, que puede no ser de acceso público, como la relativa al papel de una empresa concreta a lo largo de la cadena de valor de los semiconductores. En aquellas circunstancias limitadas en las que, para llevar a cabo las actividades de supervisión sea necesario y proporcionado, las autoridades competentes de los Estados miembros deben poder solicitar esta información a la empresa en cuestión.

(34) Los Estados miembros deben alertar a la Comisión si los factores pertinentes indican una posible crisis de semiconductores. Con el fin de garantizar una respuesta coordinada para hacer frente a tales crisis, la Comisión, a raíz de la alerta de un Estado miembro o de otras fuentes, incluida la información procedente de socios internacionales, debe convocar una reunión extraordinaria del Consejo Europeo de Semiconductores para evaluar la necesidad de activar la fase de crisis y debatir si puede ser adecuado, necesario y proporcionado que los Estados miembros lleven a cabo una contratación conjunta coordinada. La Comisión debe entablar consultas y cooperar con terceros países pertinentes con el fin de abordar cualquier perturbación en la cadena de suministro internacional, de conformidad con las obligaciones internacionales y sin perjuicio de los requisitos de procedimiento en virtud del Tratado sobre acuerdos internacionales.

(35) Como parte del seguimiento, las autoridades nacionales competentes también deben hacer una cartografía de las empresas que operan en la Unión a lo largo de la cadena de suministro de semiconductores establecidas en su territorio nacional y notificar esta información a la Comisión.

(36) Con el fin de facilitar un control eficaz, es necesaria una evaluación en profundidad de los riesgos asociados a las diferentes fases de la cadena de valor de los semiconductores, en particular del origen y las fuentes de suministro fuera de la Unión. Estos riesgos pueden estar relacionados con insumos y equipos críticos para la industria, incluidos los productos digitales que pueden ser vulnerables, las posibles repercusiones de los semiconductores falsificados, las capacidades de fabricación y otros riesgos que pueden perturbar, comprometer o afectar negativamente a la cadena de suministro. Estos riesgos podrían incluir cadenas de suministro que tengan un punto único de fallo o estén muy concentradas. Otros factores pertinentes podrían ser la disponibilidad de sustitutos o fuentes alternativas para los insumos críticos y el transporte resiliente y sostenible. La Comisión, asistida por el Consejo Europeo de Semiconductores, y teniendo también en cuenta la información recibida de las principales categorías de usuarios, debe elaborar una evaluación de riesgos a escala de la Unión.

(37) Con objeto de predecir futuras perturbaciones de las diferentes fases de la cadena de valor de los semiconductores en la Unión, y de prepararse para estas, la Comisión, asistida por el Consejo Europeo de Semiconductores, debe determinar indicadores de alerta temprana en la evaluación de riesgos de la Unión. Estos indicadores podrían incluir la disponibilidad de materias primas, productos intermedios y capital humano necesarios para la fabricación de semiconductores, o equipos de fabricación adecuados, la demanda prevista de semiconductores en los mercados de la Unión y mundiales, las subidas de precios superiores a la fluctuación normal de los precios, el efecto de accidentes, ataques, catástrofes naturales u otros acontecimientos graves, el impacto de las políticas comerciales, los aranceles, las restricciones a la exportación, las barreras comerciales y otras medidas relacionadas con el comercio, y las repercusiones de los cierres de empresas, las deslocalizaciones o las adquisiciones de agentes clave del mercado. Los Estados miembros deben supervisar estos indicadores de alerta temprana.

(38) Se considera que una serie de empresas que prestan servicios o suministran bienes de semiconductores son esenciales para una cadena de suministro efectiva de semiconductores en el ecosistema de semiconductores de la Unión, según el número de empresas de la Unión que dependen de sus productos, su cuota de mercado de la Unión o mundial, su importancia para garantizar un nivel suficiente de suministro o las posibles repercusiones de la perturbación del suministro de sus productos o servicios. Los Estados miembros deben identificar a los principales agentes del mercado en su territorio.

(39) De conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE) 2019/452, por el que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión[58], para determinar si una inversión extranjera directa puede afectar a la seguridad o al orden público, los Estados miembros y la Comisión podrán tener en cuenta sus efectos potenciales en las tecnologías críticas y los productos de doble uso,

[58] Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por el que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión (DO L 79I de 21.3.2019, p. 1).

tal como se definen en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (CE) n.º 428/2009[59] del Consejo, incluidos los semiconductores.

(40) Como parte del seguimiento, los Estados miembros podrían tener en cuenta específicamente la disponibilidad y la integridad de los servicios y bienes de los principales agentes de los mercados. Tales cuestiones podrían ser puestas en conocimiento del Consejo Europeo de Semiconductores por el Estado miembro de que se trate.

(41) Para que la Unión pueda dar una respuesta rápida, eficiente y coordinada a una crisis de semiconductores, es necesario proporcionar a los responsables de la toma de decisiones información oportuna y actualizada sobre la situación operativa en curso, así como garantizar que puedan adoptarse medidas eficaces para garantizar el suministro de semiconductores a los sectores críticos afectados.

(42) La fase de crisis de semiconductores debe activarse en presencia de pruebas concretas, serias y fiables. Se produce una crisis de semiconductores cuando se generan perturbaciones graves en el suministro de semiconductores que den lugar a penurias graves que acarreen retrasos significativos y efectos negativos en uno o más sectores económicos centrales de la Unión, ya sea directamente o a través de los efectos expansivos de la penuria, dado que los sectores industriales de la Unión representan una sólida base de usuarios de semiconductores. De forma alternativa o adicional, también se produce una crisis de semiconductores cuando las disrupciones graves del suministro de semiconductores den lugar a una penuria significativa que impida el suministro, la reparación y el mantenimiento de productos esenciales utilizados por sectores críticos, por ejemplo equipos médicos y de diagnóstico.

(43) A fin de garantizar una respuesta ágil y eficaz a una crisis de semiconductores de esta naturaleza, la Comisión debe estar facultada para activar la fase de crisis mediante actos de ejecución y por un período de duración predeterminado, teniendo en cuenta el dictamen del Consejo Europeo de Semiconductores. La Comisión debe evaluar la necesidad de una prolongación y prolongar la duración de la fase de crisis durante un período predeterminado, en caso de que se determine dicha necesidad, teniendo en cuenta el dictamen del Consejo Europeo de Semiconductores.

(44) La estrecha cooperación entre la Comisión y los Estados miembros y la coordinación de cualquier medida nacional adoptada en relación con la cadena de suministro de semiconductores son indispensables durante la fase de crisis con el fin de hacer frente a las perturbaciones con la coherencia, la resiliencia y la eficacia necesarias. Con este objetivo, el Consejo Europeo de Semiconductores debe celebrar reuniones extraordinarias cuando sea necesario. Toda medida que se adopte debe limitarse estrictamente al período de duración de la fase de crisis.

(45) Cuando se active la fase de crisis, deben determinarse y aplicarse medidas adecuadas, eficaces y proporcionadas, sin perjuicio de un posible compromiso internacional continuado con los socios pertinentes con vistas a mitigar la evolución de la situación de crisis. Cuando proceda, la Comisión debe solicitar información a las empresas a lo largo de la cadena de suministro de semiconductores. Además, la Comisión debe poder obligar, cuando sea necesario y proporcionado, a las instalaciones de producción

[59] Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso (DO L 134 de 29.5.2009, p. 1).

integrada y a las fundiciones abiertas de la UE a aceptar y priorizar un pedido para la producción de productos pertinentes para la crisis, y a actuar como central de compras cuando así lo exijan los Estados miembros. La Comisión podría limitar las medidas a determinados sectores críticos. Además, el Consejo Europeo de Semiconductores podrá asesorar sobre la necesidad de introducir un régimen de control de las exportaciones de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/479 del Parlamento Europeo y del Consejo[60]. El Consejo Europeo de Semiconductores también podrá evaluar y asesorar sobre otras medidas adecuadas y eficaces. El uso de todas estas medidas de emergencia debe ser proporcionado y limitarse a lo necesario para hacer frente a las perturbaciones significativas de que se trate, en la medida en que ello redunde en el interés superior de la Unión. La Comisión debe informar periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo de las medidas adoptadas y de los motivos subyacentes. La Comisión, previa consulta con el Consejo, podrá publicar orientaciones adicionales sobre la aplicación y el uso de las medidas de emergencia.

(46) Para el correcto funcionamiento del mercado interior, una serie de sectores son fundamentales. Estos sectores figuran en el anexo de la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la resiliencia de las entidades críticas[61]. A efectos del presente Reglamento, las actividades de defensa y otras actividades que sean pertinentes para la seguridad pública deben considerarse también un sector crítico. Algunas medidas solo deben adoptarse con el objetivo de garantizar el suministro a sectores críticos. La Comisión podrá limitar las medidas de emergencia a algunos de estos sectores, o a partes de los mismos, cuando la crisis de semiconductores haya perturbado o amenace con perturbar su funcionamiento.

(47) La finalidad de las solicitudes de información a las empresas a lo largo de la cadena de suministro de semiconductores establecidas en la Unión en la fase de crisis es realizar una evaluación en profundidad de la crisis de los semiconductores con el fin de determinar posibles medidas de mitigación o emergencia a escala nacional o de la Unión. Dicha información podrá incluir la capacidad de producción teórica y efectiva, así como las principales perturbaciones y cuellos de botella en el momento de la evaluación. También podría incluir las existencias habituales y actuales de productos relevantes para la crisis en sus instalaciones de producción situadas en la Unión y en las instalaciones de terceros países que dichas empresas gestionan, contratan o de las que se suministran; el plazo de producción medio habitual y actual de los productos más comunes; la producción prevista para los tres meses siguientes por cada instalación de producción de la Unión; las razones que impidan utilizar por completo la capacidad efectiva de producción; u otros datos existentes necesarios para evaluar la naturaleza de la crisis de los semiconductores o las posibles medidas de mitigación o emergencia a escala nacional o de la Unión. Toda solicitud debe ser proporcionada, tener en cuenta los objetivos legítimos de la empresa y el coste y el esfuerzo necesarios para facilitar los datos, así como establecer plazos adecuados para transmitir la información solicitada. Las empresas deben estar obligadas a atender la solicitud y pueden ser objeto de sanciones en caso de incumplimiento o si proporcionan información incorrecta. Toda información obtenida debe estar sujeta a normas de confidencialidad. En caso de que una empresa sea objeto de una solicitud de información relativa a sus actividades en el ámbito de los semiconductores en un

---

60 Reglamento (UE) 2015/479 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre el régimen común aplicable a las exportaciones (DO L 83 de 27.3.2015, p. 34).

61 COM(2020) 829. 16.12.2020.

tercer país, deberá informar de ello a la Comisión para que esta pueda evaluar si la solicitud de información por parte de la Comisión está justificada.

(48) Con el fin de garantizar que los sectores críticos puedan seguir funcionando en tiempos de crisis y cuando sea necesario y proporcionado para este fin, la Comisión podría obligar a las instalaciones de producción integrada y a las fundiciones abiertas de la UE a aceptar y priorizar pedidos de productos pertinentes para la crisis. Esta obligación también puede ampliarse a las instalaciones de fabricación de semiconductores que hayan aceptado tal posibilidad en el contexto de la recepción de ayudas públicas. La decisión sobre un pedido calificado de prioritario debe adoptarse de conformidad con todas las obligaciones jurídicas de la Unión aplicables, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. La obligación de calificación prioritaria debe prevalecer sobre cualquier obligación de ejecución de Derecho público o privado, teniendo en cuenta los objetivos legítimos de las empresas y el coste y el esfuerzo necesarios para cualquier cambio en la secuencia de producción. Las empresas pueden ser sancionadas si incumplen la obligación de los pedidos calificados de prioritarios.

(49) La empresa afectada estará obligada a aceptar un pedido calificado de prioritario y a darle prioridad. En casos excepcionales y debidamente justificados, la empresa podrá solicitar a la Comisión que revise la obligación impuesta. Esto se aplica tanto cuando la instalación no sea capaz de cumplir el pedido, aunque se le haya dado prioridad, debido a una capacidad de producción teórica o efectiva insuficiente, como cuando suponga una carga económica excesiva y cause grandes dificultades a la instalación.

(50) En la circunstancia excepcional de que una empresa que opere a lo largo de la cadena de suministro de semiconductores en la Unión reciba una solicitud de pedido calificado de prioritario por parte de un tercer país, esta deberá informar a la Comisión de dicha solicitud, con el fin de evaluar si, en caso de que se produzca un impacto significativo en la seguridad del suministro a sectores críticos y se cumplan los demás requisitos de necesidad, proporcionalidad y legalidad en las circunstancias del caso, la Comisión también debe imponer una obligación de pedido calificado de prioritario.

(51) Habida cuenta de la importancia de garantizar la seguridad del suministro a sectores críticos que desempeñan funciones sociales vitales, el cumplimiento de la obligación de realizar un pedido calificado de prioritario no debe implicar responsabilidad por daños frente a terceros por incumplimiento de las obligaciones contractuales que puedan derivarse de los cambios temporales necesarios en los procesos operativos del fabricante en cuestión, siendo esta limitada en la medida en que el incumplimiento de las obligaciones contractuales fuera necesario para cumplir el mandato de priorización. Las empresas potencialmente incluidas en el ámbito de un pedido calificado de prioritario deben anticipar esta posibilidad en las condiciones de sus contratos comerciales. Sin perjuicio de la aplicabilidad de otras disposiciones, la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, prevista en la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985[62], no se ve afectada por esta exención de responsabilidad.

(52) La obligación de dar prioridad a la producción de determinados productos respeta el contenido esencial de la libertad de empresa y la libertad contractual consagradas en el

---

62 Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (85/374/CEE) (DO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y no afectará de manera desproporcionada al derecho a la propiedad consagrado en el artículo 17 de la Carta. De conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, cualquier limitación del ejercicio de dichos derechos en el presente Reglamento deberá ser establecida por la ley, respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades y cumplir el principio de proporcionalidad.

(53) Cuando la fase de crisis esté activada, dos o más Estados miembros podrían encargar a la Comisión que agregue la demanda y actúe en su nombre en sus procesos de contratación pública en aras del interés público, de conformidad con las normas y procedimientos vigentes de la Unión, aprovechando su poder de compra. El mandato podría autorizar a la Comisión a celebrar acuerdos relativos a la compra de productos pertinentes para la crisis en determinados sectores críticos. La Comisión debe evaluar la utilidad, la necesidad y la proporcionalidad de cada solicitud en consulta con el Consejo Europeo de Semiconductores. Cuando tenga la intención de no dar curso a la solicitud, deberá informar a los Estados miembros afectados y al Consejo Europeo de Semiconductores e indicar sus razones. Además, los Estados miembros participantes deben tener derecho a designar representantes que proporcionarán orientación y asesoramiento durante los procedimientos de contratación pública y en la negociación de los acuerdos de compra. La implantación y el uso de los productos adquiridos deben seguir siendo competencia de los Estados miembros participantes.

(54) Durante una crisis de escasez de semiconductores podría resultar necesario que la Unión estudiara la aplicación de medidas de protección. El Consejo Europeo de Semiconductores podrá expresar su opinión para informar a la Comisión acerca de si la situación del mercado supone una escasez significativa de productos esenciales con arreglo al Reglamento (UE) 2015/479.

(55) A fin de facilitar una aplicación fluida, eficaz y armonizada del presente Reglamento, así como la cooperación y el intercambio de información, es preciso establecer el Consejo Europeo de Semiconductores. El Consejo Europeo de Semiconductores debe proporcionar asesoramiento y asistencia a la Comisión sobre cuestiones específicas. Estas cuestiones deben incluir el asesoramiento sobre la iniciativa Chips para Europa al Consejo de Autoridades Públicas de la Empresa Común de Chips; el intercambio de información sobre el funcionamiento de las instalaciones de producción integrada y las fundiciones abiertas de la UE; el debate y la preparación de la identificación de sectores y tecnologías específicos con un potencial impacto social elevado y una importancia respectiva en materia de seguridad que requieran la certificación de productos confiables y el tratamiento del seguimiento coordinado y la respuesta a las crisis. Además, el Consejo Europeo de Semiconductores debe garantizar la aplicación coherente del presente Reglamento, facilitar la cooperación entre los Estados miembros y el intercambio de información sobre cuestiones relacionadas con el presente Reglamento. El Consejo Europeo de Semiconductores debe apoyar a la Comisión en la cooperación internacional en consonancia con las obligaciones internacionales, incluida la recopilación de información y la evaluación de crisis. Además, el Consejo Europeo de Semiconductores debe coordinar, cooperar e intercambiar información con otras estructuras de la Unión encargadas de la respuesta y preparación ante crisis, con vistas a garantizar un enfoque coherente y coordinado de la Unión en lo que respecta a la respuesta a las crisis y a las medidas de preparación frente a crisis en caso de crisis de semiconductores.

(56) Un representante de la Comisión presidirá el Consejo Europeo de Semiconductores. El punto de contacto único nacional de cada Estado miembro debe designar al menos un

representante de alto nivel en el Consejo Europeo de Semiconductores. También podrían designar a diferentes representantes en relación con las diferentes tareas del Consejo Europeo de Semiconductores, por ejemplo, en función del capítulo del presente Reglamento que se debata en las reuniones del Consejo Europeo de Semiconductores. La Comisión podrá crear subgrupos y debe estar facultada para establecer acuerdos de trabajo invitando a expertos a participar en las reuniones con carácter puntual o invitando en sus subgrupos a organizaciones que representen los intereses de la industria de los semiconductores de la Unión, como la Alianza industrial sobre tecnologías de procesadores y semiconductores, en calidad de observadores.

(57) El Consejo Europeo de Semiconductores celebrará reuniones separadas para las tareas correspondientes al capítulo II y para las tareas correspondientes a los capítulos III y IV. Los Estados miembros deben esforzarse por garantizar una cooperación eficaz y eficiente en el Consejo Europeo de Semiconductores. La Comisión debe poder facilitar los intercambios entre el Consejo Europeo de Semiconductores y otros órganos, oficinas, agencias y grupos consultivos de la Unión. Habida cuenta de la importancia del suministro de semiconductores para otros sectores y de la consiguiente necesidad de coordinación, la Comisión debe garantizar la participación de otras instituciones y organismos de la Unión en calidad de observadores en las reuniones del Consejo Europeo de Semiconductores, cuando sea pertinente y proceda en relación con el mecanismo de seguimiento y respuesta a las crisis establecido en el capítulo IV. Con el fin de continuar y aprovechar la labor a raíz de la aplicación de la Recomendación de la Comisión sobre un conjunto de instrumentos comunes de la Unión para hacer frente a la escasez de semiconductores, el Consejo Europeo de Semiconductores debe llevar a cabo las tareas del Grupo Europeo de Expertos en Semiconductores. Una vez que el Consejo Europeo de Semiconductores esté operativo, el grupo de expertos debe dejar de existir.

(58) Los Estados miembros desempeñan un papel clave en la aplicación y el cumplimiento del presente Reglamento. A este respecto, cada Estado miembro debe designar una o varias autoridades nacionales competentes a efectos de la aplicación efectiva del presente Reglamento y garantizar que dichas autoridades estén debidamente capacitadas y dotadas de los recursos necesarios. Los Estados miembros podrían designar una o varias autoridades existentes. Con el fin de aumentar la eficiencia organizativa en los Estados miembros y de establecer un punto de contacto oficial ante el público y otros interlocutores a escala de los Estados miembros y de la Unión, incluida la Comisión y el Consejo Europeo de Semiconductores, cada Estado miembro debe designar, de entre una de las autoridades que haya designado como autoridad competente en virtud del presente Reglamento, un punto de contacto único nacional responsable de coordinar las cuestiones relacionadas con el presente Reglamento y la cooperación transfronteriza con las autoridades competentes de otros Estados miembros.

(59) Todas las partes implicadas en la aplicación del presente Reglamento deben respetar la confidencialidad de la información y los datos que obtengan en el ejercicio de sus funciones, con vistas a garantizar la cooperación fiable y constructiva de las autoridades competentes en la Unión y a escala nacional. La Comisión y las autoridades nacionales competentes, sus funcionarios, agentes y otras personas que trabajen bajo la supervisión de dichas autoridades, así como los funcionarios de otras autoridades de los Estados miembros, no deben divulgar la información que hayan obtenido o intercambiado en virtud del presente Reglamento y que, por su naturaleza,

esté amparada por el secreto profesional. Esto también debe aplicarse al Consejo Europeo de Semiconductores y al Comité de Semiconductores establecidos en el presente Reglamento. Cuando proceda, la Comisión debe poder adoptar actos de ejecución a fin de especificar las disposiciones prácticas para el tratamiento de la información confidencial en el contexto de la recopilación de información.

(60) El cumplimiento de las obligaciones impuestas en virtud del presente Reglamento debe garantizarse mediante multas y multas coercitivas. A tal fin, también deben establecerse niveles adecuados para las multas y multas coercitivas en caso de incumplimiento de las obligaciones. Deben aplicarse plazos de prescripción a la imposición de multas y multas coercitivas, además de los plazos de prescripción para la ejecución de sanciones. Asimismo, la Comisión debe conceder a la empresa o a las organizaciones representantes de las empresas de que se trate el derecho a ser oídas.

(61) Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado, con el fin de modificar el anexo I del presente Reglamento para reflejar los cambios tecnológicos y la evolución del mercado, en lo que respecta a las acciones que en él se establecen, de manera coherente con los objetivos del presente Reglamento, y su anexo II con respecto a los indicadores mensurables cuando se considere necesario, así como para completar el presente Reglamento con disposiciones sobre el establecimiento de un marco de seguimiento y evaluación. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que dichas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación[63]. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(62) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a la selección de los CEIC y al procedimiento para establecer y definir las tareas de los centros de competencia y al procedimiento para establecer la red, de modo que se alcancen los objetivos de la iniciativa. Además, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para activar la fase de crisis en una crisis de semiconductores, con objeto de permitir una respuesta rápida y coordinada, y para especificar las disposiciones prácticas en relación con el tratamiento de la información confidencial. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo[64].

(63) Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, debido a la dimensión o efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado. De conformidad

---

63 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

64 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

con el principio de proporcionalidad establecido en ese mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Objeto

1. El presente Reglamento establece un marco para reforzar el sector de los semiconductores a escala de la Unión, en particular mediante las siguientes medidas:

   a) crear la Iniciativa Chips para Europa (en lo sucesivo, «la Iniciativa»);

   b) determinar los criterios para el reconocimiento y el apoyo a las instalaciones de producción integrada pioneras y las fundiciones abiertas de la UE que fomenten la seguridad del suministro de semiconductores en la Unión;

   c) establecer un mecanismo de coordinación entre los Estados miembros y la Comisión para supervisar el suministro de semiconductores y la respuesta a las crisis ante la escasez de semiconductores.

Artículo 2
Definiciones

1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

   1) «semiconductor»: uno de los siguientes elementos:

      a) un material, ya sea un elemento, como el silicio, o un compuesto, como el carburo de silicio, cuya conductividad eléctrica puede modificarse, o

      b) un componente formado por una serie de capas de materiales semiconductores, aislantes y conductores, configuradas con arreglo a un patrón predeterminado, y que está destinado a desempeñar funciones electrónicas o fotónicas bien definidas;

   2) «chip»: dispositivo electrónico compuesto por diversos elementos funcionales en una sola pieza de material semiconductor, normalmente en forma de memoria, dispositivo lógico, procesador y dispositivos analógicos, también denominado «circuito integrado»;

   3) «nodo tecnológico»: estructura de un semiconductor que sirve como elemento de tránsito y proporciona una medida en nanómetros del método de fabricación;

   4) «cadena de suministro de semiconductores»: sistema de actividades, organizaciones, agentes, tecnología, información, recursos y servicios que participan en la producción de semiconductores, que incluye las materias primas, el equipo de fabricación, el diseño, la fabricación, el montaje, el ensayo y el empaquetado;

   5) «cadena de valor de los semiconductores»: conjunto de actividades relacionadas con un producto semiconductor, desde su concepción hasta su uso

final, como las materias primas, el equipo de fabricación, la investigación, el diseño, la fabricación, la prueba, el ensamblado y el empaquetado, hasta la incorporación y validación en los productos finales;

6) «línea piloto»: proyecto o acción experimentales que abordan niveles más elevados de madurez tecnológica a partir de los niveles 3 a 8, a fin de seguir desarrollando una infraestructura facilitadora necesaria para probar, demostrar y calibrar un producto o sistema con las hipótesis de modelo;

7) «coordinador»: entidad jurídica que es miembro de un Consorcio Europeo de Infraestructuras de Chips creado de conformidad con el artículo 7 y que ha sido designada por todos los miembros de dicho consorcio como punto de contacto principal a efectos de las relaciones del Consorcio con la Comisión;

8) «pequeñas y medianas empresas» o «pymes»: pequeñas y medianas empresas en el sentido de lo dispuesto en el artículo 2 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión[65];

9) «empresa de mediana capitalización»: empresa distinta de una pyme y que cuenta con un máximo de 1 500 personas, según un cálculo de plantilla realizado de conformidad con los artículos 3 a 6 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE;

10) «instalación pionera»: instalación industrial capaz de producir semiconductores, incluida la etapa de fabricación o la etapa de empaquetado, ensamblado y prueba, o ambas, que aún no está plenamente presente o sobre cuya construcción en la Unión aún no hay compromiso alguno, por ejemplo en lo que se refiere al nodo tecnológico, el material de sustrato, como el carburo de silicio y el nitruro de galio, y otra innovación de productos que permita ofrecer mejores prestaciones, innovar los procesos y mejorar el rendimiento energético y el comportamiento medioambiental;

11) «chips de próxima generación» y «tecnologías de semiconductores de próxima generación»: tecnologías de chips y de semiconductores que sobrepasan el estado actual de la técnica al ofrecer mejoras significativas en potencia computacional o eficiencia energética, así como otros beneficios significativos en materia de energía y medio ambiente;

12) «etapa de fabricación» (*front-end*): la totalidad de la elaboración de una oblea de un material semiconductor;

13) «etapa de empaquetado, ensamblado y prueba» (*back-end*): el empaquetado, el ensamblado y la prueba de cada circuito integrado;

14) «usuario de semiconductores»: empresa que fabrica productos en los que se incorporan semiconductores;

15) «agentes clave del mercado»: empresas del sector de los semiconductores de la Unión cuyo funcionamiento fiable es esencial para la cadena de suministro de semiconductores;

16) «sector crítico»: cualquier sector contemplado en el anexo de la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la

---

65 Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

resiliencia de las entidades críticas, el sector de la defensa y otras actividades que sean pertinentes para la seguridad pública;

17) «producto pertinente para la crisis»: semiconductores, productos intermedios y materias primas necesarios para producir semiconductores o productos intermedios y que se ven afectados por la crisis en el sector de los semiconductores o que revisten una importancia estratégica para resolver tal crisis o sus efectos económicos;

18) «capacidad teórica de producción»: la producción que puede alcanzar una instalación de fabricación de semiconductores con recursos óptimos, normalmente la cantidad de obleas de un determinado tamaño que puede elaborarse en un tiempo determinado;

19) «capacidad efectiva de producción»: la producción de una instalación de fabricación de semiconductores, normalmente la cantidad de obleas de un determinado tamaño que normalmente se elabora en un momento determinado.

CAPÍTULO II

INICIATIVA CHIPS PARA EUROPA

SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3
Creación de la iniciativa

1. Se crea la iniciativa, cuya duración será la del marco financiero plurianual 2021-2027.

2. La iniciativa recibirá financiación del programa Horizonte Europa y del programa Europa Digital, y en particular de su objetivo específico 6, por un importe indicativo máximo de 1 650 millones EUR y 1 650 millones EUR, respectivamente. La financiación mencionada se ejecutará de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/695 y el Reglamento (UE) 2021/694.

Artículo 4
Objetivos de la iniciativa

1. La iniciativa tiene por objetivo general apoyar el desarrollo de capacidades tecnológicas a gran escala y la innovación en toda la Unión para permitir el desarrollo y la implantación de tecnologías cuánticas y semiconductores de vanguardia y de próxima generación, que reforzarán las capacidades de diseño avanzado, integración de sistemas y producción de chips de la Unión, así como contribuir a la consecución de la doble transición digital y ecológica.

2. La iniciativa contará con los cinco objetivos operativos siguientes:

a) desarrollar capacidades de diseño avanzado a gran escala para tecnologías integradas de semiconductores. Este objetivo operativo se alcanzará como se indica a continuación:

   1) creando una plataforma virtual innovadora, disponible en toda la Unión, que integre las instalaciones de diseño existentes y las nuevas con bibliotecas ampliadas y herramientas de automatización del diseño electrónico (EDA);

   2) mejorando la capacidad de diseño con los avances innovadores en curso, como arquitecturas de procesadores basadas en la arquitectura de conjunto de instrucciones reducido de código abierto (RISC-V);

   3) ampliando el ecosistema de semiconductores mediante la integración de los sectores del mercado vertical, contribuyendo a la consecución de los objetivos en los ámbitos ecológico, digital y de innovación de la Unión.

b) mejorando las líneas piloto avanzadas existentes y creando nuevas. Este objetivo operativo se alcanzará como se indica a continuación:

   1) reforzando las capacidades tecnológicas en tecnologías de producción de chips de próxima generación, mediante la integración de actividades de investigación e innovación y la preparación del desarrollo de futuros nodos tecnológicos, incluidos los nodos de vanguardia inferiores a dos nanómetros, el silicio sobre aislante completamente empobrecido (FD-SOI) en 10 nanómetros y menos, y la integración de sistemas heterogéneos 3D y el empaquetado avanzado;

   2) apoyando la innovación a gran escala mediante el acceso a líneas piloto nuevas o existentes para la experimentación, el ensayo y la validación de nuevos conceptos de diseño que integren funcionalidades clave, como nuevos materiales y arquitecturas para la electrónica de potencia que fomenten la energía sostenible y la electromovilidad, un menor consumo de energía, la seguridad, mayores niveles de prestaciones de computación o que integren tecnologías revolucionarias como los chips de inteligencia artificial (IA) neuromórficos e incorporados, la fotónica integrada, el grafeno y otras tecnologías basadas en materiales 2D;

   3) prestando apoyo a las instalaciones de producción integrada y a las fundiciones abiertas de la UE mediante el acceso prioritario a las nuevas líneas piloto.

c) creando capacidades tecnológicas y de ingeniería avanzadas para acelerar el desarrollo innovador de chips cuánticos.

d) creando una red de centros de competencias en toda la Unión, con los fines siguientes:

   1) reforzar las capacidades y ofrecer una amplia variedad de conocimientos especializados a las partes interesadas, incluidas las pymes y las empresas emergentes que sean usuarias finales, facilitando el acceso a las capacidades e instalaciones antes mencionadas y su uso eficaz;

   2) abordar la escasez de capacidades, atraer y movilizar nuevos talentos y apoyar la formación de trabajadores con las capacidades adecuadas para fortalecer el sector de los semiconductores, en particular mediante el reciclaje profesional y la mejora de las capacidades de los trabajadores.

e) emprender actividades, que se describirán colectivamente como actividades del «Fondo de Chips», a fin de facilitar el acceso a la financiación de la deuda y al capital por parte de empresas emergentes, empresas emergentes en expansión, pymes y otras empresas de la cadena de valor de los semiconductores, a través de un mecanismo de financiación combinada en el marco del Fondo InvestEU y a través del Consejo Europeo de Innovación, con vistas a:

1) mejorar el efecto de apalancamiento del gasto presupuestario de la Unión y lograr un mayor efecto multiplicador para atraer inversión del sector financiero privado;

2) prestar apoyo a las empresas que se enfrenten a dificultades para acceder a financiación y abordar la necesidad de reforzar la resiliencia económica de la Unión y de sus Estados miembros;

3) acelerar las inversiones en el ámbito de las tecnologías de fabricación de semiconductores y el diseño de chips y movilizar financiación tanto del sector público como del privado, incrementando también la seguridad del suministro para toda la cadena de valor de los semiconductores.

Artículo 5
Componentes de la iniciativa

1. La iniciativa constará de los cinco componentes siguientes:

a) capacidades de diseño para tecnologías de semiconductores integradas;

b) líneas piloto para la preparación de instalaciones innovadoras de producción, ensayo y experimentación;

c) capacidades avanzadas de tecnología e ingeniería para chips cuánticos;

d) una red de centros de competencias y de desarrollo de capacidades;

e) actividades del «Fondo de Chips» en pro del acceso a la financiación mediante deuda y capital a empresas emergentes, empresas en expansión, pymes y otras empresas de la cadena de valor de los semiconductores.

Artículo 6
Sinergias con los programas de la Unión

1. La iniciativa permitirá establecer sinergias con los programas de la Unión a que se refiere el anexo III. La Comisión velará por que la consecución de los objetivos no se vea obstaculizada al potenciar el carácter complementario de la iniciativa con otros programas de la Unión.

Artículo 7
Consorcio Europeo de Infraestructuras de Chips

1. A efectos de la ejecución de las acciones subvencionables y otras tareas conexas financiadas en el marco de la iniciativa, podrá crearse un Consorcio Europeo de Infraestructuras de Chips (CEIC) con arreglo a las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. El CEIC:

a) tendrá personalidad jurídica a partir de la fecha de entrada en vigor de la decisión de la Comisión a que se refiere el apartado 6;

b) tendrá una o varias sedes sociales, que estarán situadas en el territorio de uno o varios Estados miembros;

c) estará compuesto por al menos tres entidades jurídicas de al menos tres Estados miembros y será gestionado como consorcio público-privado, con la participación de los Estados miembros y de entidades jurídicas privadas;

d) designará al coordinador.

3. El coordinador presentará a la Comisión una solicitud por escrito que contendrá lo siguiente:

a) una solicitud a la Comisión para crear el CEIC, así como una lista de las entidades jurídicas propuestas para formar el CEIC;

b) el proyecto de estatutos del CEIC, que incluirá, como mínimo, disposiciones sobre los elementos siguientes: el procedimiento de constitución, la composición, el presupuesto, la sede legal, la legislación y la jurisdicción aplicables, la propiedad de los resultados, la gobernanza, en particular el procedimiento de toma de decisiones, el papel específico y, en su caso, los derechos de voto de los Estados miembros y de la Comisión, la liquidación, la presentación de informes y la responsabilidad.

4. La Comisión evaluará la solicitud de creación del CEIC sobre la base de todos los criterios siguientes:

a) las competencias, los conocimientos técnicos y las capacidades adecuados del CEIC propuesto y de las entidades jurídicas que lo formen con respecto a los semiconductores;

b) la capacidad de gestión, el personal y la infraestructura adecuados que son necesarios para llevar a cabo las acciones admisibles en el marco de la iniciativa;

c) los medios operativos y jurídicos requeridos para aplicar las normas administrativas, contractuales y financieras establecidas a nivel de la Unión;

d) la viabilidad financiera adecuada correspondiente al nivel de fondos de la Unión que se le pedirá que gestione, demostrada, cuando proceda, mediante garantías emitidas preferiblemente por una autoridad pública;

e) el presupuesto que los Estados miembros y los participantes del sector privado pondrán a disposición para la financiación del CEIC, y las modalidades correspondientes;

f) la capacidad adecuada del CEIC para garantizar que se satisfacen las necesidades de la industria.

5. La Comisión, mediante un acto de ejecución y sobre la base de los criterios establecidos en el apartado 4, adoptará una de las decisiones siguientes:

a) crear el CEIC después de haber llegado a la conclusión de que se reúnen los requisitos establecidos en los apartados 3 y 4;

b) denegar la solicitud si llega a la conclusión de que no se reúnen los requisitos establecidos en los apartados 3 y 4.

El acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 33, apartado 2.

6. La decisión a que se refiere el apartado 5 se notificará a los solicitantes.

7. La Decisión por la que se crea el CEIC se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

8. El CEIC gozará de una autonomía global sustancial para determinar su composición, gobernanza, financiación, presupuesto y las modalidades para recabar las respectivas contribuciones financieras de los miembros, así como los derechos de voto y los métodos de trabajo. No obstante, la organización, la composición y los métodos de trabajo del CEIC, incluidas las modificaciones de los estatutos, se notificarán a la Comisión y deberán estar en consonancia con los fines y objetivos del presente Reglamento y de la Iniciativa Chips para Europa, así como contribuir a su consecución.

9. El CEIC elaborará un informe anual de actividades, que incluirá una descripción técnica de sus actividades y los estados financieros. El informe anual de actividades se enviará a la Comisión y se pondrá a disposición del público. La Comisión podrá formular recomendaciones sobre los asuntos tratados en el informe anual de actividades.

Artículo 8

Red Europea de Centros de Competencias en materia de Semiconductores

1. A efectos de la ejecución de acciones en el marco del componente de la iniciativa a que se refiere el artículo 5, letra d), podrá crearse una red europea de centros de competencias en materia de semiconductores (en lo sucesivo, «la Red»).

2. Con respecto a la ejecución de las acciones en el marco del componente de la iniciativa a que se refiere el artículo 5, letra d), la Red podrá llevar a cabo la totalidad o parte de las actividades siguientes en beneficio de la industria de la Unión, en particular de las pymes y las empresas de mediana capitalización, así como del sector público:

   a) proporcionar acceso a servicios y herramientas de diseño en el marco del componente de la iniciativa a que se refiere el artículo 5, letra a), así como a las líneas piloto apoyadas en el marco del componente de la iniciativa a que se refiere el artículo 5, letra b);

   b) sensibilizar y proporcionar a las partes interesadas el saber hacer, los conocimientos especializados y las capacidades necesarios para ayudarlas a acelerar el desarrollo y la integración de tecnologías de semiconductores, opciones de diseño y conceptos de sistemas nuevos mediante el uso eficaz de la infraestructura;

   c) sensibilizar y facilitar o garantizar el acceso a conocimientos especializados, saber hacer y servicios, incluida la madurez del diseño del sistema, líneas piloto nuevas y existentes y las acciones de apoyo necesarias para desarrollar capacidades y competencias respaldadas por la presente iniciativa;

d) facilitar la transferencia de conocimientos especializados y saber hacer entre Estados miembros y regiones, fomentando el intercambio de capacidades, conocimientos y buenas prácticas, así como los programas conjuntos;

e) desarrollar y gestionar acciones de formación específicas sobre tecnologías de semiconductores para apoyar el desarrollo de la reserva de talento en la Unión.

3. Los Estados miembros designarán los centros de competencias candidatos de conformidad con sus procedimientos y estructuras administrativas e institucionales nacionales a través de un proceso abierto y competitivo. La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, el procedimiento para crear centros de competencias, en particular los criterios de selección, así como otras tareas y funciones de los centros con respecto a la ejecución de las acciones en el marco de la iniciativa, el procedimiento para crear la Red y adoptar decisiones sobre la selección de las entidades que la formen. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 33, apartado 2.

4. La Red dispondrá de una amplia autonomía global a la hora de determinar su organización, composición y métodos de trabajo. No obstante, la organización, la composición y los métodos de trabajo de la Red deberán estar en consonancia con los fines y objetivos del presente Reglamento y de la iniciativa, así como contribuir a su consecución.

Artículo 9
Ejecución

1. Los componentes enumerados en el artículo 5, letras a) a d), en el marco de la iniciativa, podrán confiarse a la Empresa Común de Chips a que se refiere el Reglamento XX/XX del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/2085 del Consejo, y ejecutarse en el programa de trabajo de esta.

2. A fin de reflejar el cambio tecnológico y la evolución del mercado, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, con arreglo al artículo 32, a fin de modificar el anexo I en lo referente a las actividades establecidas en él en consonancia con los objetivos de la iniciativa, según lo establecido en el artículo 4.

3. A fin de garantizar la ejecución y la evaluación efectivas de la iniciativa, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, con arreglo al artículo 32, a fin de modificar el anexo II en lo referente a los indicadores mensurables para supervisar la ejecución de la iniciativa e informar sobre la consecución de sus objetivos, establecidos en el artículo 4.

CAPÍTULO III

SEGURIDAD DEL SUMINISTRO

Artículo 10
Instalaciones de producción integrada

1. Las instalaciones de producción integrada son instalaciones pioneras de diseño y producción de semiconductores, que incluyen la etapa de fabricación o la etapa de empaquetado, ensamblado y prueba, o ambas, que están situadas en la Unión y que contribuyen a la seguridad del suministro destinado al mercado interior.

2. Las instalaciones de producción integrada reunirán los criterios siguientes:

a) cumplen los requisitos para ser consideradas instalaciones pioneras;

b) su creación y su funcionamiento tienen un claro impacto positivo en la cadena de valor de los semiconductores de la Unión a la hora de garantizar la seguridad del suministro y aumentar el número de trabajadores cualificados;

c) garantizan que no están sujetas a la aplicación extraterritorial de obligaciones de servicio público de terceros países de manera que pueda menoscabarse la capacidad de la empresa de cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 21, apartado 1, y se comprometen a informar a la Comisión cuando surja dicha obligación;

d) se comprometen a invertir en la próxima generación de chips.

3. A efectos de invertir en la próxima generación de chips de conformidad con el apartado 2, letra d), las instalaciones de producción integrada tendrán acceso prioritario a las líneas piloto establecidas de conformidad con el artículo 5, letra b). Tal acceso prioritario se entenderá sin perjuicio del acceso efectivo a las líneas piloto por parte de otras empresas interesadas.

Artículo 11
Fundiciones abiertas de la UE

1. Las fundiciones abiertas de la UE son instalaciones pioneras de producción de semiconductores, que incluyen la etapa de fabricación o la etapa de empaquetado, ensamblado y prueba, o ambas, que están situadas en la Unión y que ofrecen capacidad efectiva de producción a empresas no vinculadas, favoreciendo así la seguridad del suministro destinado al mercado interior.

2. Las fundiciones abiertas de la UE cumplirán los criterios siguientes:

a) cumplen los requisitos para ser consideradas instalaciones pioneras;

b) su creación y funcionamiento tienen un claro impacto positivo en la cadena de valor de los semiconductores de la Unión a la hora de garantizar la seguridad del suministro y aumentar el número de trabajadores cualificados, teniendo en cuenta, en particular, en qué medida ofrecen capacidad efectiva de producción, de la etapa de fabricación o de la etapa de empaquetado, ensamblado y prueba, o de ambas, a empresas no vinculadas a la instalación, en caso de existir suficiente demanda;

c) garantizan que no están sujetas a la aplicación extraterritorial de obligaciones de servicio público de terceros países de manera que pueda menoscabarse la capacidad de la empresa de cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 21, apartado 1, y se comprometen a informar a la Comisión cuando surja dicha obligación;

d) se comprometen a invertir en la próxima generación de chips.

3. En aquellos casos en que una fundición abierta de la UE ofrezca capacidad efectiva de producción a empresas no vinculadas al operador de la instalación, establecerá y mantendrá una separación funcional adecuada y efectiva de los procesos de diseño y fabricación, a fin de garantizar la protección de la información obtenida en cada fase.

4. A efectos de invertir en la próxima generación de chips de conformidad con el apartado 2, letra d), las fundiciones abiertas de la UE tendrán acceso prioritario a las

líneas piloto establecidas de conformidad con el artículo 5, letra b). Tal acceso prioritario se entenderá sin perjuicio del acceso efectivo a las líneas piloto por parte de otras empresas interesadas.

Artículo 12
Solicitud y reconocimiento

1. Cualquier empresa o consorcio de empresas (en lo sucesivo, «el solicitante») podrá presentar una solicitud a la Comisión para que la instalación prevista del solicitante sea reconocida como instalación de producción integrada o fundición abierta de la UE.

2. La Comisión, en consulta con el Consejo Europeo de Semiconductores, evaluará la solicitud mediante un proceso equitativo y transparente basado en los siguientes elementos:

   a) el cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 10, apartado 2, o en el artículo 11, apartado 2, respectivamente;

   b) un plan de negocio que evalúe la viabilidad financiera del proyecto, que incluya información sobre cualquier ayuda pública prevista;

   c) la experiencia demostrada del solicitante en la instalación y explotación de instalaciones similares;

   d) la presentación de un documento justificativo adecuado que demuestre la disposición del Estado o Estados miembros en los que el solicitante tenga la intención de establecer su instalación para facilitar la creación de dicha instalación.

   La Comisión tramitará la solicitud, adoptará oportunamente su decisión y la notificará al solicitante.

3. La Comisión supervisará las actividades de las instalaciones de producción integrada y las fundiciones abiertas de la UE. En aquellos casos en que la Comisión constate que una instalación ha dejado de cumplir los criterios establecidos en el artículo 10, apartado 2, o en el artículo 11, apartado 2, respectivamente, notificará sus conclusiones al Consejo Europeo de Semiconductores. Una vez se haya consultado al Consejo Europeo de Semiconductores y se haya escuchado a la instalación, la Comisión podrá derogar la decisión por la que se concede a una instalación la condición de instalación de producción integrada o de fundición abierta de la UE.

4. La Comisión, previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, podrá revocar una decisión por la que se reconozca la condición de instalación de producción integrada o de fundición abierta de la UE si el reconocimiento se basa en una solicitud con información incorrecta.

5. Las instalaciones que dejen de ser instalaciones de producción integrada y fundiciones abiertas de la UE perderán todos los derechos relacionados con el reconocimiento de esta condición derivados del presente Reglamento.

Artículo 13
Interés y apoyo públicos

1. Se considerará que las instalaciones de producción integrada y las fundiciones abiertas de la UE contribuyen a la seguridad del suministro de semiconductores en la Unión y que, por tanto, redundan en interés público.

2. A fin de lograr la seguridad del suministro en la Unión, los Estados miembros podrán, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicar regímenes de apoyo y prestar apoyo administrativo a las instalaciones de producción integrada y a las fundiciones abiertas de la UE de conformidad con el artículo 14.

Artículo 14
Agilización nacional de los procedimientos de concesión de autorizaciones

1. Los Estados miembros velarán por que las solicitudes administrativas relativas a la planificación, construcción y explotación de instalaciones de producción integrada y fundiciones abiertas de la UE se tramiten de manera eficiente y oportuna. A tal fin, todas las autoridades nacionales afectadas velarán por que se dé a estas solicitudes el tratamiento más rápido legalmente posible.

2. En aquellos casos en que tal estatuto exista en la legislación nacional, se asignará, a las instalaciones de producción integrada y a las fundiciones abiertas de la UE, el estatuto de la máxima importancia nacional posible y se las tratará como tal en los procesos de concesión de autorizaciones, y en particular en los relativos a las evaluaciones medioambientales y, si así lo dispone la legislación nacional, en la ordenación del territorio.

3. La seguridad del suministro de semiconductores puede considerarse una razón imperiosa de interés público de primer orden en el sentido del artículo 6, apartado 4, y del artículo 16, apartado 1, letra c), de la Directiva 92/43/CEE, y de interés público superior en el sentido del artículo 4, apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE. Por lo tanto, la planificación, la construcción y la explotación de instalaciones de producción integrada y de fundiciones abiertas de la UE pueden considerarse de interés público superior, siempre que se cumplan las demás condiciones establecidas en dichas disposiciones.

4. Para cada instalación de producción integrada y fundición abierta de la UE, el Estado miembro de que se trate designará a una autoridad responsable de facilitar y coordinar las solicitudes administrativas relacionadas con la planificación, la construcción y la explotación. La autoridad designará un coordinador que actuará como punto de contacto único para la instalación de producción integrada o la fundición abierta de la UE. La autoridad podrá crear un grupo de trabajo en el que estén representadas todas las autoridades que intervienen en las solicitudes administrativas, con el fin de elaborar un calendario de concesión de autorizaciones y de supervisar y coordinar su ejecución. Si la creación de una instalación de producción integrada o de una fundición abierta de la UE requiere que se tomen decisiones en dos o más Estados miembros, las autoridades respectivas adoptarán todas las medidas necesarias en pro de una cooperación y coordinación eficientes y eficaces entre ellas.

CAPÍTULO IV

SUPERVISIÓN Y RESPUESTA A LAS CRISIS

SECCIÓN 1
SUPERVISIÓN

Artículo 15
Supervisión y alerta

1. Los Estados miembros supervisarán periódicamente la cadena de valor de los semiconductores. En particular:

   a) supervisarán los indicadores de alerta temprana identificados con arreglo al artículo 16;

   b) supervisarán la disponibilidad e integridad de los servicios y bienes suministrados por los agentes clave del mercado identificados con arreglo al artículo 17.

   Los Estados miembros comunicarán las conclusiones pertinentes al Consejo Europeo de Semiconductores en forma de actualizaciones periódicas.

2. Los Estados miembros invitarán a los principales usuarios de semiconductores y a otras partes interesadas pertinentes a que faciliten información sobre las fluctuaciones significativas de la demanda y las alteraciones conocidas de su cadena de suministro. Para facilitar el intercambio de información, los Estados miembros establecerán un mecanismo y una estructura administrativa para estas actualizaciones.

3. Las autoridades nacionales competentes designadas con arreglo al artículo 26, apartado 1, podrán solicitar información a organizaciones representativas de empresas o a empresas que operen a lo largo de la cadena de suministro de semiconductores en aquellos casos en que sea necesario y proporcionado a efectos del apartado 1. En tal caso, las autoridades nacionales competentes prestarán especial atención a las pymes, a fin de minimizar la carga administrativa derivada de la solicitud y favorecerán las soluciones digitales para obtener dicha información. Toda información obtenida en virtud del presente apartado será tratada de conformidad con las obligaciones de confidencialidad establecidas en el artículo 27.

4. En aquellos casos en que un Estado miembro tenga conocimiento de una posible crisis en el sector de los semiconductores o de una fluctuación significativa de la demanda o disponga de información concreta y fiable sobre la materialización de cualquier otro factor de riesgo o acontecimiento, alertará inmediatamente de ello a la Comisión («alerta temprana»).

5. En aquellos casos en que la Comisión tenga conocimiento de una posible crisis en el sector de los semiconductores, de una fluctuación significativa de la demanda o disponga de información concreta y fiable sobre la materialización de cualquier otro factor de riesgo o acontecimiento, sobre la base de una alerta de un Estado miembro facilitada de conformidad con el apartado 4, o a través de otras fuentes, como la información procedente de socios internacionales, deberá, sin demora injustificada:

a) convocar una reunión extraordinaria del Consejo Europeo de Semiconductores para coordinar las siguientes acciones:

1) evaluar si está justificada la activación de la fase de crisis a que se refiere el artículo 18;

2) debatir si puede ser apropiado, necesario y proporcionado que los Estados miembros adquieran conjuntamente semiconductores, productos intermedios o materias primas afectados o amenazados por una posible crisis en el sector de los semiconductores («contratación coordinada»);

b) entablará consultas o cooperará, en nombre de la Unión, con los terceros países pertinentes con el fin de buscar soluciones de cooperación para hacer frente a las alteraciones de la cadena de suministro, de conformidad con las obligaciones internacionales. Esto podrá requerir, en su caso, coordinación en los foros internacionales pertinentes.

6. La contratación coordinada a que se refiere el apartado 5, letra a), inciso ii), será llevada a cabo por los Estados miembros de conformidad con las normas establecidas en el artículo 38 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[66].

7. Las autoridades nacionales competentes designadas con arreglo al artículo 26, apartado 1, elaborarán una cartografía de las empresas que operen a lo largo de la cadena de suministro de semiconductores en su territorio nacional, que incluirá información no confidencial sobre los servicios o productos, así como información de contacto. Notificarán esta lista y cualquier actualización posterior a la Comisión. Previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, la Comisión podrá publicar orientaciones para especificar en mayor medida la información que debe recogerse y definir las especificaciones técnicas y los formatos.

Artículo 16
Evaluación de riesgos e indicadores de alerta temprana de la Unión

1. Previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, la Comisión evaluará los riesgos que puedan alterar, poner en peligro o perjudicar el suministro de semiconductores (evaluación de riesgos de la Unión). En la evaluación de riesgos de la Unión, la Comisión establecerá los indicadores de alerta temprana.

2. La Comisión revisará la evaluación de riesgos de la Unión, incluidos los indicadores de alerta temprana, según sea necesario.

3. Al supervisar la cadena de valor de los semiconductores de conformidad con el artículo 15, los Estados miembros supervisarán los indicadores de alerta temprana establecidos por la Comisión.

[66] Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).

Artículo 17
Agentes clave del mercado

1. Los Estados miembros identificarán a los agentes clave del mercado a lo largo de las cadenas de suministro de semiconductores en su territorio nacional, teniendo en cuenta los siguientes elementos:

   a) el número de otras empresas de la Unión que dependen de los servicios o de los bienes proporcionados por un agente del mercado;

   b) la cuota de mercado de dichos servicios o bienes del agente clave del mercado a escala mundial o de la Unión;

   c) la importancia de un agente del mercado para mantener un nivel suficiente de suministro de un bien o servicio en la Unión, teniendo en cuenta la disponibilidad de otros medios para proporcionar dicho bien o servicio;

   d) el impacto que una alteración del suministro del bien o servicio proporcionado por el agente del mercado pueda tener en la cadena de suministro de semiconductores de la Unión y en los mercados dependientes.

2. Al supervisar la cadena de valor de los semiconductores de conformidad con el artículo 15, los Estados miembros, previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, realizarán un seguimiento de la disponibilidad e integridad de los servicios o bienes que proporcionan los agentes clave del mercado.

SECCIÓN 2
FASE DE CRISIS DE SUMINISTRO DE SEMICONDUCTORES

Artículo 18
Activación de la fase de crisis

1. Se considerará que existe una crisis en el sector de los semiconductores cuando se produzcan alteraciones graves en el suministro de semiconductores que provoquen una escasez significativa que:

   a) entrañe retrasos significativos o efectos negativos significativos en uno o más sectores económicos importantes de la Unión, o

   b) impida el suministro, la reparación y el mantenimiento de productos esenciales utilizados por sectores críticos.

2. En aquellos casos en que una evaluación de la Comisión aporte pruebas concretas, graves y fiables de una crisis en el sector de los semiconductores, la Comisión podrá activar la fase de crisis mediante actos de ejecución de conformidad con el artículo 33, apartado 2. La duración de la activación se especificará en el acto de ejecución. En aquellos casos en que, habida cuenta del alcance y la gravedad de la crisis en el sector de los semiconductores, existan razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas que así lo exijan, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 33, apartado 3, a los actos de ejecución adoptados en virtud del presente artículo.

3. Antes de que expire el período iniciado con la activación de la fase de crisis, la Comisión, previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, evaluará si debe prolongarse la activación de la fase de crisis. Si la evaluación llega a la conclusión de

que procede prorrogar dicha activación, la Comisión podrá hacerlo mediante actos de ejecución. La duración de la prórroga se especificará en los actos de ejecución adoptados de conformidad con el artículo 33, apartado 2. La Comisión podrá decidir en repetidas ocasiones prorrogar la activación de la fase de crisis en aquellos casos en que proceda.

4. Durante la fase de crisis, la Comisión, a petición de un Estado miembro o por iniciativa propia, convocará reuniones extraordinarias del Consejo Europeo de Semiconductores, cuando se estime necesario. Los Estados miembros colaborarán estrechamente con la Comisión y coordinarán todas las medidas nacionales adoptadas en relación con la cadena de suministro de semiconductores en el seno del Consejo Europeo de Semiconductores.

5. Al expirar el período de duración para el que se ha activado la fase de crisis, dejarán de aplicarse las medidas adoptadas de conformidad con los artículos 20, 21 y 22. La Comisión revisará la evaluación de riesgos de la Unión de conformidad con el artículo 16, apartado 2, a más tardar seis meses después de la expiración del período de duración de la fase de crisis.

Artículo 19
Caja de herramientas de emergencia

1. En aquellos casos en que se active la fase de crisis y se considere que procede para hacer frente a la crisis en el sector de los semiconductores en la Unión, la Comisión adoptará la medida prevista en el artículo 20 en las condiciones establecidas en el mismo. Además, la Comisión podrá adoptar las medidas contempladas tanto en el artículo 21 como en el artículo 22 en las condiciones que en ellos se establecen.

2. Previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, la Comisión podrá limitar las medidas previstas en los artículos 21 y 22 a determinados sectores críticos cuyo funcionamiento se vea alterado o amenazado con sufrir alteraciones debido a la crisis en el sector de los a los semiconductores.

3. En aquellos casos en que se active la fase de crisis y se considere que procede para hacer frente a la crisis en el sector de los semiconductores en la Unión, el Consejo Europeo de Semiconductores podrá:

   a) evaluar el impacto de la posible aplicación de medidas de protección, en particular si la situación del mercado corresponde a una escasez significativa de un producto esencial con arreglo al Reglamento (UE) 2015/479, y presentar un dictamen a la Comisión;

   b) evaluar nuevas medidas de emergencia pertinentes y eficaces y asesorar al respecto.

4. El recurso a las medidas a que se refiere el apartado 1 será proporcionado y se limitará a lo necesario para hacer frente a alteraciones graves de funciones sociales o actividades económicas vitales en la Unión y deberá redundar en el interés superior de la Unión. El recurso a estas medidas evitará imponer una carga administrativa desproporcionada a las pymes.

5. La Comisión informará periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo de cualquier medida adoptada de conformidad con el apartado 1 y explicará los motivos de su decisión.

6. Previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, la Comisión podrá publicar orientaciones sobre la ejecución y la utilización de las medidas de emergencia.

Artículo 20
Recogida de información

1. Previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, la Comisión solicitará a las organizaciones representativas de las empresas o, en caso necesario, a las empresas que operan a lo largo de la cadena de suministro de semiconductores, que informen a la Comisión sobre sus capacidades teóricas de producción, sus capacidades efectivas de producción y las alteraciones primarias actuales, y que faciliten otros datos existentes necesarios para evaluar la naturaleza de la crisis en el sector de los semiconductores o para identificar y evaluar posibles medidas de mitigación o de emergencia a escala nacional o de la Unión.

2. La solicitud de información indicará su base jurídica, será proporcionada en cuanto a la granularidad y el volumen de los datos y la frecuencia de acceso a los datos solicitados, tendrá en cuenta los objetivos legítimos de la empresa y el coste y el esfuerzo necesarios para facilitar los datos, y establecerá el plazo en el que debe facilitarse la información. Asimismo, indicará las sanciones previstas en el artículo 28.

3. Estarán obligados a facilitar la información solicitada en nombre de la empresa o de la asociación de empresas afectadas los propietarios de las empresas o sus representantes y, en el caso de personas jurídicas, sociedades o asociaciones sin personalidad jurídica, las personas encargadas de representarlas de acuerdo con la ley o con los estatutos. Los abogados debidamente habilitados podrán facilitar la información en nombre de sus clientes. Estos últimos seguirán siendo plenamente responsables si la información presentada es incompleta, incorrecta o engañosa.

4. En caso de que una empresa facilite información incorrecta, incompleta o engañosa en respuesta a una solicitud formulada en virtud del presente artículo, o no facilite la información en el plazo establecido, se le impondrán multas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 28.

5. En caso de que una empresa establecida en la Unión sea objeto de una solicitud de información relativa a sus actividades en relación con los semiconductores procedente de un tercer país, informará de ello a la Comisión de manera que esta pueda solicitar información similar. La Comisión informará al Consejo Europeo de Semiconductores de la existencia de dicha solicitud procedente de un tercer país.

Artículo 21
Pedidos calificados de prioritarios

1. En aquellos casos en que sea necesario y proporcionado a fin de garantizar el funcionamiento de todos o algunos sectores críticos, la Comisión podrá obligar a las instalaciones de producción integrada y a las fundiciones abiertas de la UE a aceptar un pedido de productos pertinentes para la crisis y a darle prioridad («pedido calificado de prioritario»). Esta obligación prevalecerá sobre cualquier obligación de ejecución de Derecho público o privado.

2. La obligación prevista en el apartado 1 también puede imponerse a otras empresas de semiconductores que hayan aceptado tal posibilidad en el contexto de la recepción de ayudas públicas.

3. Cuando una empresa de semiconductores establecida en la Unión esté sujeta a una medida de pedido calificado de prioritario de un tercer país, informará de ello a la Comisión. En caso de que dicha obligación afecte significativamente al funcionamiento de determinados sectores críticos, la Comisión podrá obligar a dicha empresa a aceptar pedidos de productos pertinentes para la crisis y a darles prioridad, de conformidad con los apartados 4, 5 y 6.

4. Las obligaciones previstas en los apartados 1, 2 y 3 serán adoptadas por la Comisión mediante una Decisión. Esta se adoptará de conformidad con todas las obligaciones jurídicas de la Unión aplicables, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y, entre otros, los principios de necesidad y proporcionalidad. La Decisión tendrá en cuenta, en particular, los objetivos legítimos de la empresa afectada y el coste y el esfuerzo necesarios para cualquier cambio en la secuencia de producción. En su Decisión, la Comisión indicará la base jurídica del pedido considerado prioritario, fijará el plazo en el que se ejecutará el pedido y, en su caso, especificará el producto y la cantidad, e indicará las sanciones previstas en el artículo 28 en caso de incumplimiento de la obligación. El pedido calificado de prioritario se hará a un precio justo y razonable.

5. La empresa afectada estará obligada a aceptar un pedido calificado de prioritario y a darle prioridad. La empresa podrá solicitar a la Comisión que revise el pedido calificado de prioritario si lo considera debidamente justificado por alguno de los motivos siguientes:

   a) si la empresa no puede ejecutar el pedido calificado de prioritario por falta de capacidad teórica de producción o de capacidad efectiva de producción, incluso otorgando un trato preferente al pedido;

   b) si la aceptación del pedido supone una carga económica excesiva y conlleva especiales dificultades para la empresa.

6. En aquellos casos en que una empresa sea obligada a aceptar un pedido calificado de prioritario y a darle prioridad, no será responsable de los incumplimientos de las obligaciones contractuales necesarios para ejecutar los pedidos calificados de prioritarios. La responsabilidad quedará excluida solamente en la medida en que el incumplimiento de las obligaciones contractuales fue necesario para el cumplimiento de la priorización encomendada.

Artículo 22
Compras comunes

1. A petición de dos o más Estados miembros, la Comisión podrá establecer un mandato para actuar como central de compras en nombre de los Estados miembros participantes (en lo sucesivo, «Estados miembros participantes») para su contratación pública de productos pertinentes para la crisis en determinados sectores críticos (en lo sucesivo, «compras comunes»).

2. La Comisión, en consulta con el Consejo Europeo de Semiconductores, evaluará la utilidad, la necesidad y la proporcionalidad de la solicitud. En aquellos casos en que la Comisión no tenga intención de aprobar la solicitud, informará de ello a los

Estados miembros interesados y al Consejo Europeo de Semiconductores y expondrá los motivos de su negativa.

3. La Comisión elaborará una propuesta de acuerdo marco para su firma por los Estados miembros participantes. En él se organizará detalladamente la compra común a que se refiere el apartado 1.

4. La contratación pública en virtud del presente Reglamento será efectuada por la Comisión de conformidad con las normas establecidas en el Reglamento Financiero para su propia contratación pública. La Comisión podrá tener la capacidad y la responsabilidad, en nombre de todos los Estados miembros participantes, de celebrar contratos con agentes económicos, incluidos los fabricantes de productos pertinentes para hacer frente a la crisis, relativos a la compra de dichos productos o a la financiación anticipada de la producción o el desarrollo de dichos productos, a cambio de un derecho prioritario sobre el resultado.

5. En aquellos casos en que la contratación pública de productos pertinentes para hacer frente a la crisis incluya financiación con cargo al presupuesto de la Unión, podrán establecerse condiciones particulares en acuerdos específicos con los agentes económicos.

6. La Comisión llevará a cabo los procedimientos de contratación pública y celebrará los contratos con los agentes económicos en nombre de los Estados miembros participantes. La Comisión invitará a los Estados miembros participantes a designar representantes para que participen en la preparación de los procedimientos de contratación pública. El despliegue y el uso de los productos adquiridos seguirán siendo responsabilidad de los Estados miembros participantes.

CAPÍTULO V

GOBERNANZA

SECCIÓN 1
CONSEJO EUROPEO DE SEMICONDUCTORES

Artículo 23
Creación y funciones del Consejo Europeo de Semiconductores

1. Se crea el Consejo Europeo de Semiconductores.

2. El Consejo Europeo de Semiconductores proporcionará a la Comisión asesoramiento y asistencia con arreglo al presente Reglamento, en particular:

   a) asesorando sobre la iniciativa al Consejo de Autoridades Públicas de la Empresa Común de Chips;

   b) intercambiando información sobre el funcionamiento de las instalaciones de producción integrada y las fundiciones abiertas de la UE;

   c) debatiendo y preparando la identificación de sectores y tecnologías específicos con un posible gran impacto social y que, por ello, sean importantes en materia de seguridad, lo cual requiere una certificación de productos de confianza;

   d) abordando los problemas de supervisión y de respuesta a las crisis;

e) asesorando sobre la ejecución coherente del presente Reglamento, facilitando la cooperación entre los Estados miembros e intercambiando información sobre cuestiones relacionadas con el presente Reglamento.

3. El Consejo Europeo de Semiconductores apoyará a la Comisión en la cooperación internacional, incluida la recogida de información y la evaluación de crisis, en consonancia con las obligaciones internacionales.

4. El Consejo Europeo de Semiconductores garantizará la coordinación, la cooperación y el intercambio de información, en aquellos casos en que proceda, con las estructuras pertinentes de respuesta y de preparación frente a las crisis establecidas en virtud del Derecho de la Unión.

Artículo 24
Estructura del Consejo Europeo de Semiconductores

1. El Consejo Europeo de Semiconductores estará compuesto por representantes de los Estados miembros y estará presidido por un representante de la Comisión.

2. Cada punto de contacto único nacional a que se refiere el artículo 26, apartado 3, nombrará a un representante de alto nivel en el Consejo Europeo de Semiconductores. En aquellos casos en que sea pertinente por lo que se refiere a la función y los conocimientos especializados, un Estado miembro podrá contar con más de un representante en relación con diferentes tareas del Consejo Europeo de Semiconductores. Cada miembro del Consejo Europeo de Semiconductores tendrá un suplente.

3. A propuesta de la Comisión y de acuerdo con ella, el Consejo Europeo de Semiconductores adoptará su reglamento interno por mayoría simple de sus miembros.

4. La Comisión podrá crear subgrupos permanentes o temporales con el fin de examinar cuestiones específicas. Cuando proceda, la Comisión podrá invitar a dichos subgrupos, en calidad de observadores, a organizaciones que representen los intereses de la industria de semiconductores, incluida la Alianza industrial sobre tecnologías de procesadores y semiconductores y a usuarios de semiconductores a escala de la Unión. Se creará un subgrupo que incluirá a las organizaciones de investigación y tecnología de la Unión, con el fin de examinar aspectos específicos de las orientaciones tecnológicas estratégicas e informar al respecto al Consejo Europeo de Semiconductores.

Artículo 25
Funcionamiento del Consejo Europeo de Semiconductores

1. El Consejo Europeo de Semiconductores celebrará reuniones ordinarias una vez al año, como mínimo. Podrá celebrar reuniones extraordinarias a petición de la Comisión o de un Estado miembro y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 15 y 18.

2. El Consejo Europeo de Semiconductores celebrará reuniones aparte para las funciones a que se refiere el artículo 23, apartado 2, letra a), y para las tareas contempladas en el artículo 23, apartado 2, letras b), c) y d).

3. La presidencia convocará las reuniones y elaborará el orden del día de conformidad con las tareas del Consejo Europeo de Semiconductores en virtud del presente Reglamento y con su reglamento interno. La Comisión prestará apoyo administrativo y analítico a las actividades del Consejo Europeo de Semiconductores de conformidad con el artículo 23.

4. La Comisión podrá nombrar observadores para que participen en las reuniones, según proceda. La Comisión podrá invitar a participar en las reuniones del Consejo Europeo de Semiconductores, con carácter puntual, a expertos con conocimientos específicos, incluidos los de las organizaciones de partes interesadas pertinentes, en relación con un asunto incluido en el orden del día. La Comisión podrá facilitar los intercambios entre el Consejo Europeo de Semiconductores y otros órganos, oficinas, agencias y grupos consultivos de la Unión. La Comisión invitará a un representante del Parlamento Europeo al Consejo Europeo de Semiconductores en calidad de observador. La Comisión garantizará la participación de otras instituciones y órganos pertinentes de la Unión en el Consejo Europeo de Semiconductores en calidad de observadores en lo que respecta a las reuniones relativas al capítulo IV sobre *supervisión y respuesta a las crisis*. Los observadores y expertos no tendrán derecho de voto ni participarán en la formulación de dictámenes, recomendaciones o asesoramiento del Consejo Europeo de Semiconductores y sus subgrupos.

5. El Consejo Europeo de Semiconductores adoptará las medidas necesarias para garantizar el manejo y el tratamiento seguros de la información confidencial.

SECCIÓN 2
AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

Artículo 26

Designación de las autoridades nacionales competentes y de los puntos de contacto únicos

1. Cada Estado miembro designará una o varias autoridades nacionales competentes con el fin de garantizar la aplicación y ejecución del presente Reglamento a nivel nacional.

2. En aquellos casos en que los Estados miembros designen más de una autoridad nacional competente, establecerán claramente las responsabilidades respectivas de las autoridades correspondientes y velarán por que cooperen de manera eficaz y eficiente para desempeñar sus funciones en virtud del presente Reglamento, en particular en lo que respecta a la designación y las actividades del punto de contacto único nacional a que se refiere el apartado 3.

3. Cada Estado miembro designará un punto de contacto único nacional para ejercer una función de enlace, a fin de garantizar la cooperación transfronteriza con las autoridades nacionales competentes de otros Estados miembros, con la Comisión y con el Consejo Europeo de Semiconductores («punto de contacto único»). Si un Estado miembro designa únicamente una autoridad competente, dicha autoridad también será el punto de contacto único.

4. Cada Estado miembro notificará a la Comisión la designación de la autoridad nacional competente y, en su caso, los motivos para designar más de una autoridad nacional competente, y del punto de contacto único nacional, así como sus tareas y

responsabilidades precisas en virtud del presente Reglamento, sus datos de contacto y cualquier modificación posterior de estos elementos.

5. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales competentes, incluido el punto de contacto único designado, ejerzan sus competencias de manera imparcial, transparente y a su debido tiempo y dispongan de las competencias y de los recursos técnicos, financieros y humanos adecuados para desempeñar sus funciones en virtud del presente Reglamento.

6. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales competentes celebren consultas y cooperen con otras autoridades nacionales pertinentes, así como con las partes interesadas correspondientes, en aquellos casos en que proceda y de conformidad con el Derecho de la Unión y el nacional. La Comisión facilitará el intercambio de experiencias entre las autoridades nacionales competentes.

CAPÍTULO VI

CONFIDENCIALIDAD Y SANCIONES

Artículo 27
Tratamiento de la información confidencial

1. La Comisión y las autoridades nacionales competentes, sus funcionarios, agentes y otras personas que trabajen bajo la supervisión de dichas autoridades, así como los funcionarios y agentes de otras autoridades de los Estados miembros, se abstendrán de divulgar la información que hayan obtenido o intercambiado en aplicación del presente Reglamento y que, por su naturaleza, esté amparada por la obligación de secreto profesional. Respetarán la confidencialidad de la información y los datos obtenidos en el desempeño de sus funciones y actividades, de manera que se protejan, en particular, los derechos de propiedad intelectual y la información empresarial sensible o los secretos comerciales. Esta obligación se aplicará a todos los representantes de los Estados miembros, los observadores, los expertos y otros participantes que asistan a las reuniones del Consejo Europeo de Semiconductores de conformidad con el artículo 23, y a los miembros del Comité con arreglo al artículo 33, apartado 1.

2. En aquellos casos en que sea necesario, la Comisión y los Estados miembros podrán intercambiar información confidencial con las autoridades reguladoras de terceros países con las que hayan celebrado acuerdos de confidencialidad bilaterales o multilaterales que garanticen un nivel de confidencialidad adecuado.

3. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución, según sea necesario a raíz de la experiencia adquirida en la recogida de información, a fin de especificar las modalidades prácticas para el tratamiento de la información confidencial en el contexto del intercambio de información en virtud del presente Reglamento. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 33, apartado 2.

Artículo 28
Sanciones y multas

1. Si se considera necesario y proporcionado, la Comisión podrá, mediante una Decisión:

   a) imponer multas en aquellos casos en que una organización representativa de empresas o una empresa, de forma intencionada o por negligencia grave, facilite información incorrecta, incompleta o engañosa en respuesta a una solicitud presentada de conformidad con el artículo 20, o no facilite la información en el plazo prescrito;

   b) imponer multas en aquellos casos en que una empresa, deliberadamente o por negligencia grave, no cumpla la obligación de informar a la Comisión sobre una obligación con un tercer país, de conformidad con el artículo 20, apartado 5, y el artículo 21, apartado 3;

   c) imponer multas coercitivas en aquellos casos en que una empresa, de forma deliberada o por negligencia grave, no cumpla la obligación de dar prioridad a la producción de productos relacionados con la crisis de conformidad con el artículo 21.

2. Las multas impuestas en los casos contemplados en el apartado 1, letras a) y b), no excederán de 300 000 EUR.

3. Las multas coercitivas impuestas en los casos a que se refiere el apartado 1, letra c), no superarán el 1,5 % del volumen de negocios diario medio del ejercicio anterior por cada día laborable de incumplimiento de la obligación con arreglo al artículo 21, calculado a partir de la fecha establecida en la decisión.

4. Al fijar el importe de la multa coercitiva, se tomarán en consideración la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo debidamente en cuenta los principios de proporcionalidad y oportunidad.

5. En aquellos casos en que la empresa haya cumplido la obligación que la multa coercitiva pretendía hacer cumplir, la Comisión podrá fijar el importe definitivo de esta en una cifra inferior a la que resultaría con arreglo a la decisión inicial.

6. El Tribunal de Justicia de las Unión Europea tendrá competencia jurisdiccional plena para revisar las decisiones por las cuales la Comisión haya impuesto una multa coercitiva. Podrá anular, reducir o incrementar la sanción o multa coercitiva impuesta.

Artículo 29
Plazo de prescripción para la imposición de multas y multas coercitivas

1. Los poderes atribuidos a la Comisión en virtud del artículo 28 estarán sujetos a los siguientes plazos de prescripción:

   a) dos años en caso de infracción de las disposiciones sobre las solicitudes de información con arreglo al artículo 20;

   b) dos años en caso de incumplimiento de las disposiciones relativas a la obligación de información con arreglo al artículo 20, apartado 5, y al artículo 21, apartado 3;

c) tres años en caso de incumplimiento de las disposiciones relativas a la obligación de dar prioridad a la producción de productos pertinentes para hacer frente a la crisis de conformidad con el artículo 21.

2. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del día en que se cometa la infracción. No obstante, en el caso de infracciones continuadas o reiteradas, el plazo de prescripción comenzará a contar el día en que cese la infracción.

3. Toda acción adoptada por la Comisión o las autoridades competentes de los Estados miembros encaminada a garantizar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento interrumpirá el plazo de prescripción.

4. La interrupción del plazo de prescripción se aplicará a todas las partes consideradas responsables de participar en la infracción.

5. Tras cada interrupción, el plazo comenzará a contarse desde el inicio. No obstante, se habrá alcanzado la prescripción a más tardar el día en que se cumpla un plazo igual al doble del de la prescripción sin que la Comisión haya impuesto ninguna sanción ni multa coercitiva. Dicho plazo se prorrogará por el tiempo durante el cual el plazo de prescripción se suspenda debido a que la decisión de la Comisión es objeto de un procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Artículo 30
Prescripción en materia de ejecución de sanciones

1. Los poderes de la Comisión para hacer cumplir las decisiones adoptadas en aplicación del artículo 28 estarán sujetos a un plazo de prescripción de tres años.

2. El plazo comenzará a contar a partir del día en que la decisión sea firme.

3. Quedará suspendido el plazo de prescripción para la ejecución de sanciones y de multas coercitivas:

a) por la notificación de una decisión que modifique el importe inicial de la sanción o de la multa coercitiva o que rechace una solicitud tendente a obtener tal modificación;

b) por cualquier acción de la Comisión, o de un Estado miembro que actúe a instancia de la Comisión, que esté destinada a la recaudación por vía ejecutiva de la sanción o la multa coercitiva.

4. Tras cada interrupción, el plazo comenzará a contarse desde el inicio.

5. Quedará suspendido el plazo de prescripción para la ejecución de sanciones y multas coercitivas:

a) durante el plazo otorgado para el pago;

b) mientras dure la suspensión del cobro por vía ejecutiva en virtud de una decisión del Tribunal de Justicia.

Artículo 31
Derecho a ser oído para la imposición de sanciones o multas coercitivas

1. Antes de adoptar una decisión de conformidad con el apartado 28, la Comisión ofrecerá a la empresa o a las organizaciones representativas de las empresas en cuestión la oportunidad de ser oídas sobre:

   a) las conclusiones preliminares de la Comisión, incluido cualquier asunto respecto del cual la Comisión haya formulado objeciones;

   b) las medidas que la Comisión se proponga adoptar en vista de las conclusiones preliminares con arreglo a la letra a) del presente apartado.

2. Las empresas y las asociaciones de empresas en cuestión podrán presentar sus observaciones a las conclusiones preliminares de la Comisión en un plazo que esta fijará en sus conclusiones preliminares y que no podrá ser inferior a catorce días.

3. La Comisión basará sus decisiones únicamente en las objeciones sobre las que las empresas y las asociaciones de empresas en cuestión hayan podido formular observaciones.

4. Los derechos de defensa de la empresa o asociación de empresas en cuestión se respetarán plenamente en cualquier procedimiento. La empresa o la asociación de empresas en cuestión tendrán derecho a acceder al expediente de la Comisión conforme a las condiciones de una divulgación negociada, a reserva del interés legítimo de las empresas de proteger sus secretos empresariales. El derecho de acceso al expediente no se extenderá a la información confidencial ni a los documentos internos de la Comisión o de las autoridades de los Estados miembros. En particular, el derecho de acceso no se extenderá a los intercambios de correspondencia entre la Comisión y las autoridades de los Estados miembros. Lo dispuesto en el presente apartado no será óbice para que la Comisión divulgue y utilice la información necesaria para demostrar una infracción.

CAPÍTULO VII

DELEGACIÓN DE PODERES Y PROCEDIMIENTO DE COMITÉ

Artículo 32
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 9, apartados 2 y 3, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor del presente acto legislativo.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 9, apartados 2 y 3, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea* o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación de 13 de abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 9, apartados 2 y 3, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 33
Comité

1. La Comisión estará asistida por un comité («el Comité de Semiconductores»). Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 182/2011, en relación con su artículo 5.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 34
Modificaciones del Reglamento (UE) 2021/694, por el que se establece el Programa Europa Digital y se deroga la Decisión (UE) 2015/2240

1. El Reglamento (UE) n.º 2021/694 queda modificado como sigue:

1) En el **artículo 3, apartado 2**, se añade la letra f) siguiente:

f) objetivo específico 6: Semiconductores.».

2) Se inserta el artículo 8 *bis* siguiente:

«Artículo 8 *bis*

Objetivo específico 6 – Semiconductores

La contribución financiera de la Unión en virtud del objetivo específico 6 – Semiconductores perseguirá los objetivos establecidos en el artículo 4, letras a) a d), del Reglamento XX/XX del Parlamento Europeo y del Consejo.».

3) En el **artículo 9**, los **apartados 1 y 2**, se modifican como sigue:

«Artículo 9

Presupuesto

1. La dotación financiera para la ejecución del Programa, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre 2027, será de 8 638 000 000 EUR a precios corrientes.

2. La distribución indicativa del importe indicado en el apartado 1 será la siguiente:

2 076 914 000 EUR para el objetivo específico 1 – Informática de alto rendimiento;

1 841 956 000 EUR para el objetivo específico 2 – Inteligencia artificial;

1 529 566 000 EUR para el objetivo específico 3 – Ciberseguridad y confianza;

517 347 000 EUR para el objetivo específico 4 – Capacidades digitales avanzadas;

1 022 217 000 EUR para el objetivo específico 5 – Despliegue y mejor uso de la capacidad digital e interoperabilidad;

1 650 000 000 EUR para el objetivo específico 6 – Semiconductores.».

4) En el **artículo 11**, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. La cooperación con los terceros países y organizaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo en relación con los objetivos específicos 1, 2, 3 y 6 estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 12.».

5) En el **artículo 12**, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6. En caso de que existan motivos de seguridad debidamente justificados, el programa de trabajo también podrá estipular que las entidades jurídicas establecidas en países asociados y las entidades jurídicas establecidas en la Unión pero controladas desde terceros países puedan ser admisibles para participar en la totalidad o en una parte de las acciones en el marco de los objetivos específicos 1, 2 **y 6**, únicamente si cumplen los requisitos que han de cumplir las entidades jurídicas para garantizar la protección de los intereses esenciales de seguridad de la Unión y los Estados miembros y para garantizar la protección de la información de los documentos clasificados. Dichos requisitos se establecerán en el programa de trabajo.».

6) En el **artículo 13**, se añade el apartado 3 siguiente:

«3. Las sinergias del objetivo específico 6 con otros programas de la Unión se describen en el artículo 6 y en el anexo III del Reglamento XX/XX.».

7) El **artículo 14** se modifica como sigue:

El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

8) «1. El Programa se ejecutará en gestión directa, de conformidad con el Reglamento Financiero, o en gestión indirecta confiando determinadas labores de

ejecución a los organismos mencionados en el artículo 62, apartado 1, primer párrafo, letra c), del Reglamento Financiero, de conformidad con los artículos 4 a 8 *bis* del presente Reglamento. Los organismos a los que se haya confiado la ejecución del Programa podrán apartarse de las normas de participación y difusión establecidas en el presente Reglamento únicamente si dicha salida está prevista en el acto jurídico por el que se establecen dichos organismos o por el que se les delega tareas de ejecución presupuestaria o, para los organismos a que se refiere el artículo 62, apartado 1, primer párrafo, letra c), incisos ii), iii) o v), del Reglamento Financiero, en aquellos casos en que dicha salida está prevista en el convenio de contribución y las necesidades de funcionamiento específicas de dichos organismos o la naturaleza de la acción lo requieren.».

9) En el **artículo 14**, se añade el apartado siguiente:

«4. En aquellos casos en que se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 22 del Reglamento XX/XX, se aplicarán las disposiciones de dicho artículo.».

10) En el **artículo 17**, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Solo serán admisibles las acciones que contribuyan a cumplir los objetivos establecidos en los artículos 3 a 8 *bis*.».

11) En el **anexo I**, se añade el párrafo siguiente:

«Objetivo específico 6 – Semiconductores

Las acciones correspondientes al objetivo específico 6 figuran en el anexo I del Reglamento XX/XX.».

12) En el **anexo II** se añade el párrafo siguiente:

«Objetivo específico 6 – Semiconductores

En el anexo II del Reglamento XX/XX figuran indicadores mensurables para supervisar la ejecución e informar sobre los progresos realizados en relación con el objetivo específico 6.».

13) En el **anexo III** se añade el párrafo siguiente:

«Objetivo específico 6 – Semiconductores. En el anexo III del Reglamento XX/XX figuran las sinergias con programas de la Unión en relación con el objetivo específico 6.».

Artículo 35
Evaluación y revisión

1. A más tardar tres años después de que el presente Reglamento sea aplicable, y posteriormente cada cuatro años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al

Consejo un informe sobre la evaluación y revisión del presente Reglamento. Los informes se harán públicos.

2. A efectos de la evaluación y la revisión, el Consejo Europeo de Semiconductores, los Estados miembros y las autoridades nacionales competentes facilitarán información a la Comisión a petición de esta.

3. Al llevar a cabo la evaluación y revisión, la Comisión tendrá en cuenta las posiciones y conclusiones del Consejo Europeo de Semiconductores, del Parlamento Europeo, del Consejo y de los demás órganos o fuentes pertinentes.

Artículo 36
Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo
La Presidenta

Por el Consejo
El Presidente

FICHA DE FINANCIACIÓN LEGISLATIVA

1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

1.1. Denominación de la propuesta/iniciativa

1.2. Política(s) afectada(s)

1.3. La propuesta/iniciativa se refiere a:

1.4. Objetivo(s)

1.4.1. Objetivo(s) general(es)

1.4.2. Objetivo(s) específico(s)

1.4.3. Resultado(s) e incidencia esperados

1.4.4. Indicadores de rendimiento

1.5. Justificación de la propuesta/iniciativa

1.5.1. Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo, incluido un calendario detallado de la aplicación de la iniciativa

1.5.2. Valor añadido de la intervención de la Unión (puede derivarse de distintos factores, como mejor coordinación, seguridad jurídica, mejora de la eficacia o complementariedades). A efectos del presente punto, se entenderá por «valor añadido de la intervención de la Unión» el valor resultante de una intervención de la Unión que viene a sumarse al valor que se habría generado de haber actuado los Estados miembros de forma aislada.

1.5.3. Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores

1.5.4. Compatibilidad con el marco financiero plurianual y posibles sinergias con otros instrumentos adecuados

1.5.5. Evaluación de las diferentes opciones de financiación disponibles, incluidas las posibilidades de reasignación

1.6. Duración e incidencia financiera de la propuesta/iniciativa

1.7. Modo(s) de gestión previsto(s)

2. MEDIDAS DE GESTIÓN

2.1. Normas en materia de seguimiento e informes

2.2. Sistema(s) de gestión y de control

2.2.1. Justificación del modo / de los modo(s) de gestión, el/los mecanismo(s) de aplicación de la financiación, de las modalidades de pago y de la estrategia de control propuestos

2.2.2. Información relativa a los riesgos identificados y al /a los sistema(s) de control interno establecidos para atenuarlos

2.2.3. Estimación y justificación de la relación coste/beneficio de los controles (ratio «gastos de control ÷ valor de los correspondientes fondos gestionados»), y evaluación del nivel esperado de riesgo de error (al pago y al cierre)

2.3. Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades

3. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

3.1. Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)

3.2. Incidencia financiera estimada de la propuesta en los créditos

3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los créditos operativos

3.2.2. Resultados estimados financiados con créditos operativos

3.2.3. Resumen de la incidencia estimada en los créditos administrativos

3.2.4. Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente

3.2.5. Contribución de terceros

3.3. Incidencia estimada en los ingresos

La presente ficha de financiación legislativa introduce las consecuencias presupuestarias de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores (Ley de Chips) y la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (UE) 2021/2085 del Consejo, por el que se establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa. Se añade a la ficha de financiación legislativa introducida para la Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave, que forma parte de la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa [COM(2021) 87, de 23 de febrero de 2021].

Las consecuencias presupuestarias mencionadas en la presente ficha de financiación legislativa son dobles:

Gastos para la Iniciativa Chips para Europa (a excepción del Fondo de Chips) y actividades en curso en el marco de la Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave, que serán gestionadas por la Empresa Común de Chips. El gasto total que gestionará la Empresa Común de Chips, anteriormente denominada «Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave», asciende a 4 175 millones EUR, de los cuales 1 800 millones EUR se habían comprometido anteriormente en el marco de la Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave.

Gastos de personal de la Comisión Europea para hacer frente a las nuevas tareas encomendadas a la Comisión para supervisar la Empresa Común de Chips, revisar y decidir sobre las solicitudes del Consorcio Europeo de Infraestructuras de Chips, revisar y decidir sobre las solicitudes de una instalación de producción integrada o una fundición abierta de la UE, apoyar al Consejo Europeo de Semiconductores y, de consuno con los Estados miembros, supervisar las cadenas de suministro de semiconductores y decidir las acciones, cuando proceda. Se prevé un total de nueve unidades equivalentes a tiempo completo para estas actividades.

1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

1.1 Denominación de la propuesta/iniciativa

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores (Ley de Chips)

1.2 Política(s) afectada(s)

Una Europa Adaptada a la Era Digital Inversiones estratégicas europeas Actividad: configurar el futuro digital de Europa.

1.1. La propuesta/iniciativa se refiere a:

☒ **una acción nueva**

¨ **una acción nueva a raíz de un proyecto piloto / una acción preparatoria**[67]

☒ **la prolongación de una acción existente**

☐ **una fusión o reorientación de una o más acciones hacia otra/una nueva acción**

1.2. Objetivo(s)

1.2.1. Objetivo(s) general(es)

La Ley Europea de Chips tiene por objeto establecer un marco coherente para reforzar el ecosistema de semiconductores de la Unión. Ampliará la resiliencia del ecosistema europeo de semiconductores y aumentará su cuota de mercado mundial. Facilitará la rápida utilización de nuevos chips por parte de la industria europea y aumentará su competitividad.

1.2.2. Objetivo(s) específico(s)

Crear la Iniciativa Chips para Europa a fin de apoyar el desarrollo de capacidades tecnológicas a gran escala mediante la inversión en infraestructuras innovadoras transfronterizas y abiertamente accesibles establecidas en la Unión para permitir el desarrollo de tecnologías de semiconductores punteras y de próxima generación que refuercen el diseño avanzado de la UE, la integración de sistemas y las capacidades teóricas de producción de chips (pilar 1, «Iniciativa Chips para Europa»).

Crear un marco para garantizar la seguridad del suministro atrayendo inversiones y mejorando las capacidades efectivas de producción en la fabricación de semiconductores, así como en cuanto al empaquetado, las pruebas y el montaje avanzados a través de instalaciones de producción integradas pioneras y fundiciones abiertas de la UE (pilar 2, «Seguridad del suministro»).

Establecer un mecanismo de coordinación entre los Estados miembros y la Comisión para reforzar la colaboración con los Estados miembros y, entre ellos, supervisar la oferta de semiconductores, estimar la demanda, anticipar la escasez, activar las situaciones de crisis y actuar a través de un conjunto de medidas específicas (pilar 3, «Preparación y seguimiento»).

[67] Tal como se contempla en el artículo 58, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento Financiero.

1.2.3. *Resultado(s) e incidencia esperados*

Especificar los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios / los grupos destinatarios.

La industria de semiconductores de la Unión debe beneficiarse del apoyo al desarrollo de capacidades tecnológicas a gran escala en tecnologías de semiconductores de vanguardia y de próxima generación que refuercen las capacidades avanzadas de diseño, integración de sistemas y capacidades teóricas de producción de chips de la UE. Las instalaciones de semiconductores se beneficiarán de procedimientos más eficaces de concesión de autorizaciones.

Los usuarios de semiconductores de la Unión en todos los sectores deben beneficiarse de una mayor seguridad en el suministro de semiconductores sin interrupciones. Además, los sectores cruciales deben beneficiarse de una mayor seguridad en el suministro de semiconductores.

Los usuarios finales de productos con semiconductores deben beneficiarse de una mayor seguridad en el suministro y precios de mercado más atractivos.

De este modo, mejorará la competitividad del ecosistema europeo de semiconductores.

1.2.4. *Indicadores de rendimiento*

Precisar los indicadores para hacer un seguimiento de los avances y logros.

Los indicadores de rendimiento son, sobre todo, pertinentes para la Iniciativa Chips para Europa. El anexo II recoge las primeras versiones de los indicadores mensurables para el seguimiento de la ejecución y para informar de los progresos de la Iniciativa respecto de la consecución de sus objetivos específicos:

1. El número de entidades jurídicas participantes (subdivididas por tamaño, tipo y país de establecimiento) en las acciones apoyadas por la Iniciativa.
2. El número de herramientas de diseño desarrolladas o integradas en el marco de la Iniciativa.
3. El importe total coinvertido en capacidades de diseño y líneas piloto en el marco de la Iniciativa.
4. El número de usuarios o comunidades de usuarios que acceden a capacidades de diseño y líneas piloto en el marco de la Iniciativa.
5. El número de empresas que han recurrido a los servicios de los centros nacionales de competencia apoyados por la Iniciativa.
6. El número de personas que han recibido formación para adquirir capacidades digitales avanzadas y en tecnologías con apoyo de la Iniciativa
7. El número de empresas emergentes, empresas en expansión y pymes que han recibido capital de riesgo del Fondo de Chips y el importe total de las inversiones de capital realizadas.
8. El importe de las inversiones de las empresas que operan en la UE teniendo en cuenta el segmento de la cadena de valor en el que operan.

1.3. Justificación de la propuesta/iniciativa

1.3.1. Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo, incluido un calendario detallado de la aplicación de la iniciativa

El Reglamento debe ser plenamente aplicable poco tiempo después de su fecha de adopción, es decir, el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*. Sin embargo, los elementos iniciales deben estar en vigor antes, respaldados por la Recomendación de la Comisión, adoptada al mismo tiempo que la propuesta de Reglamento.

Debe crearse el Consejo Europeo de Semiconductores y los Estados miembros deben haber designado un punto de contacto para su reunión. En el momento en que empiece a aplicarse, el Consejo Europeo de Semiconductores debe estar plenamente operativo.

La recogida de información de las organizaciones representativas de las empresas de semiconductores debe estar ya en marcha y los Estados miembros deben haber debatido ya una serie de posibles medidas en el conjunto de instrumentos de crisis y haber llevado a cabo un seguimiento de la cadena de valor de los semiconductores.

1.3.2. Valor añadido de la intervención de la Unión (puede derivarse de distintos factores, como mejor coordinación, seguridad jurídica, mejora de la eficacia o complementariedades). A efectos del presente punto, se entenderá por «valor añadido de la intervención de la Unión» el valor resultante de una intervención de la Unión que viene a sumarse al valor que se habría generado de haber actuado los Estados miembros de forma aislada.

Los chips de semiconductores son fundamentales para la economía digital. La escasez mundial de semiconductores ha puesto de manifiesto la dependencia de Europa respecto del suministro de un número limitado de empresas y zonas geográficas, así como su vulnerabilidad ante las restricciones a la exportación de terceros países y otras perturbaciones en el contexto geopolítico actual. Además, esta dependencia se ve agravada por los obstáculos extremadamente elevados a la entrada y a la intensidad de capital del sector. Por ejemplo, los chips más potentes desde el punto de vista informático requieren la fabricación con una precisión de unos pocos nanómetros (nm). La construcción de estas instalaciones requiere una inversión inicial de al menos 15 000 millones EUR y tres años para lograr una preparación para la producción con unos rendimientos adecuados. Los gastos para diseñar estos chips pueden oscilar entre 500 millones EUR y más de 1 000 millones EUR. La intensidad de I+D en el sector es elevada y supera el 15 %. Ningún Estado miembro puede lograrlo por sí solo.

La intervención, a nivel de la Unión, es la mejor opción para hacer frente a los retos derivados de la complejidad del ecosistema de semiconductores, de las dependencias estructurales de la Unión y de las interrupciones de la cadena de suministro de gran alcance.

La Iniciativa Chips para Europa debe establecerse como una iniciativa a escala de la Unión que apoye un determinado sector industrial en toda Europa. Una iniciativa a escala de la Unión puede proporcionar el grado de uniformidad necesario para el

funcionamiento eficaz de los programas de financiación destinados a reforzar el ecosistema de semiconductores de Europa.

En cuanto a la seguridad del suministro, la acción a escala de la Unión se justifica por la necesidad de una aplicación uniforme de las nuevas normas, en particular la definición de las instalaciones de producción integradas y de las fundiciones abiertas de la UE, así como de un procedimiento uniforme para su reconocimiento y apoyo.

Además, un elemento clave de la presente propuesta es establecer medidas para hacer frente a perturbaciones graves de funciones sociales o actividades económicas vitales a escala de la Unión. La creación de un mecanismo de coordinación entre los Estados miembros y la Comisión para el seguimiento y la respuesta a las crisis en caso de escasez de semiconductores debe aportar importantes beneficios en materia de coordinación.

1.3.3. Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores

La Comisión publicó en 2013 una Comunicación titulada «Una estrategia europea para los componentes y sistemas microelectrónicos y nanoelectrónicos»[68] en la que propuso una estrategia industrial para garantizar la vuelta al crecimiento y alcanzar, en una década, un nivel de producción en la UE más cercano a su cuota en el PIB mundial. Más concretamente, su objetivo era:

- Garantizar la disponibilidad de la microelectrónica y la nanoelectrónica necesarias para la competitividad de las industrias clave en Europa.

- Atraer una mayor inversión en la fabricación avanzada en Europa y reforzar la competitividad industrial en toda la cadena de valor, desde el diseño hasta la fabricación.

- Mantener el liderazgo en el suministro de equipos y materiales y en ámbitos como «más que Moore» y componentes eficientes desde el punto de vista energético.

- Impulsar el liderazgo en el diseño de chips en mercados de alto crecimiento, especialmente en el diseño de componentes complejos.

Es evidente que la Unión no logró alcanzar plenamente los objetivos de esta estrategia industrial.

Una de las razones es que las acciones de la UE a raíz de la Comunicación se centraron en gran medida en apoyar la I+D, por ejemplo, a través de la Empresa Común ECSEL. Sin embargo, no se abordó adecuadamente el desarrollo de capacidades en el sector de la microelectrónica.

Por otra parte, la Comunicación mencionaba las acciones relacionadas con la demanda que debían abordarse. Sin embargo, las acciones emprendidas no abordaron adecuadamente estas acciones relacionadas con la demanda. Es necesario hacer más hincapié en dichas acciones, por ejemplo, las que abordan actividades de diseño.

Por último, en relación con el primer punto, la Comunicación de 2013 contaba con pocos instrumentos a su disposición. En la actualidad, se dispone de más instrumentos, se ha dado una apertura a la política de competencia y el impulso político es ahora más claro.

[68] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AE4345&from=EN

1.3.4. Compatibilidad con el marco financiero plurianual y posibles sinergias con otros instrumentos adecuados

Con el fin de maximizar sus efectos positivos, la Iniciativa Chips para Europa (pilar 1) se basará en una sólida base de conocimientos y mejorará las sinergias con las acciones actualmente apoyadas por la Unión y los Estados miembros a través de programas y acciones de investigación e innovación en semiconductores y en la evolución de parte de la cadena de suministro. Entre ellos figuran, en particular, el Programa Marco Horizonte Europa y el Programa Europa Digital, con el objetivo de reforzar a Europa como actor mundial en la tecnología de semiconductores y sus aplicaciones, con una cuota mundial cada vez mayor en la fabricación de aquí a 2030. Como complemento de estas actividades, la Iniciativa Chips para Europa colaboraría estrechamente con la Alianza industrial sobre tecnologías de procesadores y semiconductores.

Además, el Reglamento establece un marco de procedimiento para facilitar la financiación combinada de los Estados miembros, el presupuesto de la UE y la inversión privada.

La iniciativa propuesta puede incluirse en el contexto de una serie de políticas y prioridades europeas recientemente anunciadas:

- Estrategia industrial;
- Plan de Recuperación para Europa;
- Pacto Verde;
- Inteligencia artificial;
- Investigación e innovación en el marco del programa Horizonte Europa propuesto, pilar II, clúster ««Mundo digital, industria y espacio», con el objetivo de aportar contribuciones concretas a tres políticas generales de la UE: «Una Europa Adaptada a la Era Digital», «Una Economía al Servicio de las Personas» y «Pacto Verde Europeo»;
- Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En lo que respecta a sus posibles sinergias con otros instrumentos adecuados, la función de las autoridades competentes a nivel nacional pueden desempeñarla autoridades nacionales que ejerzan funciones similares con arreglo a la legislación de la Unión. Véase también el capítulo 1 de la exposición de motivos.

1.3.5. Evaluación de las diferentes opciones de financiación disponibles, incluidas las posibilidades de reasignación

1.4. Duración e incidencia financiera de la propuesta/iniciativa

☒ **Duración limitada**

☒ en vigor a partir de la fecha de adopción de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores (Ley de Chips)

☒ incidencia financiera desde 2023 hasta 2027 para créditos de compromiso y desde 2023 hasta 2031 para créditos de pago.

☐ **Duración ilimitada**

1 Ejecución: fase de puesta en marcha desde AAAA hasta AAAA

2 y pleno funcionamiento a partir de entonces.

1.5. Modo(s) de gestión previsto(s)

☒ **Gestión directa** por la Comisión

☒ por sus servicios, incluido su personal en las Delegaciones de la Unión;

☐ por las agencias ejecutivas.

☐ **Gestión compartida** con los Estados miembros

☒ **Gestión indirecta** mediante delegación de tareas de ejecución presupuestaria en:

☐ terceros países o los organismos que estos hayan designado;

☐ organizaciones internacionales y sus agencias (especificar);

☐ el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones;

☒ los organismos a que se hace referencia en los artículos 70 y 71 del Reglamento Financiero;

☐ organismos de Derecho público;

☐ organismos de Derecho privado investidos de una misión de servicio público, en la medida en que presenten garantías financieras suficientes;

☐ organismos de Derecho privado de un Estado miembro a los que se haya encomendado la ejecución de una colaboración público-privada y que presenten garantías financieras suficientes;

☐ personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones específicas en el marco de la PESC, de conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea, y que estén identificadas en el acto de base correspondiente.

Si se indica más de un modo de gestión, facilítense los detalles en el recuadro de observaciones.

Observaciones

Con la excepción de: a) actividades y presupuestos relacionados con el Fondo de Chips y b) actividades y presupuestos asignados en el marco del Consejo Europeo de Innovación, la Iniciativa Chips para Europa se ejecutará en régimen de gestión indirecta confiando la ejecución de los trabajos a la Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave, que pasará a denominarse «Empresa Común de Chips». Los Estados miembros y otros Estados participantes cofinancian acciones indirectas. Otras partes, como las actividades de los pilares 2 y 3, se realizan en régimen de gestión directa. Se trata de tareas encomendadas a la Comisión para supervisar la Empresa Común de Chips, revisar y decidir sobre las solicitudes del Consorcio Europeo de Infraestructuras de Chips, revisar y decidir sobre las solicitudes de una instalación de producción integrada o una fundición abierta de la UE, apoyar al Consejo Europeo de Semiconductores y, junto con los Estados miembros, supervisar las cadenas de suministro de semiconductores y decidir las acciones, cuando proceda.

2. MEDIDAS DE GESTIÓN

2.1. Normas en materia de seguimiento e informes

Especificar la frecuencia y las condiciones de dichas medidas.

Como organismo de la Unión, la Empresa Común de Chips funciona con arreglo a estrictas normas de supervisión. El seguimiento se realizará como sigue:

- sus propios recursos de auditoría interna y el servicio de auditoría de la Comisión;
- la supervisión del Consejo de Administración; el Director Ejecutivo se encargará de la supervisión interna de las operaciones de la Empresa Común;
- un conjunto de indicadores de rendimiento cuantitativos y cualitativos que se establecerán para hacer un seguimiento de la ejecución del programa y medir su repercusión;
- evaluaciones intermedia y final del programa a cargo de expertos externos, bajo la supervisión de la Comisión;
- el programa de trabajo de la Empresa Común y su informe anual de actividad.

2.2. Sistema(s) de gestión y de control

2.2.1. Justificación del modo / de los modo(s) de gestión, el/los mecanismo(s) de aplicación de la financiación, de las modalidades de pago y de la estrategia de control propuestos

El Reglamento introduce un nuevo marco político para atraer inversiones y mejorar la fabricación avanzada de semiconductores en la Unión e introduce normas armonizadas para un enfoque coordinado del seguimiento y la preparación frente a la escasez de semiconductores.

Estas nuevas normas requieren un mecanismo de coherencia para la aplicación transfronteriza de las obligaciones derivadas del presente Reglamento y la coordinación de las actividades de las autoridades nacionales y de la Comisión a través de un nuevo grupo consultivo, el Consejo Europeo de Semiconductores.

Estas tareas se llevarán a cabo en régimen de gestión directa. Para hacer frente a estas nuevas tareas en el marco de los pilares 2 y 3 y relacionadas con el Fondo de Chips, es necesario dotar de recursos adecuados a los servicios de la Comisión.

En el caso de otros aspectos, la gestión indirecta está justificada porque la Empresa Común de Chips es una asociación público-privada con parte de la cofinanciación aportada a través de contribuciones de los Estados participantes y de contribuciones en especie de miembros privados.

Cada año, la decisión sobre la contribución a la Empresa Común de Chips se adoptará en virtud del presupuesto de la UE aprobado para ese año.

En el acuerdo marco de colaboración financiera firmado entre la Comisión Europea y la Empresa Común de Chips se indicará que, para las tareas que deban realizarse cada año, la Comisión abonará una contribución tras la celebración de un convenio de contribución con la Empresa Común de Chips y la emisión, por parte de esta, de las correspondientes solicitudes de pago a miembros que no sean la Unión.

La Comisión velará por que las normas aplicables a la Empresa Común de Chips cumplan plenamente los requisitos del Reglamento Financiero. De conformidad con el artículo 71 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Empresa Común respetará el principio de buena gestión financiera. La Empresa Común de Chips deberá también cumplir las disposiciones del reglamento financiero tipo que le sea aplicable. Toda desviación respecto de dicho reglamento financiero tipo que sea precisa para satisfacer las necesidades específicas de la Empresa Común estará sujeta al consentimiento previo de la Comisión.

Los mecanismos de seguimiento, en particular a través de la representación de la Unión en el Consejo de Administración y el Consejo de Autoridades Públicas de la Empresa Común de Chips, así como los mecanismos de información, garantizarán que los servicios de la Comisión puedan cumplir los requisitos de rendición de cuentas tanto ante el Colegio como ante la Autoridad Presupuestaria.

El marco de control interno de la Empresa Común de Chips se basa en lo siguiente:

-la aplicación de normas de control interno que ofrezcan garantías al menos equivalentes a las de la Comisión;

-procedimientos para seleccionar los mejores proyectos a través de una evaluación independiente y para plasmarlos en instrumentos jurídicos;

-la gestión de proyectos y de contratos durante todo el ciclo de vida de cada proyecto;

-los controles ex ante del 100 % de las solicitudes, incluida la recepción de los certificados de auditoría y la certificación ex ante de las metodologías de costes;

-las auditorías ex post de una muestra de solicitudes como parte de las auditorías ex post de Horizonte Europa;

-la evaluación científica de los resultados de los proyectos.

2.2.1. Información relativa a los riesgos identificados y al /a los sistema(s) de control interno establecidos para atenuarlos

Se han establecido varias medidas para mitigar el riesgo inherente de conflicto de intereses dentro de la Empresa Común de Chips, en particular:

-los mismos votos (un tercio) para la Comisión, los Estados participantes (colectivamente) y los miembros privados (colectivamente) en el Consejo de Administración; igualdad de votos (la mitad) para la Comisión y los Estados participantes (colectivamente) en el Consejo de Autoridades Públicas;

-las decisiones de alto nivel sobre las actividades/presupuestos dedicados a las actividades de la Iniciativa Chips para Europa (desarrollo de capacidades en los próximos programas de trabajo) son adoptadas únicamente por el Consejo de Autoridades Públicas con los Estados miembros,

-la parte del programa de trabajo que se ocupa de las actividades de desarrollo de capacidades es adoptada únicamente por el Consejo de Autoridades Públicas con los Estados miembros,

-la selección del Director Ejecutivo por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión,

-la independencia del personal,

-las evaluaciones de expertos independientes basadas en criterios de evaluación publicados, junto con mecanismos de recurso y declaraciones completas de intereses,

-el requisito de que el Consejo de Administración adopte normas para prevenir, evitar y gestionar los conflictos de intereses dentro de la Empresa Común de conformidad con las normas financieras de esta y con el Estatuto, por lo que respecta al personal.

El establecimiento de unos valores éticos y organizativos será una de las funciones principales de la Empresa Común, y la Comisión se encargará de su seguimiento.

El director ejecutivo de la Empresa Común de Chips, en su calidad de ordenador, tendrá que introducir un sistema eficiente de control y gestión internos. Deberá informar a la Comisión sobre el marco de control interno adoptado.

La Comisión vigilará el riesgo de incumplimiento por medio del sistema de información que diseñará, así como mediante el seguimiento de los resultados de las auditorías ex post realizadas a los beneficiarios de los fondos de la UE procedentes de la Empresa Común de Chips, como parte de las auditorías ex post que abarcan el conjunto de Horizonte Europa.

Existe una clara necesidad de gestionar el presupuesto de forma eficiente y eficaz, y de prevenir el fraude y el derroche. Sin embargo, el sistema de control debe alcanzar un equilibrio justo entre el porcentaje de error aceptable y la carga de control requerida, evitando mermar el atractivo del programa de investigación de la Unión.

2.2.3. Estimación y justificación de la relación coste/beneficio de los controles (ratio «gastos de control ÷ valor de los correspondientes fondos gestionados»), y evaluación del nivel esperado de riesgo de error (al pago y al cierre)

Dado que las normas de participación de Horizonte Europa y el Programa Europa Digital aplicables a la Empresa Común de Chips son similares a las que utilizará la Comisión en sus programas de trabajo, y que el perfil de riesgo de los beneficiarios es similar al de los programas en gestión directa, cabe esperar que el margen de error sea similar al previsto por la Comisión para Horizonte Europa y el Programa Europa Digital, es decir, que es razonable asegurar que el riesgo de error a lo largo del período de gasto plurianual irá del 2 al 5 % anual, con el objetivo último de alcanzar un porcentaje de error residual lo más cercano posible al 2 % al cierre de los programas plurianuales, una vez que se hayan tenido en cuenta el impacto económico de todas las auditorías y las medidas de corrección y recuperación.

2.3. Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades

Especificar las medidas de prevención y protección existentes o previstas, por ejemplo, en la estrategia de lucha contra el fraude.

La Comisión velará por que la Empresa Común de Chips aplique los procedimientos de lucha contra el fraude en todas las etapas del proceso de gestión.

La Comisión velará por que se apliquen las medidas adecuadas para garantizar que, cuando se realicen las acciones financiadas en el marco del presente Reglamento, los intereses financieros de la Unión queden protegidos mediante la aplicación de

medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualesquiera otras actividades ilegales, mediante controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante la recuperación de las cantidades abonadas indebidamente y, cuando proceda, la imposición de sanciones administrativas y financieras efectivas, proporcionadas y disuasorias.

El Tribunal de Cuentas estará facultado para auditar, sobre la base de documentos e in situ, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y subcontratistas que hayan recibido fondos de la Unión en el marco del Programa.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá realizar controles y verificaciones in situ de los operadores económicos afectados directa o indirectamente por dicha financiación de conformidad con los procedimientos previstos en el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, con vistas a establecer cualquier posible fraude, corrupción u otra actividad ilegal que ataña a los intereses financieros de la Unión en relación con un convenio o decisión de subvención o con un contrato relativo a la financiación de la Unión. Las empresas comunes tendrán que adherirse también al Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

La Fiscalía Europea podrá llevar a cabo investigaciones de conformidad con las disposiciones y los procedimientos establecidos en el Reglamento (UE) 2017/193923 del Consejo, con el fin de investigar los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión.

3. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

3.1. Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)

Líneas presupuestarias existentes

En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias.

Rúbrica del marco financiero plurianual	Línea presupuestaria	Tipo de gasto	Contribución			
	Número	CD/CND[69]	de países de la AELC[70]	de países candidatos [71]	de terceros países	en el sentido del artículo 21, apartado 2, letra b), del Reglamento Financiero
1	01 02 02 30 — Bloque «Seguridad civil para la sociedad»	CD	SÍ	SÍ	SÍ	NO
1	01 02 02 40 - Bloque «Mundo digital, industria y espacio»	CD	SÍ	SÍ	SÍ	NO
1	Programa Horizonte Europa - 01 02 02 42 - Bloque «Mundo digital, industria y espacio» - Empresa Común sobre tecnologías digitales clave	CD	SÍ	SÍ	SÍ	NO
1	01 02 02 50 - Bloque «Mundo digital, industria y espacio»	CD	SÍ	SÍ	SÍ	NO
1	01 02 03 01 - Consejo Europeo de Innovación	CD	SÍ	SÍ	SÍ	NO
1	02 03 01 Mecanismo Conectar Europa – Transporte	CD	NO	SÍ	SÍ	NO
1	02 03 03 01 - Mecanismo Conectar Europa – Digital	CD	NO	SÍ	SÍ	NO
1	Programa Europa Digital - 02 04 01 10 - Ciberseguridad	CD	SÍ	SÍ	SÍ	NO
1	Programa Europa Digital - 02 04 01 11 - Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad	CD	SÍ	SÍ	SÍ	NO
1	Programa Europa Digital - 02 04 02 11 - Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (EuroHPC)	CD	SÍ	SÍ	SÍ	NO
1	Programa Europa Digital - 02 04 03 -	CD	SÍ	SÍ	SÍ	NO

[69] CD = créditos disociados / CND = créditos no disociados.
[70] AELC: Asociación Europea de Libre Comercio.
[71] Países candidatos y, en su caso, candidatos potenciales de los Balcanes Occidentales.

	Inteligencia artificial					
1	Programa Europa Digital - 02 04 04 - Capacidades	CD	SÍ	SÍ	SÍ	NO
1	Programa Europa Digital - 02 04 05 01 - Despliegue	CD	SÍ	SÍ	SÍ	NO
1	Programa Europa Digital - 02 04 05 02 - Despliegue/Interoperabilidad	CD	SÍ	SÍ	SÍ	NO
1	Margen no asignado — Rúbrica 1	CD	NO	NO	NO	NO

Nuevas líneas presupuestarias solicitadas

En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias.

Rúbrica del marco financiero plurianual	Línea presupuestaria	Tipo de gasto	Contribución			
	Número	CD/CND	de países de la AELC	de países candidatos	de terceros países	en el sentido del artículo 21, apartado 2, letra b), del Reglamento Financiero
1	Programa Europa Digital - 02 04 06 10 - Chips	CD	SÍ	SÍ	SÍ	NO
1	Programa Europa Digital - 02 04 06 11 - Empresa Común de Chips	CD	SÍ	SÍ	SÍ	NO

3.2. Incidencia financiera estimada de la propuesta en los créditos

3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los créditos operativos

☐ La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos operativos

☒ La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos operativos, tal como se explica a continuación:

En millones EUR (al tercer decimal)

Rúbrica del marco financiero plurianual	**1**	**Mercado único, innovación y economía digital**

La propuesta no aumentará el nivel total de gastos programados en el marco de la Rúbrica 1 del marco financiero plurianual 2021-2027. De hecho, la contribución del presupuesto de la UE a la Iniciativa Chips para Europa se pondrá en común a partir del Programa Horizonte Europa y del Programa Europa Digital y, a excepción de la acción en el marco del Consejo Europeo de Innovación, se canalizará hacia la Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave (futura Empresa Común de Chips). A tal fin, se creará un sexto objetivo específico en el marco del Programa Europa Digital.

Este sexto objetivo específico será financiado por:

i una redistribución interna de la dotación actual del Programa Europa Digital,

ii la utilización del margen no asignado dentro de la Rúbrica 1, y

iii una reducción de las dotaciones del Mecanismo Conectar Europa — Transporte y del Mecanismo Conectar Europa — Digital.

El cuadro recapitulativo de la sección 3.2.4 ofrece una visión completa de todas las fuentes de financiación.

- Créditos operativos asignados o reasignados en el marco de **Horizonte Europa** para ser utilizados a efectos de la Iniciativa Chips para Europa

Créditos operativos en el marco de **Horizonte Europa**			**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	***Después de 2027***	**TOTAL**
Créditos operativos **asignados** en el marco de **Horizonte Europa**											
Programa Europa Digital - 01 02 02 42 - Bloque «Mundo digital, industria y espacio» - Empresa Común sobre tecnologías digitales clave	Créditos de compromiso	(1a)			108,850	112,609	97,470	91,781	89,290		500,000

01 02 03 01 - Consejo Europeo de Innovación[72]	Créditos de compromiso	(1a)			75,251	55,054	55,501	56,499	57,696		300,000
Créditos de operaciones **reasignados** en el marco de **Horizonte Europa**											
01 02 02 30 — Bloque «Seguridad civil para la sociedad»	Créditos de compromiso	(1a)			40,800	47,400	41,400	10,200	10,200		150,000
01 02 02 40 - Bloque «Mundo digital, industria y espacio»	Créditos de compromiso	(1a)			108,800	126,400	110,400	27,200	27,200		400,000
01 02 02 50 - Bloque «Clima, energía y movilidad»	Créditos de compromiso	(1a)			81,600	94,800	82,800	20,400	20,400		300,000
TOTAL de los créditos en el marco de Horizonte Europa	Créditos de compromiso				**415,302**	**436,263**	**387,570**	**206,080**	**204,785**	**-**	**1 650,000**

- Créditos operativos que se pondrán en común en el marco de un sexto objetivo específico del **Programa Europa Digital** a efectos de la Iniciativa Chips para Europa, que será ejecutada por la futura Empresa Común de Chips:

Créditos operativos en el marco de **Europa Digital** — sexto objetivo			**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	***Después de 2027***	**TOTAL**
Créditos operativos **reasignados** de otros programas **(Horizonte Europa, Mecanismo Conectar Europa)**											
Horizonte Europa - 01 02 02 40 - Bloque «Mundo digital, industria y espacio»	Créditos de compromiso	(1a)			80,000	80,000	80,000	80,000	80,000		400,000
02 03 01 Mecanismo Conectar Europa – Transporte	Créditos de compromiso	(1a)				96,000	86,000	34,000	34,000		250,000

[72] En el marco del Consejo Europeo de Innovación se destinarán hasta 300 000 millones EUR a los fines de la Iniciativa Chips para Europa. La programación anual de la dotación es indicativa.

02 03 03 01 - Mecanismo Conectar Europa – Digital	Créditos de compromiso	(1a)				57,600	51,600	20,400	20,400		150,000
Créditos operativos **reasignados** en el marco del Programa **Europa Digital**											
Programa Europa Digital - 02 04 01 10 - Ciberseguridad	Créditos de compromiso	(1a)			16,320	18,960	16,560	4,080	4,080		60,000
Programa Europa Digital - 02 04 01 11 - Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad	Créditos de compromiso	(1a)			16,320	18,960	16,560	4,080	4,080		60,000
Programa Europa Digital - 02 04 02 11 - Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (EuroHPC)	Créditos de compromiso	(1a)			40,800	47,400	41,400	10,200	10,200		150,000
Programa Europa Digital - 02 04 03 - Inteligencia artificial	Créditos de compromiso	(1a)			59,840	69,520	60,720	14,960	14,960		220,000
Programa Europa Digital - 02 04 04 - Capacidades	Créditos de compromiso	(1a)			16,320	18,960	16,560	4,080	4,080		60,000
Programa Europa Digital - 02 04 05 01 - Despliegue	Créditos de compromiso	(1a)			10,880	12,640	11,040	2,720	2,720		40,000
Programa Europa Digital - 02 04 05 02 - Despliegue/Interoperabilidad	Créditos de compromiso	(1a)			2,720	3,160	2,760	0,680	0,680		10,000
Contribución del **margen** disponible en la **Rúbrica 1** del marco financiero plurianual											
Margen no asignado dentro de la Rúbrica 1	Créditos de compromiso	(1a)			50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		250,000
TOTAL de los créditos agrupados en el marco del Programa Europa Digital	Créditos de compromiso	=1a			**293,200**	**473,200**	**433,200**	**225,200**	**225,200**	**-**	**1 650,000**

Únicamente a efectos informativos: visión general de la ejecución por el Consejo Europeo de Innovación y la Empresa Común de Chips

A Horizonte Europa

Ejecución por el Consejo Europeo de Innovación

Créditos operativos «asignados» en el marco de Horizonte Europa — Consejo Europeo de Innovación			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	*Después de 2027*	TOTAL
01 02 03 01 - Consejo Europeo de Innovación[73]	Créditos de compromiso	(1a)			75,251	55,054	55,501	56,499	57,696		300,000
	Créditos de pago	(2a)			45,151	48,082	51,836	58,030	56,973	39,928	300,000

Ejecución por la Empresa Común de Chips

500 millones EUR destinados a los fines de la Iniciativa Chips para Europa dentro de la dotación financiera preexistente de la Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave serán ejecutados por la Empresa Común de Chips:

Créditos operativos «asignados» en el marco de Horizonte Europa — Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	*Después de 2027*	TOTAL
Programa Europa Digital - 01 02 02 42 - Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave	Créditos de compromiso	(1a)			108,850	112,609	97,470	91,781	89,290		500,000
	Créditos de pago	(2a)			60,897	74,926	83,997	83,126	79,271	117,783	500,000

[73] En el marco del Consejo Europeo de Innovación se destinarán hasta 300 000 millones EUR a los fines de la Iniciativa Chips para Europa. La programación anual de la dotación es puramente indicativa.

Los 850 millones EUR reasignados en el marco de Horizonte Europa serán ejecutados por la Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave (futura Empresa Común de Chips) y se dividirán entre gastos operativos y de apoyo como sigue:

Créditos reasignados dentro de Horizonte Europa a la Empresa Común de Chips			**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	***Después de 2027***	**TOTAL**
Créditos operativos											
01 02 02 42 Programa Horizonte Europa — Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave — Gastos operativos	Créditos de compromiso	(1a)			230,809	267,842	233,371	56,546	52,897		841,465
	Créditos de pago	(2a)			138,329	206,642	216,371	130,326	95,281	54,516	841,465
Créditos de carácter administrativo financiados mediante la dotación de programas específicos[74]											
01 02 02 42 Programa Horizonte Europa — Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave — Gastos de apoyo	Créditos de compromiso	(1b)			0,391	0,758	1,229	1,254	4,903		8,535
	Créditos de pago	(2b)			0,391	0,758	1,229	1,254	1,279	3,624	8,535
TOTAL de los créditos suplementarios para la Empresa Común de Chips en el marco de Horizonte Europa	Créditos de compromiso	=1a+1b +3			**231,200**	**268,600**	**234,600**	**57,800**	**57,800**	**-**	**850,000**
	Créditos de pago	=2 a+2b +3			**138,720**	**207,400**	**217,600**	**131,580**	**96,560**	**58,140**	**850,000**

Los créditos consolidados de la Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave (futura Empresa Común de Chips) en el marco de Horizonte Europa, incluidos los créditos para actividades anteriores de la Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave que no forman parte de la Iniciativa Chips para Europa, serán los siguientes:

Empresa Común de Chips			**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	***Después de 2027***	**TOTAL**
Créditos operativos											
01 02 02 42 Programa Horizonte Europa	Créditos de compromiso	(1a)	207,637	247,490	518,207	565,170	490,661	298,788	287,185		2 615,139

[74] Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa.

— Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave — Gastos operativos	Créditos de pago	(2a)	51,909	113,782	334,342	447,834	486,757	397,896	350,073	432,545	2 615,139
Créditos de carácter administrativo financiados mediante la dotación de programas específicos											
01 02 02 42 Programa Horizonte Europa — Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave — Gastos de apoyo	Créditos de compromiso	(1b)	2,363	2,510	2,993	3,430	3,939	4,012	15,615		34,861
	Créditos de pago	(2b)	2,363	2,510	2,993	3,430	3,939	4,012	4,076	11,539	34,861
TOTAL de los créditos para la Empresa Común de Chips en el marco del Programa Horizonte Europa	Créditos de compromiso	=1a+1b +3	**210,000**	**250,000**	**521,200**	**568,600**	**494,600**	**302,800**	**302,800**		**2 650,000**
	Créditos de pago	=2a+2b +3	**54,272**	**116,292**	**337,335**	**451,264**	**490,696**	**401,908**	**354,149**	**444,083**	**2 650,000**

B Programa Europa Digital

En el marco del Programa Europa Digital, excepto para los 125 millones EUR que se ejecutarán en el marco de InvestEU, la Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave (futura Empresa Común de Chips) ejecutará 1 525 millones EUR, que se repartirán entre gastos operativos y de apoyo como sigue:

Empresa Común de Chips			**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	***Después de 2027***	**TOTAL**
Créditos operativos											
Programa Europa Digital - 02 04 06 11 - Empresa Común de Chips — Gastos operativos	Créditos de compromiso	(1a)			258,498	432,340	396,494	214,450	207,904		1 509,687
	Créditos de pago	(2a)			154,818	310,700	349,674	276,800	254,305	163,389	1 509,687
Créditos de carácter administrativo financiados mediante la dotación de programas específicos											
Programa Europa Digital - 02 04 06 11 - Empresa Común de Chips - Gastos de apoyo	Créditos de compromiso	(1b)			0,702	1,360	2,206	2,250	8,796		15,313
	Créditos de pago	(2b)			0,702	1,360	2,206	2,250	2,295	6,501	15,313

TOTAL de los créditos para la Empresa Común de Chips	Créditos de compromiso	=1a+1b +3			**259,200**	**433,700**	**398,700**	**216,700**	**216,700**		**1 525,000**
	Créditos de pago	=2 a+2b +3			**155,520**	**312,060**	**351,880**	**279,050**	**256,600**	**169,890**	**1 525,000**

El total de los créditos **adicionales** agrupados en la Rúbrica 1 que ejecutará la futura Empresa Común de Chips a efectos de la Iniciativa Chips para Europa asciende a 2 375 millones EUR, de los cuales 850 millones EUR en el marco de Horizonte Europa y 1 525 millones EUR en el marco de Europa Digital. Se dividirá entre gastos operativos (título 3) y gastos de apoyo (títulos 1 y 2) del siguiente modo:

			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	***Después de 2027***	**TOTAL**
Título 1	Créditos de compromiso	(4)			0,792	1,535	2,489	2,538	9,924		17,277
	Créditos de pago	(5)			0,792	1,535	2,489	2,538	2,589	7,335	17,277
Título 2	Créditos de compromiso	(4)			0,301	0,584	0,947	0,966	3,775		6,572
	Créditos de pago	(5)			0,301	0,584	0,947	0,966	0,985	2,790	6,572
Título 3	Créditos de compromiso	(4)			489,307	700,182	629,865	270,996	260,801		2 351,152
	Créditos de pago	(5)			293,147	517,342	566,045	407,126	349,586	217,905	2 351 152
TOTAL de los créditos	Créditos de compromiso	=4+ 6			**490,400**	**702,300**	**633,300**	**274,500**	**274,500**		**2 375,000**
	Créditos de pago	=5+ 6			**294,240**	**519,460**	**569,480**	**410,630**	**353,160**	**228,030**	**2 375,000**

El **total de los créditos** que serán ejecutados por la **Empresa Común de Chips** en el marco del Programa Horizonte Europa y el Programa Europa Digital, incluidos los créditos para actividades anteriores de la Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave que no forman parte de la Iniciativa Chips para Europa, ascienden a 4 175 millones EUR. Se repartirá entre gastos operativos (título 3) y gastos de apoyo (títulos 1 y 2) del siguiente modo:

			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	*Después de 2027*	TOTAL
Título 1	Créditos de compromiso	(4)	1,804	1,861	2,732	3,516	4,508	4,595	18,011	-	37,027
	Créditos de pago	(5)	1,804	1,861	2,732	3,516	4,508	4,595	4,685	13,326	37,027
Título 2	Créditos de compromiso	(4)	0,559	0,649	0,963	1,274	1,637	1,666	6,399	-	13,147
	Créditos de pago	(5)	0,559	0,649	0,963	1,274	1,637	1,666	1,685	4,714	13,147
Título 3	Créditos de compromiso	(4)	207,637	247,490	776,705	997,510	887,155	513,238	495,090		4 124,826
	Créditos de pago	(5)	51,909	113,782	489,161	758,534	836,432	674,696	604,378	595,933	4 124,826
TOTAL de los créditos	Créditos de compromiso	=4+6	**210,000**	**250,000**	**780,400**	**1 002,300**	**893,300**	**519,500**	**519,500**		**4 175,000**
	Créditos de pago	=5+6	**54,272**	**116,292**	**492,855**	**763,324**	**842,576**	**680,958**	**610,749**	**613,973**	**4 175,000**

Rúbrica del marco financiero plurianual	7	«Gastos administrativos»

Esta sección debe rellenarse mediante «los datos presupuestarios de carácter administrativo» introducidos primeramente en el anexo de la ficha de financiación legislativa (anexo V de las normas internas), que se carga en DECIDE a efectos de consulta entre servicios.

En millones EUR (al tercer decimal)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
DG CNECT									
○ Recursos humanos				1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	**5,625**
○ Otros gastos administrativos									
TOTAL para la DG CNECT				1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	**5,625**

TOTAL de los créditos de la RÚBRICA 7 del marco financiero plurianual	(Total de los créditos de compromiso = total de los créditos de pago)			1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	**5,625**

En millones EUR (al tercer decimal)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	*Después de 2027*	TOTAL
TOTAL de los créditos de las RÚBRICAS 1 A 7 del marco financiero plurianual	Créditos de compromiso			709,627	910,588	821,895	432,405	431,110	-	**3.305,625**
	Créditos de pago			421,813	674,093	738,438	572,261	504,728	394,291	**3 305,625**

3.2.2. Resultados estimados financiados con créditos operativos

Los objetos y resultados indicativos del cuadro que figura a continuación son los primeros proyectos, basados en gran medida en los indicadores que figuran en el anexo II de la propuesta de Reglamento. Se espera que, en una fase posterior, se disponga de definiciones más precisas.

Créditos de compromiso en millones EUR (al tercer decimal)

Indicar los objetivos y los resultados ⇩			Año **2023**		Año **2024**		Año **2025**		Año **2026**		Año **2027**			**TOTAL**
	Tipo[75]	Coste medio	Número	Coste	Número	Coste	Número	Coste	Número	Coste	Número	Coste	Número total	Coste total
OBJETIVO ESPECÍFICO n.º 1 «Iniciativa Chips para Europa»														
- Resultado	Número de entidades jurídicas que participan en las acciones			154,241		198,938		179,800		96,679		96,383		726,041
- Resultado	Número de herramientas de diseño desarrolladas/integradas			76,811		99,070		89,539		48,145		47,998		361,563
- Resultado	Importe coinvertido en capacidades de diseño y líneas piloto			117,984		152,174		137,534		73,953		73,726		555,370
- Resultado	Número de usuarios que acceden a capacidades de diseño y líneas piloto			95,818		123,584		111,695		60,059		59,875		451,030

[75] Los resultados son los productos y servicios que se deben suministrar (por ejemplo, número de intercambios de estudiantes financiados, número de kilómetros de carretera construidos, etc.).

- Resultado	Número de empresas que utilizan servicios de centros de competencia			65,080		83,939		75,864		40,792		40,667	306,343
- Resultado	Número de personas que reciben formación			43,914		56,639		51,191		27,525		27,441	206,710
- Resultado	Importe de la inversión en la UE por parte de las empresas de semiconductores			120,654		155,618		140,648		75,627		75,395	567,942
- Resultado	Importe de la inversión en la UE por parte de las empresas de semiconductores			34,000		39,500		34,500		8,500		8,500	125,000
Subtotal del objetivo específico n.º 1				708,502		909,463		820,770		431,280		429,985	**3 300,000**
OBJETIVO ESPECÍFICO n.º 2 «Seguridad del suministro»													
- Resultado	Número de solicitudes de instalaciones de producción integradas y fundiciones abiertas de la UE evaluadas			0,500		0,500		0,500		0,500		0,500	**2,500**
Subtotal del objetivo específico n.º 2				0,500		0,500		0,500		0,500		0,500	**2,500**
OBJETIVO ESPECÍFICO n.º 3 «Preparación y seguimiento»													
- Resultado	Número de organizaciones sobre las que se recopilan datos de la cadena de suministro			0,625		0,625		0,625		0,625		0,625	**3,125**
Subtotal del objetivo específico n.º 3				0,625		0,625		0,625		0,625		0,625	**3,125**
TOTALES				**709,627**		**910,588**		**821,895**		**432,405**		**431,110**	**3 305,625**

3.2.3. *Resumen de la incidencia estimada en los créditos administrativos*

☐ La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos administrativos

☒ La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos administrativos, tal como se explica a continuación:

En millones EUR (al tercer decimal)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
RÚBRICA 7 del marco financiero plurianual								
Recursos humanos			1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	**5,625**
Otros gastos administrativos								
Subtotal de la RÚBRICA 7 del marco financiero plurianual			1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	**5,625**

Al margen de la RÚBRICA 7[76] del marco financiero plurianual								
Recursos humanos								
Otros gastos administrativos								
Subtotal al margen de la RÚBRICA 7 del marco financiero plurianual								

TOTAL			1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	**5,625**

Dado que se trata de una nueva iniciativa, no hay personal de la DG que ya esté destinado a la gestión de la acción y que, por lo tanto, pueda ser reasignado dentro de la DG. Por consiguiente, las necesidades de recursos humanos deben cubrirse con una dotación adicional que debe asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias.

[76] Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa.

3.2.3.1. Necesidades estimadas en recursos humanos

☐ La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos.

☒ La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se explica a continuación:

El cuadro que figura a continuación se refiere al personal adicional de la Empresa Común de Chips como resultado de la propuesta de Reglamento.

Estimación que debe expresarse en equivalencia a jornada completa

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
○ Puestos de la plantilla de personal (funcionarios y personal temporal)											
Otras líneas presupuestarias (especificar) Personal de la Empresa Común (AT)			3	5	8	8	8	8	5	4	2
○ Personal externo (en equivalencia a jornada completa: EJC)[77]											
Otras líneas presupuestarias (especificar) Personal de la Empresa Común (AC)			3	7	10	10	10	10	10	10	4
Otras líneas presupuestarias (especificar): Personal de la Empresa Común (ENCS)			0	0	1	1	1	1	0	0	0
TOTAL			6	12	19	19	19	19	15	14	6

XX es la política o título presupuestario en cuestión.

Dado que se trata de una nueva iniciativa, no hay personal de la DG que ya esté destinado a la gestión de la acción y que, por lo tanto, pueda ser reasignado dentro de la DG. Por consiguiente, las necesidades de recursos humanos deben cubrirse con una dotación adicional que debe concederse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de las restricciones presupuestarias.

[77] AC = agente contractual; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión de servicios; INT = personal de empresas de trabajo temporal («intérimaires»); JPD= joven profesional en delegación.

El cuadro que figura a continuación es el personal total de la Empresa Común de Chips como resultado de la propuesta de Reglamento.

Estimación que debe expresarse en equivalencia a jornada completa

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
○ Puestos de la plantilla de personal (funcionarios y personal temporal)											
Otras líneas presupuestarias (especificar): Personal de la Empresa Común (AT)	14	14	14	17	19	22	22	22	22	13	10
○·Personal externo (en equivalencia a jornada completa: EJC)[78]											
Otras líneas presupuestarias (especificar): Personal de la Empresa Común (AC)	16	16	16	19	23	26	26	26	26	26	26
Otras líneas presupuestarias (especificar): Personal de la Empresa Común (ENCS)	0	0	0	1	1	2	2	2	2	0	0
TOTAL	30	30	30	37	43	50	50	50	50	39	36

El personal adicional de la Comisión como resultado de la propuesta de Reglamento se compone de cinco EJC funcionarios y cuatro EJC agentes contractuales por cada año del período 2023-2027.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Puestos de la plantilla de personal (funcionarios y personal temporal)							
20 01 02 01 (Remuneración e indemnizaciones — Sede y oficinas de representación)			5	5	5	5	5
•Personal externo (en equivalencia a jornada completa: EJC)[79]							

78 AC = agente contractual; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión de servicios; INT = personal de empresas de trabajo temporal («intérimaires»); JPD= joven profesional en delegación.

79 AC = agente contractual; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión de servicios; INT = personal de empresas de trabajo temporal («intérimaires»); JPD= joven profesional en delegación.

Otras líneas presupuestarias (especificar): Personal de la Comisión (AC)			4	4	4	4	4
TOTAL			9	9	9	9	9

Dado que se trata de una nueva iniciativa, no hay personal de la DG que ya esté destinado a la gestión de la acción y que, por lo tanto, pueda ser reasignado dentro de la DG. Por consiguiente, las necesidades de recursos humanos deben cubrirse con una dotación adicional que debe concederse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de las restricciones presupuestarias.

Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo:

Funcionarios y agentes temporales	Funcionarios: - Supervisión de la Empresa Común de Chips - Supervisión de la correcta aplicación de las obligaciones establecidas por el Reglamento para las empresas privadas y los Estados miembros - Preparación y redacción de actos de ejecución y delegados, de conformidad con el presente Reglamento - Realización de investigaciones, auditorías y otros análisis, incluida la analítica de datos - Apoyo administrativo al Consejo Europeo de Semiconductores y organización de reuniones, preparación de dictámenes y otro tipo de apoyo a dicho Consejo Los agentes temporales son personal de la empresa común: - Véase el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/2085 del Consejo por el que se establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa.
Personal externo	Personal externo en la Comisión Europea - Supervisión de la Empresa Común de Chips - Realización de investigaciones, auditorías y otros análisis - Apoyo administrativo al Consejo Europeo de Semiconductores y organización de reuniones, preparación de dictámenes y otro tipo de apoyo al Consejo Europeo de Semiconductores

	Personal externo en la Empresa Común: - Véase el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/2085 del Consejo por el que se establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa.

3.2.4. Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente

La propuesta/iniciativa:

☒ puede ser financiada en su totalidad mediante una redistribución dentro de la rúbrica correspondiente del marco financiero plurianual (MFP).

De la línea presupuestaria		Importe (millones EUR)	A la línea presupuestaria
01 02 03 01	Consejo Europeo de Innovación	300,000	Asignada
01 02 02 30	Bloque «Seguridad civil para la sociedad»	150,000	01 02 02 42
01 02 02 40	Bloque «Mundo digital, industria y espacio»	400,000	01 02 02 42
01 02 02 40	Bloque «Mundo digital, industria y espacio»	400,000	02 04 06 11
01 02 02 42	Programa Europa Digital — Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave	500,000	Asignada
01 02 02 50	Bloque «Clima, energía y movilidad»	300,000	01 02 02 42
Subtotal HE	*Programa Horizonte Europa*	*2 050,000*	
02 03 01	Mecanismo Conectar Europa — Transporte	250,000	02 04 06 11
02 03 03 01	Mecanismo Conectar Europa — Digital	150,000	02 04 06 11
Subtotal MCE	*Mecanismo Conectar Europa (MCE)*	*400,000*	
02 04 01 10	Programa Europa Digital (incluida la ciberseguridad)	60,000	02 04 06 11
02 04 01 11	Programa Europa Digital - Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad	60,000	02 04 06 11
02 04 02 11	Programa Europa Digital - Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (EuroHPC)	150,000	02 04 06 11
02 04 03	Programa Europa Digital - Inteligencia artificial	220,000	02 04 06 11
02 04 04	Programa Europa Digital - Capacidades	60,000	02 04 06 11
02 04 05	Programa Europa Digital - Despliegue	50,000	02 04 06 11
Subtotal PED	*Programa Europa Digital*	*600,000*	
	Total	**3 050,000**	

☒ requiere el uso de los márgenes no asignados con cargo a la rúbrica correspondiente del MFP o el uso de instrumentos especiales tal como se define en el Reglamento del MFP.

Explicar qué es lo que se requiere, precisando las rúbricas y líneas presupuestarias afectadas, los importes correspondientes y los instrumentos propuestos que van a usarse.

		Importe (millones	A la línea presupuestaria

		EUR)	
-	Margen no asignado en la Rúbrica 1	**250,000**	02 04 06 11

☐ requiere una revisión del MFP.

Explicar qué es lo que se requiere, precisando las rúbricas y líneas presupuestarias afectadas y los importes correspondientes.

En millones EUR (al tercer decimal)

3.2.5. Contribución de terceros

La propuesta/iniciativa:

☐ no prevé la cofinanciación por terceros

☒ prevé la cofinanciación por terceros que se estima a continuación:

Créditos en millones EUR (al tercer decimal)

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Estados participantes			489,307	700,182	629,865	270,996	260,801	**2 351,152**
TOTAL de los créditos cofinanciados			489,307	700,182	629,865	270,996	260,801	**2 351 152**

Se espera que los Estados participantes contribuyan a los gastos operativos adicionales con un importe que sea proporcional a la contribución de la Unión.

No se espera que miembros distintos de la Unión contribuyan a sufragar los costes administrativos adicionales de la Empresa Común.

3.3. Incidencia estimada en los ingresos

☒ La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos.

☐ La propuesta/iniciativa tiene la incidencia financiera que se indica a continuación:

☐ en los recursos propios

☐ en otros ingresos

indicar si los ingresos se asignan a líneas de gasto ☐

En millones EUR (al tercer decimal)

Línea presupuestaria de ingresos:	Créditos disponibles para el ejercicio presupuestario en curso	Incidencia de la propuesta/iniciativa[80]						
		Año N	Año N+1	Año N+2	Año N+3	Insertar tantos años como sea necesario para reflejar la duración de la incidencia (véase el punto 1.6)		
Artículo								

En el caso de los ingresos asignados, especificar la línea o líneas presupuestarias de gasto en la(s) que repercutan.

[...]

Otras observaciones (por ejemplo, método/fórmula que se utiliza para calcular la incidencia en los ingresos o cualquier otra información).

[...]

ANEXO
de la FICHA DE FINANCIACIÓN LEGISLATIVA

Denominación de la propuesta o iniciativa:

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores (Ley de Chips) y propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (UE) 2021/2085 del Consejo por el que se establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa

1. NÚMERO y COSTE DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE SE CONSIDERAN NECESARIOS
2. COSTE DE LOS DEMÁS GASTOS ADMINISTRATIVOS

[80] Por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales (derechos de aduana, cotizaciones sobre el azúcar), los importes indicados deben ser importes netos, es decir, importes brutos tras la deducción del 20 % de los gastos de recaudación.

3. COSTES ADMINISTRATIVOS TOTALES

4. MÉTODOS de CÁLCULO UTILIZADOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS COSTES

4.1 Recursos humanos

4,2 Otros gastos administrativos

El presente anexo debe acompañar a la ficha financiera legislativa cuando empiece la consulta interservicios.

Los cuadros de datos se utilizan como fuente para los cuadros que figuran en la ficha financiera legislativa. Son únicamente para su uso interno dentro de la Comisión.

1 COSTE DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE SE CONSIDERAN NECESARIOS

☐ La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos

■ La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se explica a continuación:

En millones EUR (al tercer decimal)

RÚBRICA 7 del marco financiero plurianual		Año 2021		Año 2022		Año 2023		Año 2024		Año 2025		Año 2026		Año 2027		TOTAL	
		EJC	Créditos	EJC	Créditos	EJC	Créditos	EJC	Créditos	EJC	Créditos	EJC	Créditos	EJC	Créditos	EJC	Créditos
• Puestos de la plantilla de personal (funcionarios y personal temporal)																	
20 01 02 01 – Remuneración e indemnizaciones — Sede y oficinas de representación	AD					5	0,785	5	0,785	5	0,785	5	0,785	5	0,785		3,925
	AST																
20 01 02 03 – Remuneraciones e indemnizaciones — Delegaciones de la Unión	AD																
	AST																
• Personal externo[81]																	
20 02 01 y 20 02 02 – Personal externo – Sede y Representaciones de la Comisión	AC					4	0,340	4	0,340	4	0,340	4	0,340	4	0,340		1,700
	ENCS																
	INT																
20 02 03 – Personal externo – Delegaciones de la Unión	AC																
	AL																
	ENCS																
	INT																
	JPD																

[81] AC = agente contractual; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión de servicios; INT = personal de empresas de trabajo temporal («intérimaires»); JPD= joven profesional en delegación.

Otras líneas presupuestarias relacionadas con los recursos humanos (*especificar*)																	
Subtotal recursos humanos de la RÚBRICA 7						**9**	**1,125**	**9**	**1,125**	**9**	**1,125**	**9**	**1,125**	**9**	**1,125**		**5,625**

Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la gestión de la acción y/o reasignado dentro de la DG, que se complementará, en caso necesario, con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los imperativos presupuestarios existentes.

Al margen de la RÚBRICA 7 del marco financiero plurianual		**Año 2021**		**Año 2022**		**Año 2023**		**Año 2024**		**Año 2025**		**Año 2026**		**Año 2027 y siguientes**		**TOTAL**	
		EJC	Créditos	EJC	Créditos	EJC	Créditos	EJC	Créditos	EJC	Créditos	EJC	Créditos	EJC	Créditos	EJC	Créditos
• Puestos de la plantilla de personal (funcionarios y personal temporal)																	
01 01 01 01 - Gastos relacionados con los funcionarios y agentes temporales que ejecutan Horizonte Europa — Investigación indirecta[82] 01 01 01 11 Investigación directa Otro (especificar)	AD																
	AST																
• Personal externo[83]																	
Personal externo con cargo a créditos	- en la sede	AC															
		ENCS															
		INT															

[82] Selecciónese la línea presupuestaria pertinente o especifíquese otra en caso necesario; si la propuesta afecta a más líneas presupuestarias, deberá diferenciarse el personal por cada línea presupuestaria afectada.

[83] AC = agente contractual; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión de servicios; INT = personal de empresas de trabajo temporal («intérimaires»); JPD= joven profesional en delegación.

operativos (antiguas líneas «BA»).	- en las delegaciones de la Unión	AC																
		AL																
		ENCS																
		INT																
		JPD																
01 01 01 02 Investigación indirecta 01 01 01 12 Investigación directa Otro (especificar)[84]		AC																
		ENCS																
		INT																
Otras líneas presupuestarias relacionadas con los recursos humanos (*especificar*)																		
Subtotal recursos humanos al margen de la RÚBRICA 7																		
Total recursos humanos (todas las rúbricas del MFP)							**9**	**1,125**	**9**	**1,125**	**9**	**1,125**	**9**	**1,125**	**9**	**1,125**		**5,625**

Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la gestión de la acción y/o reasignado dentro de la DG, que se complementará, en caso necesario, con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los imperativos presupuestarios existentes.

[84] Selecciónese la línea presupuestaria pertinente o especifíquese otra en caso necesario; si la propuesta afecta a más líneas presupuestarias, deberá diferenciarse el personal por cada línea presupuestaria afectada.

2 COSTE DE LOS DEMÁS GASTOS ADMINISTRATIVOS

■ La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos administrativos

☐ La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos administrativos, tal como se explica a continuación:

En millones EUR (al tercer decimal)

RÚBRICA 7 del marco financiero plurianual	Año N[85]	Año N+1	Año N+2	Año N+3	Año N+4	Año N+5	Año N+7	**Total**
En la sede o dentro del territorio de la UE:								
20 02 06 01 – Gastos de misión y de representación								
20 02 06 02 – Reuniones, grupos de expertos y gastos de conferencias								
20 02 06 03 – Reuniones de comités[86]								
20 02 06 04 - Estudios y consultas								
20 04 – Gastos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación[87]								
Otras líneas presupuestarias no relacionadas con los recursos humanos (*especificar cuando sea necesario*)								
En las delegaciones de la Unión								
20 02 07 01 – Gastos de misiones y conferencias y gastos de representación								
20 02 07 02 – Formación complementaria del personal								
20 03 05 – Infraestructura y logística								
Otras líneas presupuestarias no relacionadas con los recursos humanos (*especificar cuando sea necesario*)								

[85] El año N es el año de comienzo de la ejecución de la propuesta/iniciativa. Sustitúyase «N» por el primer año de aplicación prevista (por ejemplo: 2021). Lo mismo para los años siguientes

[86] Especifíquese el tipo de comité y el grupo al que pertenece.

[87] Se requiere el dictamen del equipo de inversiones en tecnologías de la información y la comunicación de la DG DIGIT [véanse las Directrices sobre la financiación de tecnologías de la información y la comunicación, C(2020)6126 final de 10.9.2020, p. 7].

Subtotal de Otros dentro de la RÚBRICA 7 del marco financiero plurianual								

En millones EUR (al tercer decimal)

Al margen de la RÚBRICA 7 del marco financiero plurianual	**Año 2021**	**Año 2022**	**Año 2023**	**Año 2024**	**Año 2025**	**Año 2026**	**Año 2027**	**Total**
Gastos en asistencia técnica y administrativa (con exclusión del personal externo) con cargo a créditos operativos (antiguas líneas «BA»):								
- en la sede								
- en las delegaciones de la Unión								
Otros gastos de gestión en el ámbito de la investigación								
Gasto estratégico en tecnologías de la información y la comunicación: programas operativos[88]								
Gasto institucional en tecnologías de la información y la comunicación: programas operativos[89]								
Otras líneas presupuestarias no relacionadas con los recursos humanos (*especificar cuando sea necesario*)								
Subtotal Otros al margen de la RÚBRICA 7 del marco financiero plurianual								
Total Otros gastos administrativos (todas las rúbricas del MFP)								

[88] Se requiere el dictamen del equipo de inversiones en tecnologías de la información y la comunicación de la DG DIGIT [véanse las Directrices sobre la financiación de TI, C(2020)6126 final de 10.9.2020, p. 7].

[89] Esta partida incluye sistemas administrativos locales y contribuciones a la cofinanciación de sistemas institucionales de tecnologías de la información y la comunicación [véanse las Directrices sobre la financiación de tecnologías de la información y la comunicación, C(2020)6126 final de 10.9.2020].

3 COSTES ADMINISTRATIVOS TOTALES (TODAS LAS RÚBRICAS DEL MFP)

En millones EUR (al tercer decimal)

Resumen	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Total
Rúbrica 7 – Recursos humanos			1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	**5,625**
Rúbrica 7 – Otros gastos administrativos								
Subtotal Rúbrica 7			**1,125**	**1,125**	**1,125**	**1,125**	**1,125**	**5,625**
Al margen de la Rúbrica 7 — Recursos humanos (título 1, Empresa Común)								
Al margen de la Rúbrica 7 – Otros gastos administrativos (título 2, Empresa Común)								
Subtotal para otras rúbricas								
TOTAL RÚBRICA 7 y al margen de la RÚBRICA 7			**1,125**	**1,125**	**1,125**	**1,125**	**1,125**	**5,625**

Las necesidades en materia de créditos administrativos se cubrirán mediante los créditos ya destinados a la gestión de la acción o reasignados, que se complementarán en caso necesario con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los imperativos presupuestarios existentes.

4 MÉTODOS DE CÁLCULO UTILIZADOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS COSTES

4.1 Recursos humanos

En este apartado se expone el método de cálculo utilizado para estimar los recursos humanos considerados necesarios [hipótesis sobre carga de trabajo, incluidos los empleos específicos (perfiles de actividad Sysper 2), categorías de personal y costes medios conexos]

RÚBRICA 7 del marco financiero plurianual
NOTA: los costes medios correspondientes a cada categoría de personal en la sede se encuentran disponibles en BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx
• Funcionarios y agentes temporales Equivalentes a jornada completa multiplicados por los costes medios (157 000 EUR)
• Personal externo Equivalentes a jornada completa multiplicados por los costes medios (85 000 EUR)

Al margen de la RÚBRICA 7 del marco financiero plurianual
• Únicamente puestos financiados con cargo al presupuesto de investigación
• Personal externo

4.2 Otros gastos administrativos

Descríbase detalladamente el método de cálculo utilizado para cada línea presupuestaria y, en particular, las hipótesis de base (p. ej., número de reuniones al año, costes medios, etc.)

RÚBRICA 7 del marco financiero plurianual

Al margen de la RÚBRICA 7 del marco financiero plurianual